第23届
深圳国际电子展
暨嵌入式展
elexcon 2026

博闻创意
Creativity Exhibition

2026年9月9-11日
深圳国际会展中心（宝安新馆）

elexcon 2026

深圳国际电子展
暨嵌入式展
展前预览

同期举办：CIOE 中国光博会　ICIE 国际集成电路创新博览会 INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

320,000m²
超级规模

240,000+
专业观众

5,000+
参展企业

三展联动 | 共建电子嵌入式 × 光芯融合新生态

主办单位：博闻创意会展(深圳)有限公司

联系电话： 0755 8831 1535

即刻扫码登记
获取参观证件

展前预览——目录

>>回目录页

扫码登记参观

目录

P03 关于elexcon深圳国际电子展暨嵌入展

P04 展会亮点

P05 elexcon主题展区一览

P07 三展联动--展馆分布图

P06 热门主题会议

P08 elexcon特色展区--**存储**

P14 elexcon特色展区--**嵌入式**

P20 elexcon特色展区--**功率与电源**

P24 elexcon特色展区--**电子元器件**

P37 elexcon特色展区--**芯片**

P42 elexcon特色展区--**连接器**

P45 elexcon特色展区--**设备、材料**、**其他**

P53 第八届中国嵌入式技术大会

P54 新能源汽车电子创新技术论坛

P55 SiP China第十届系统级封装大会

P57 固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛

P58 AI数据中心光电融合技术创新论坛｜聚焦NPO

P59 Kaifa Gala大湾区开发者/工程师嘉年华

P60 三展联动，一证通览！70+会议论坛

- AI算力基础设施
- 汽车电子及具身机器人
- 消费电子、AR&VR
- 半导体制造与智能制造

P70 组团参观

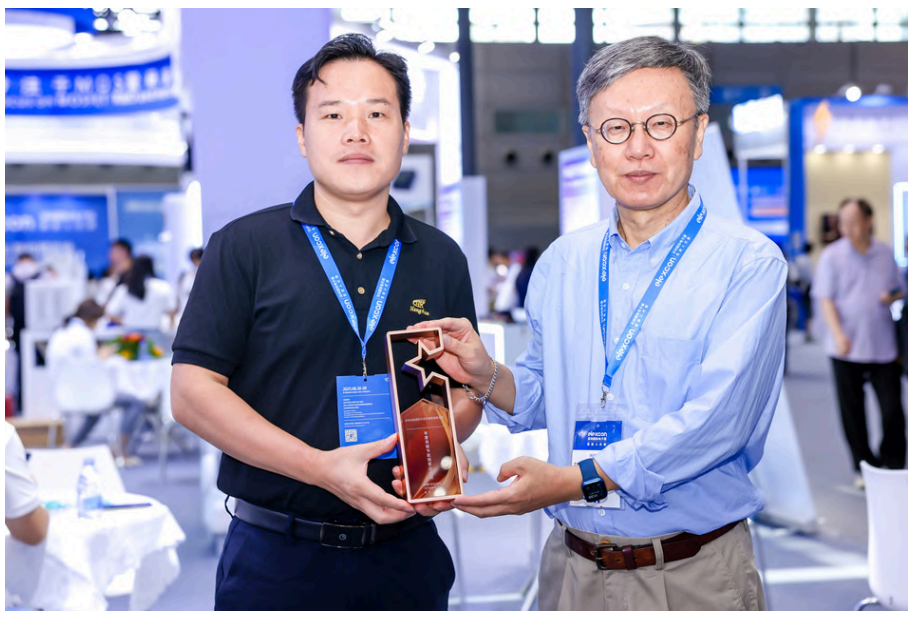
P71 交通指引

领取参观证件









本资料由主办方根据展商提交内容整理，当前版本信息截至8月25日，内容将持续更新中！

关于elexcon深圳国际电子展

领取参观证件

由博闻创意会展主办的 **elexcon第23届深圳国际电子展暨嵌入式展** 将于2026年9月9-11日将在深圳国际会展中心（宝安）开幕，携手 CIOE中国光博会、IICIE国际集成电路创新博览会，三展联动，共同打造总规模达 32 万平方米的新技术·新产品发布与推广平台，形成**“光-电-存-算”**全产业链协同效应。

作为华南电子与嵌入式技术年度大展，elexcon2026聚焦展示嵌入式与边缘AI、存储、芯片、功率与电源、电子元器件、连接器、先进封装等全产业链资源。

同期举办多场专业论坛：开幕主题演讲、第八届中国嵌入式技术大会、SiP China第十届系统级封装大会、华南汽车电子采供对接会及Kaifa Gala大湾区开发者嘉年华，助力硬件开发者、采购经理与决策者第一时间掌握新技术、对接新伙伴。

三展规模：5000+参展商·320,000㎡超大规模·240,000+专业观众·70+同期会议

嵌入式

- 嵌入式处理器：MCU/MPU/SoC/FPGA/DSP
- 嵌入式AI与边缘计算
- AIoT解决方案
- 嵌入式模块
- 存储
- 嵌入式操作系统
- 开发板
- 调试与仿真工具
- 有线/无线通信模组
- 传感器与执行器
- 电源管理IC

电子元器件

- 半导体IC
- MEMS与传感器
- 电源
- 汽车电子
- 功率半导体
- 热管理
- 测试与测量
- SiP与先进封装
- 高速连接技术与连接器
- 线束、线缆与组件
- 继电器与开关
- 无源器件（容阻感/晶振）

>>回目录页

展会亮点

- **权威品牌行业标杆：**电子与嵌入式权威品牌，历经22届沉淀，行业影响力突出。
- **AI+嵌入式 x 元器件等全产业链一站式联动：**涵盖芯片、功率器件、模组工具链，为AI硬件、汽车电子、机器人、智能制造、物联网等全产业链提供系统级选型与方案对接平台。
- **全域观众精准对接：**覆盖电子与嵌入式上下游、应用领域及产业协会，实现产业、技术、科研多方精准对接。
- **联动KAIFA GALA开发者/工程师嘉年华：**集Demo体验、开发板领取、工具链上手、技术论坛与社群互动于一体，打造大湾区最火爆的硬核技术体验场。
- **三展联动生态互通：**联动CIOE光博会、IC创新博览会，覆盖上游核心器件到下游终端与应用生态，赋能**AI算力、消费电子&AR/VR、智能汽车与具身机器人、半导体与智能制造**等四大核心赛道。

领取参观证件

提前登记，节省入场时间，提前参观体验；

- **节约时间，凭报名回执现场快速换领证件入场；**
- **精准规划， 登记后将第一时间获取展会手册及参展商名单，合理规划参观；**
- **专属VIP福利，免费参与应用论坛；**
- **展前提醒，不错过开展时间；**

扫码下载团体报名表

扫码领取个人参观证件

关注elexcon官方公众号

>>回目录页

elexcon主题展区一览

>>回目录页

扫码登记参观

作为**深圳及华南地区唯一专注于电子与嵌入式的行业展会，elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展**已成功举办22届，行业影响力卓著。本届elexcon规模再度升级，同期**7大热门展区**包含嵌入式与边缘AI、存储、芯片、功率与电源、电子元器件、连接器、先进封装等全产业链资源，从研发工程师到采购决策者等各类专业观众，可**“一站式找齐供应商、一次性对接全链条资源”**，高效完成选型和资源对接。

elexcon主题展区一览

>>回目录页

领取参观证件

嵌入式与边缘AI展区：智能落地核心主线

- **展示范畴：**嵌入式工控 & 边缘计算硬件、嵌入式开发工具 & 开发平台
- **代表展商：**研华科技、SEGGER 中国（哲戈微）、安勤科技、璞致电子、芯驿电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro、拓普微、临滴、睿赛德、研江等
- **第八届中国嵌入式技术大会：**中电港、ARM、NXP、达摩院-玄铁、Linaro、安勤科技、瑞萨电子、ADI、研华科技、兆威机电、苦芽科技、灵动微、睿赛德、航顺芯片等

存储展区：AI时代数据粮仓

- **展示范畴：**存储芯片、存储模组、存储配套元器件
- **代表展商：**长江存储、长江万润半导体、朗科、东芯半导体、宇瞻、科摩思、德明利、喻芯半导体、博雅、华迅、迈德迩、金胜电子、舜铭、华芯星、威刚、豪杰创新、捷龙存储等

芯片展区：前沿应用核芯底座

- **展示范畴：**算力芯片、 MCU、CPU、NPU、DSP；

代表展商：华大电子、航顺芯片、灵动微、码灵、速显微、凌烟阁、本原微、唯创知音、九芯电子、芯龙半导体等

功率与电源展区：高效能能源变革

- **展示范畴：**电源 IC、电源模块、功率分立器件
- **代表展商：**京泉华、上海贝岭、爱浦、荣和美、台懋半导体、信安半导体、江智科技、鸮善电源、万芯半导体、芯北电子、芯控源、汉仁等；
- **固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛暨主题展区：**伊顿、村田、艾德克斯、威派森、京泉华、维谛等

elexcon主题展区/会议一览

>>回目录页

扫码登记参观

电子元器件展区：电子产业基石

- **展示涵盖：**磁性 / 电感 / 变压器类（电源核心元器件）、被动元件（电阻、MLCC 电容）、射频 / 精密结构件、测试测量；
- **代表展商：**厚声、微容、宇阳、扬兴科技、信维电子、德鸿感应、进工、芯声微、富捷科技、CCTA品牌晶振、华晟电通、军康电子、灿昇、三和电容、新永利、西普尔、敦源电子、岑科、科达嘉、三乐益、东晶、功得、金华、艾芙司、富致、圣镁、今凯、必德、东恒、鸿利光显、屹立得、圣科萨、柯洱斯、模量等

先进封装展区：CPO与SiP先进封装

- **展示范畴：**Chiplet 异构集成 SiP / TSV / TGV / 封装基板 / 封装材料 / 工艺设备 / 光电共封等；
- **代表展商：**苏纳光电、启诺迪、伊帕思、贺利氏电子、比昂芯、盟拓智能
- **“SiP China第十届系统级封装大会”代表企业：**芯和半导体、康宁、长电科技、苏纳光电、西门子EDA、比昂芯、锐杰微、贺利氏电子、天芯互联、烽火通信等

>>回目录页

领取参观证件

连接器：精密可靠连接

- **展示范畴：**微型连接器、板对板连接器、高速连接器、高压连接器、车规连接器；
- **代表展商：**步步精、硕凌、宇熙精密、福顺、创豪欣、精途、帏达鑫、万达、五盈、厚为电子等

elexcon会议一览

时间	会议名称	会议地点
09/10全天	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1
09/09全天	新能源汽车电子创新技术论坛	14号馆二楼 14A
09/09-/09/10	第十届中国系统级封装大会 SiPChina2026	北登录大厅二楼媒体中心 B&C
09/09全天	固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛	北登录大厅二楼媒体中心C
09/09全天	AI数据中心光电融合技术创新论坛：聚焦NPO	北登录大厅二楼媒体中心 A

**以上会议以最终实际为准。*

三展联动/展馆分布图

>>回目录页

扫码登记参观

打通电子/光电/半导体全产业链
三展联动，一证参观三展!

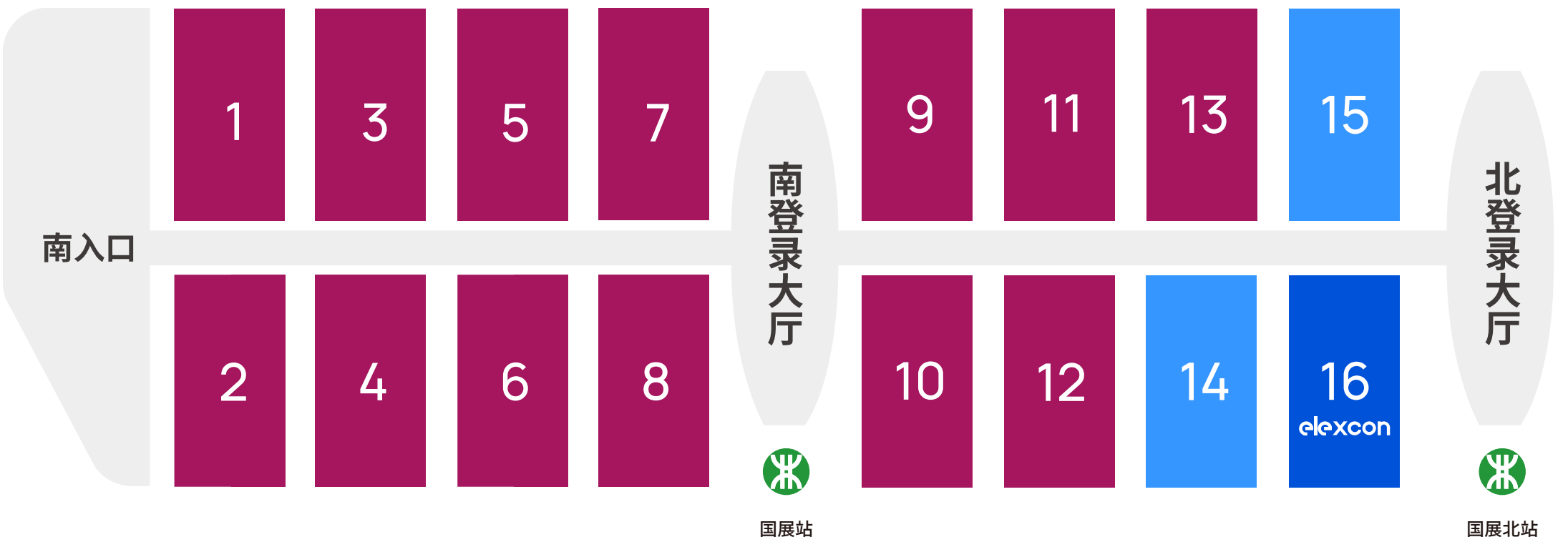
elexcon第23届深圳国际电子展暨嵌入式展与CIOE中国光博会、IICIE国际集成电路创新博览会同期同地举办，深度融合“**光-电-存-算**”扩大产业协同聚合优势，助力**参展企业对接多元上下游应用市场，催生更多跨领域技术联动与商业合作契机。**

CIOE 集中呈现光电全产业链上游材料、中游芯片 / 器件 / 模组、下游生产加工设备、终端整机与行业系统解决方案，覆盖光通信、消费电子、汽车电子、智能制造、安防、医疗、半导体、元宇宙、新能源等全下游应用赛道，是一站式光电产品采购、技术交流、产业对接综合平台；同期联动IC集成电路展，完整覆盖 “光电子 + 半导体” 双产业生态

IICIE 国际集成电路创新博览会集中展示集成电路全产业链芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备、关键材料、核心零部件及各行业终端应用解决方案，覆盖宽禁带半导体、先进封装、AI 与车规芯片等前沿创新技术

领取参观证件

• 三展联动展馆分布图 •



同期展会：

Hall 1-13 CIOE 中国光博会

Hall 14-16 IICIE 国际集成电路创新博览会 INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

Hall 14-16 第23届 深圳国际电子展暨嵌入式展 elexcon 2026

>>回目录页

展前预览——存储展区

>>回目录页

扫码登记参观

深圳市德明利技术股份有限公司 16A50



嵌入式存储
eMMC



固态硬盘
2.5 Inch SATA



固态硬盘M.2 2280 PCIe4.0x4

产品介绍：

- 嵌入式存储eMMC：遵循JEDEC eMMC 5.1标准，带有eMMC接口，将闪存及主控制器集成于一个小的BGA封装内，提供高可靠性、高性能和低成本的存储解决方案。
- 固态硬盘M.2 2280 PCIe4.0x4：提供M.2 2280/2230规格，容量256GB-4TB，读取最高7400MB/s，写入6800MB/s，NVMe协议，3.3V低功耗，0-70°C稳定运行，满足高性能存储需求。
- 固态硬盘2.5 Inch SATA：SATA III 6Gbps接口，容量128GB-4TB，读写速度达560/520MB/s，AHCI协议，5V供电，0-70°C稳定运行，兼容主流笔记本和台式机。

>>回目录页

领取参观证件

宇瞻科技股份有限公司 16B25



工业级 DDR5 CQDIMM 内存模组



GraTherX DDR5 ECC CSODIMM
内存模组

产品介绍：

- 工业级 DDR5 CQDIMM 内存模组：专为人工智能、高性能计算（HPC）、边缘服务器及各种数据密集型应用设计。 采用先进的四列CUDIMM架构，单条最大容量128GB，传输速度高达7200 MT/s，平衡高容量与高性能，以满足下一代计算平台日益增长的内存需求。
- GraTherX DDR5 ECC CSODIMM 内存模组：GraTherX DDR5 ECC CSODIMM 是专为解决上述散热挑战所打造的模块级散热解决方案。在无风扇自然对流测试环境下，GraTherX DDR5 ECC CSODIMM 可实现：模块最高温降低最高 20°C；模块正反面温差缩小至约 1°C 以内。通过更均匀的热分布，大幅提升内存散热效率，使 DRAM 平均故障间隔时间（MTBF）提升 2.7 倍，并将故障率（FIT）降低 60%，有效提升系统长期运作可靠性。

威刚电子（上海）贸易有限公司 14B63



TRUSTA T7P5 Gen5
E3.S eSSD



TRUSTA T7P5 Gen5
U.2 eSSD



TRUSTA T7P5 Gen5 E1.S eSSD

产品介绍：

- TRUSTA T7P5 Gen5 eSSD 是我们的旗舰企业存储解决方案，旨在满足高端数据中心的严格需求，实现卓越的速度与行业领先的能效完美协同。
- T7P5基于NVMe 2.0c协议，配备PCIe Gen5 x4接口，采用先进的eTLC NAND技术，为关键任务负载提供卓越的服务质量（QoS）和可靠的24小时运行。
- T7P5 设计注重最大可靠性和数据完整性，配备了全面的企业级功能套件，包括断电保护（PLP）、SMBus 管理和智能热节流，确保在高热负载下持续性能。为保护敏感数据，支持TCG Opal SSC和AES GCM硬件加密。

深圳市朗科科技股份有限公司 16A28



US9固态手机U盘



绝影NV7000-t



ZX20移动固态硬盘



HD10M2 Pr磁吸硬盘盒

产品介绍：

>>回目录页 领取参观证件

- US9固态手机U盘：Type-A+C双接口，支持手机电脑多设备；1000MB/s高速传输；酷炫超跑机身；支持Win to go
- ZX20移动固态硬盘：2000MB/s读速，数据高效互传；支持电脑、手机等多设备连接；名片大小，差旅易携
- 绝影NV7000-t：7300MB/s读速，6700MB/s写速；Mini体积，兼容笔记本、台式PC；4TB容量空间；支持PS5扩展
- HD10M2 Pr磁吸硬盘盒：一贴即合，边录边存；

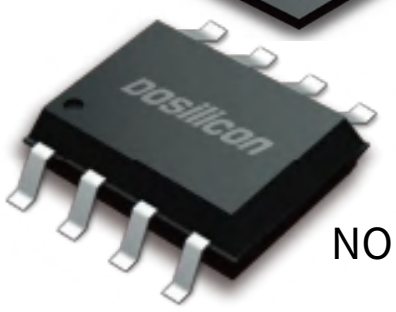
东芯半导体股份有限公司 16C50



SPI NAND Flash



DDR3 (L)



NOR Flash



PPI NAND Flash

产品介绍：

- SPI NAND Flash：单芯片设计的串行通信方案，引脚少、封装尺寸小，且在同一颗粒上集成了存储阵列和控制器，并带有内部ECC模块，使其在满足数据传输效率的同时，既节约了空间，又提升了稳定性。产品现拥有38nm及2xnm的成熟工艺制程，目前工艺制程已经推进至1xnm先进工艺制程。
- DDR3 (L)：东芯的DDR3（L）产品具备高传输速率以及低工作电压。可提供1.5V/1.35V两种电压模式，具有标准SSTL接口、8n-bit prefetch DDR架构和8个内部bank的DDR3 SDRAM，是主流的内存产品。在网络通信，消费电子，智能终端，物联网等几乎所有电子产品领域都有广泛应用。
- NOR Flash：可提供通用SPI接口、不同规格的NOR Flash，容量从64Mb到2Gb，1.8V/3.3V 两种电压，支持Single/Dual/Quad SPI和QPI四种指令模式、DTR传输模式和多种封装方式。可广泛应用于各种应用场景。
- PPI NAND Flash：兼容传统的并行接口标准，高可靠性。可提供容量从1Gb到16Gb，1.8V / 3.3V两种电压，多种封装方式的产品，以满足不同应用场景。在网络通信，物联网，工业控制等领域中广泛应用。

湖北长江万润半导体技术有限公司 16B50



MI7000



MC7000



ME7000

产品介绍：

- MI7000：采用自封工规Good Die颗粒；大容量，至多可到2048GB；支持软件PLP掉电保护、Agile ECC等算法；具有高性能、高可靠性、低功耗等特点。
- MC7000：采用自封Good Die颗粒、智能纠错；实时监控设备状态、TBW；峰值性能更持久、双重温控；少卡顿，保障性能稳定发挥。
- ME7000：出色的性能功耗比；稳定的QoS性能；端到端数据保护；异常掉电数据保护；固件在线升级。

展前预览——存储展区

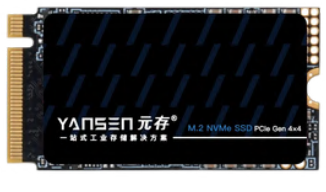
>>回目录页

扫码登记参观

深圳市金胜电子科技有限公司 16D40



M.2 PCIe 4.0 固态硬盘



M.2 PCIe 4.0 2242 固态硬盘



SATA DOM 固态硬盘

产品介绍：

- M.2 PCIe4.0 2280 固态硬盘，峰值读写速度达7400/6500MB/s，4K 随机读写650000/670000 IOPS；支持宽温工况稳定运行，平均无故障时长200万小时，容量区间覆盖256GB~4TB，高耐久高可靠适配工业及算力类存储场景。
- M.2 PCIe4.0 2242 固态硬盘，峰值读写速度达5100/4500MB/s，4K 随机读写400000 /630000 IOPS；通过严苛振动跌落测试，平均无故障时长200 万小时，容量覆盖 256GB~1TB。
- SATA DOM 采用直插式结构，无需额外供电布线；搭载TLC闪存、SATA III 接口，具备强抗震抗跌落、-40°C~85°C超宽温运行、200 万小时长MTBF高可靠性。

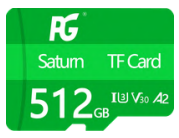
深圳华芯星半导体有限公司 16B30













TF卡 eMMC5.1





工规级 /企业级 3DTLC/QLC Nand Flash

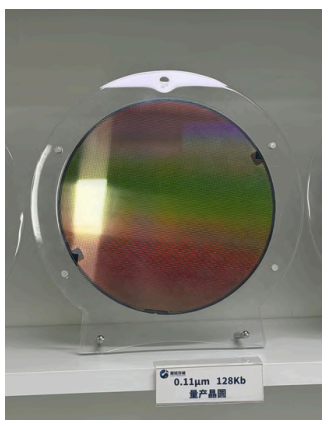


SSD固态硬盘

产品介绍：

- TF卡：商规级TF卡，具有超高清、低功耗、高速读写特性，适用于电子学习、IP摄像头、行车记录仪、安卓设备、游戏机等。工规级TF卡，耐用、稳定、可靠，适合恶劣环境中长时间运行，用于工业、医疗、交通等领域。容量：16GB-2TB；速度等级：C10, U3, V30, A1, A2A1速率：90MB/s；50MB/sA2速率：180MB/s；135MB/s。
- eMMC5.1分为商规级、工规级和车规级，在复杂多变的应用场合下，满足客户对eMMC大容量、高性能、低功耗、兼容性和稳定性的苛刻要求。容量：4GB-256GB；协议：eMMC 5.1，向下兼容至3.1；读取速度：最高330MB/s；写入速度：最高240MB/s；尺寸(mm)：11.5x13x1.0。
- 工规级Nand Flash具有高密度封装、优异的电气性能、高可靠性、易于自动化生产以及良好的机械强度和耐久性等特点，是许多高性能工业级电子设备的首选封装方案。企业级Nand Flash封装技术具备高密度引脚、优异的热管理和电气性能、抗震性、可靠性等优点，特别适用于要求高性能、高可靠性、紧凑设计和长期稳定性的企业级产品。容量：128GB-512GB
- 工业级SSD采用 TLC 闪存芯片研发，拥有更高的带宽和速度支持数据密集型应用，如数据库、高性能计算和虚拟化，是现代数据存储解决方案中的重要选择，特别是在高需求的工业环境中。容量：64GB-4TB；接口：M.2 / mSATA / SATAIII；协议：NVMe1.4 / NVMe1.3 / SATAIII；工作温度：-40°C~+85°C

无锡舜铭存储科技有限公司 16C16



产品名称： FRAM 晶圆

产品介绍： FRAM产品量产晶圆

>>回目录页

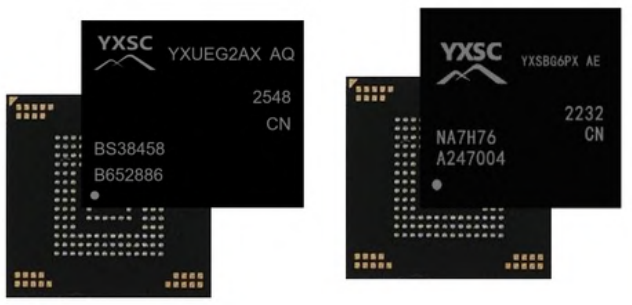
领取参观证件

武汉喻芯半导体股份有限公司

16C70



喻芯国产企业级SSD



喻芯国产UFS　　喻芯国产eMMC

>>回目录页

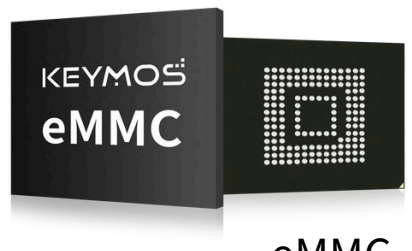
领取参观证件

产品介绍：

- 喻芯国产企业级SSD：采用PCIe 5.0×4 + NVMe 2.0架构。面向数据中心、云计算、数据库、AI/HPC 与虚拟化场景的旗舰级企业级U.2固态硬盘。支持热插拔。3D TLC 闪存，提供 R 读密集型与 M 混合负载型双系列。支持 SMBus 带外管理与 NVMe-MI，断电仍可读取盘体信息。FFU 在线固件升级业务不停机，Sanitize 安全擦除。
- 喻芯国产UFS：喻芯UFS 2.2系列符合JEDEC标准的高性能嵌入式存储芯片，面向高端智能终端、平板、IoT网关、工业设备。遵循 JEDEC 标准的高性能嵌入式存储芯片。顺序读写达 1074/922 MB/s，随机读写 180K/206K IOPS。支持 Write Booster 写入加速、RPMB 安全分区、双重写保护与 FFU 现场固件升级。动态功耗管理，休眠模式功耗极低，适配旗舰 SoC 平台。
- 喻芯国产eMMC：喻芯半导体eMMC5.1是行业主流存储芯片，高集成度国产晶圆及先进封装技术，SoC平台良好兼容性，支持工规宽温，可广泛应用于网络通信，机顶盒，电视，消费电子，智能终端，物联网等领域。

深圳科摩思智能科技有限公司

16B39

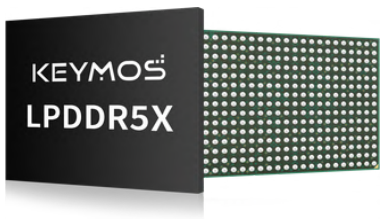


eMMC





LPDDR4/4X



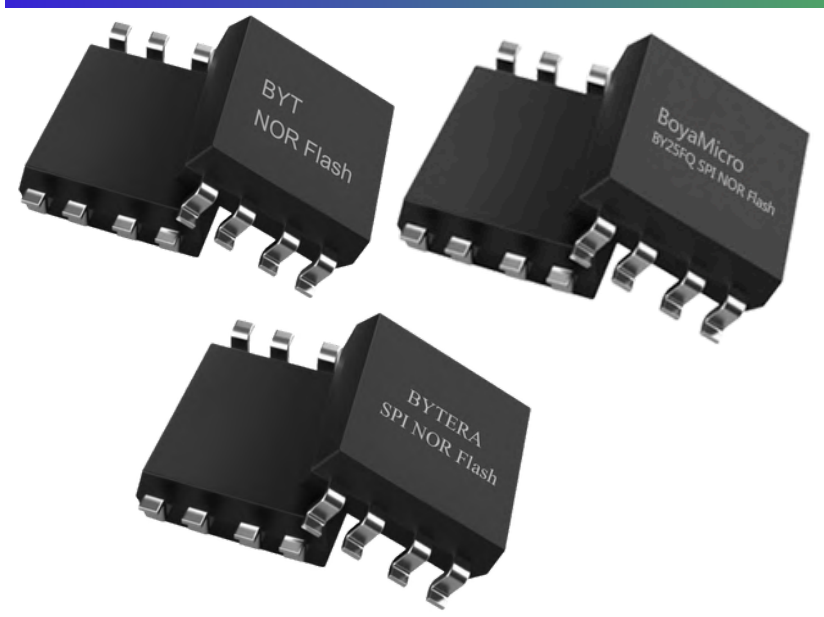
LPDDR5/5X

产品介绍：

- eMMC：eMMC产品高度集成化让数据传输更为高效，体积小，减少了PCB空间占用，降低了管理NAND Flash芯片的时间；大容量，高性能，低功耗，提供64GB-128GB容量选择，读速可达265MB/s，应用程序启动和数据传输更为高效，更低功耗设计可延长设备续航时长；高可靠性和安全性，支持断电保护、ECC纠错功能和内建坏块检测机制，以确保数据的安全性和完整性； 更优的寿命管理及性能优化支持动/静态磨损均衡算法化。
- LPDDR4/4X：高速传输，低功耗，采用双数据速率架构，速率高达4266Mbps，加快多任务处理速度进而优化用户体验；电压低至0.6V，可有效延长设备使用时长。数据访问和使用更高效；通过可编程和动态突发长度以此更有效地管理数据访问，提高内存使用效率，进而优化设备的性能。
- LPDDR5/5X：高性能，大容量，4GB-16GB多种容量选择；采用WCK信号设计从而提高数据传输效率，速率高达8533Mbps；低功耗，强稳定性，电压低至0.5V，采用了更先进的电源管理技术，如写入休眠模式和自适应电压调节，能更精细地控制功能，优化系统性能提高设备稳定性。

珠海博雅科技股份有限公司

16B04

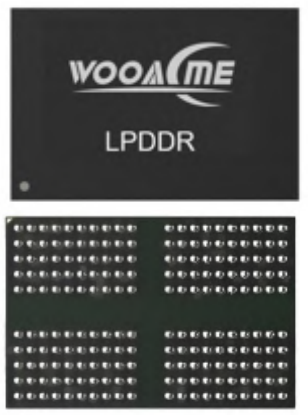


产品名称：NOR Flash，EEPROM

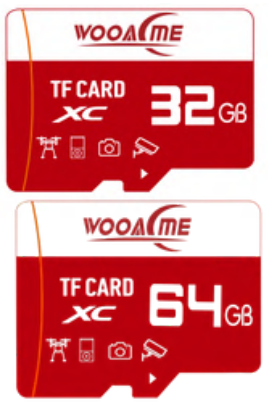
产品介绍：

- NOR Flash: 全系列，容量涵盖512Kb~2Gb，SPI和Parallel两种接口，高、低、宽压多种规格电压。极高性能，STR/DTR频率最高达 200MHz，擦写时间极短，支持Octal接口，最高读写速度高达3200MBit/s。极高可靠性，20年数据保存时间，10万次P/E Cycle，支持温度高达125°C，支持ECC, CRC，为客户带来极大保障。
- EEPROM: 全系列，支持IIC和SPI两种接口，容量覆盖1Kb~2Mb。

安徽华迅科技有限公司 16B08



武迅HX53E



武迅TF卡



武迅固态硬盘

产品介绍：

- 武迅HX53E：HX53E系列是一款低功耗高速SDRAM，兼容LPDDR4与LPDDR4X双电压I/O标准（1.1V/0.6V），支持最高4266Mbps数据率及64Gb容量。芯片内部每通道配备8个Bank，支持并发访问以提升数据带宽。功耗控制上，VDD2仅需1.1V，配合0.6V超低I/O电压。广泛适用于智能手机、平板及IPC摄像头等智能视觉终端。
- 分为PCIe与SATA两大系列。PCIe系列中，WX-P3采用NVMe协议，搭载高性能主控与3D TLC颗粒，顺序读写达3500/3100 MB/s；WX-P4为PCIe 4.0，搭配长江存储颗粒，读写高达7400/6500 MB/s。SATA系列中，WX-S25为2.5英寸，搭配原厂颗粒，顺序读写达550/520 MB/s；WX-M2S为M.2 SATA协议，顺序读写同样达550/520 MB/s。适配台式机、笔记本等。
- WX-TF卡是安徽华迅科技推出的高性能microSD存储卡，提供8GB至128GB容量选择。顺序读取速度高达100MB/s，顺序写入速度高达90MB/s。

产品尺寸为15×11×0.7mm，支持叠Die封装。具备耐高低温、防摔、抗冲击等特性，广泛兼容智能手机、平板、监控摄像头、行车记录仪及游戏机等主流设备。

深圳市迈德迩半导体科技有限公司 16B35



2.5″SATA, mSATA,M.2 SATA,
M.2 PCIe5.0,M.2 PCIe4.0,M.2 PCIe3.0

产品介绍：

- 主营消费级固态硬盘，涵盖eMMC嵌入式存储与SSD高速固态两大核心产品，依托成熟闪存技术，兼具稳定耐用、低功耗、高适配性等优势，适配多场景民用及智能终端存储需求。
- eMMC为一体化嵌入式存储方案，结构精简、成本可控、功耗更低，适配轻量化智能设备，广泛应用于智能手机、智能电视、智能手表、智能门锁等消费终端，可充分满足日常基础数据存储与快速读写需求。
- SSD固态硬盘主打高性能、高速读写、强兼容与稳定扩容，算力与多任务处理能力突出，适配高端场景，核心应用于笔记本电脑、安防设备、物联网终端、人工智能及服务器等设备，高效承载大容量数据读写、存储与传输工作，全方位适配多元化消费级存储场景。

>>回目录页

领取参观证件

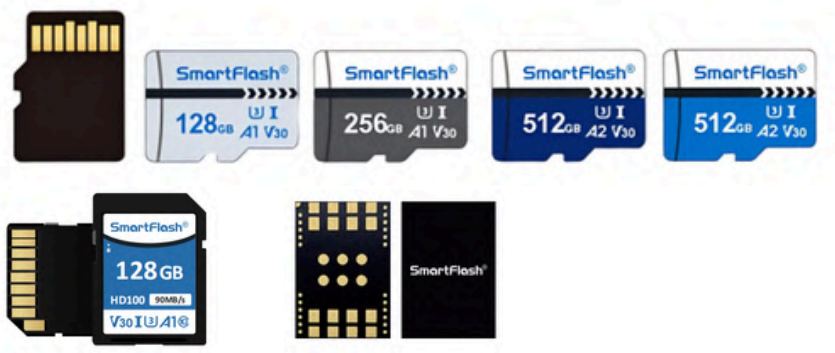
深圳豪杰创新电子有限公司 16A16



SSD-类工规存储系列



SSD-专业存储系列



行业存储卡系列

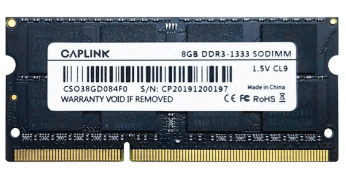
产品介绍：

- SSD-类工规存储系列：类工规存储系列SSD，采用原厂精选NAND，经过严格测试和强化筛选，具有更高的稳定性，产品涵盖如下：M.2 NVMe PCIe Gen 3×4 SSD / M.2 SATA III SSD / 2.5" SATA III SSD;广泛应用于端侧AI、工控机、医疗设备、NAS存储等领域。
- SSD-专业存储系列：专业存储系列SSD，采用原厂高品质NAND，兼具专业性能与稳定高效的品质，产品涵盖如下：M.2 NVMe PCIe Gen 5×4 SSD / M.2 NVMe PCIe Gen 4×4 SSD / M.2 NVMe PCIe Gen 3×4 SSD / M.2 SATA III SSD / 2.5" SATA III SSD;广泛应用于专业应用领域，如AI PC、智能终端、商显设备等。
- 行业存储卡系列：行业存储卡系列涵盖microSD卡、SD卡、SD NAND等产品，兼具迷你尺寸和高效性能的特点，广泛应用于行车记录仪、无人机、安防监控、嵌入式设备等等。

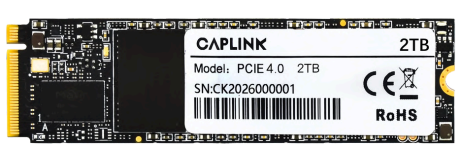
深圳市捷龙存储科技有限公司 16B33



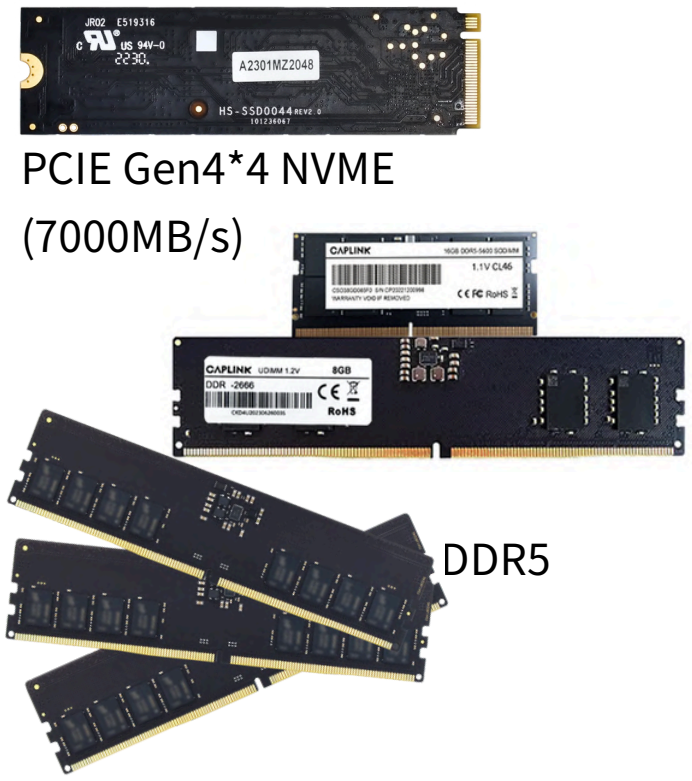
eMMC



eMMC



PCIE Gen4*4 NVME (7000MB/s)



DDR5

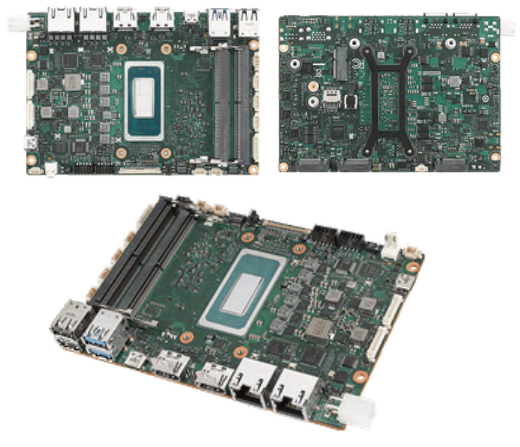
产品介绍：

- eMMC：CAPLINK eMMC 5.1 属于消费级嵌入式存储芯片，提供 32GB 至 64GB 主流容量选择，搭载 3D TLC / 3D QLC 闪存，HS400 高速接口，顺序读取速度可达 300MB/s，顺序写入速度最高 200MB/s。采用 BGA-153 封装，即焊即用。产品运行稳定、功耗低，拥有 1 年质保。适配智能手机、平板电脑、智能电视、机顶盒、智能音箱、入门级笔记本等各类消费电子产品。
- PCIE Gen4*4 NVME(7000MB/s)：CAPLINK PCIe 4.0×4 NVMe SSD 为旗舰级高速固态硬盘，M.2 2280 标准规格，容量覆盖 128GB 至 4TB，顺序读取最高 7000MB/s，顺序写入最高 6400MB/s。采用高品质 3D TLC/QLC 闪存颗粒，拥有出色的读写性能与可靠性，工作温度 0°C-70°C，提供三年原厂质保。专为高性能主机、工作站打造，可流畅运行大型游戏、4K/8K 视频剪辑、大数据运算等严苛业务。广泛应用于高速台式机、笔记本、商用终端、工作站等设备。
- DDR5：CAPLINK DDR5 内存模组，紧跟次世代内存技术标准，覆盖 8GB/16GB/32GB/64GB 丰富容量规格，支持 4800、5200、5600、6000、6400MHz 等多种主流频率，工作温度 0°C-70°C，适配更广使用环境。产品采用低功耗设计，传输效率大幅提升，支持 ECC 校验，有效保障数据可靠性。专为游戏发烧友、创作者及高性能算力场景设计，拥有更大带宽，可轻松驾驭大型游戏、视频剪辑、多任务并行处理等高强度工作，兼顾消费级主机与商用设备，稳定输出强悍性能。

>>回目录页

领取参观证件

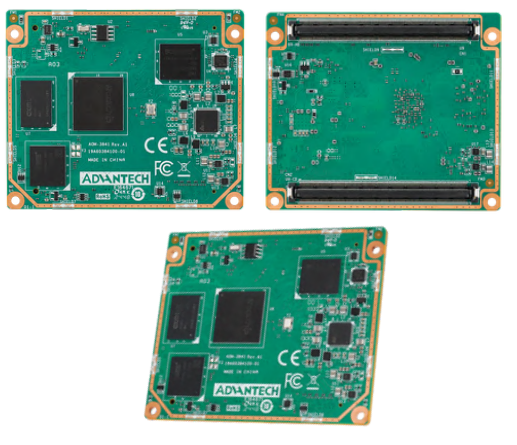
研华科技 16A42



研华AI嵌入式单板电脑MIO-5379



研华机器人控制系统 AFE-A702



AOM-3841核心板

产品介绍：

- 研华AI嵌入式单板电脑MIO-5379： 搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器（Arrow Lake/Meteor Lake），最高 14 核，提供 15W/28W 功耗选型。板载双通道 DDR5-6400 内存，最大支持 96GB 并具备 IBECC 内存纠错能力，支持四路同步显示输出。配备双网口、USB4、CAN-FD、多路串口与 GPIO；拥有 4 路 M.2 插槽。系统兼容 Windows LTSC、Ubuntu 长期版本，配套嵌入式 API、DeviceOn 远程管理与机器人软件套件，并搭载 EdgeBMC 实现带外远程硬件管控，非常适合工场景。
- 研华机器人控制系统 AFE-A702：针对行业需求，研华经大量客户调研开发的AFE-A702 / ASR-A702机器人专用控制器，作为原厂限购套件的标准化可量产替代方案，研华方案核心优势为无采购配额、供货稳定、工业级可靠，实现POC研发到批量量产全链路无缝衔接。
- AOM-3841核心板：采用RTXe标准核心板：2.0mm抗失真PCB与B2B连接器，插拔力高达264N，抗震抗干扰性能优异，专为轨道交通、特种车辆等严苛场景设计。其扩展灵活：3x MIPI-CSI接口，支持DP/HDMI/MIPI-DSI多屏输出，满足复杂显示需求。

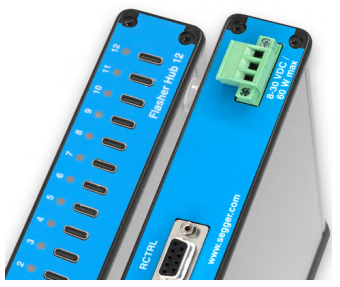
>>回目录页

领取参观证件

SEGGER中国（哲戈微） 16A25



Flasher Compact 烧录器



Flasher Hub-12



Flasher PRO 烧录器



J-Link PLUS 仿真器

产品介绍：

- Flasher Compact 烧录器：Flasher Compact 是 Flasher PRO 的精简孪生款，主要设计用于安装在空间有限的生产设备或自动测试设备（ATE）中。它可对微控制器（MCU）或片上系统（SoC）的内部及外部存储器，以及直接与其相连的存储芯片进行编程。它作为独立设备运行，无需电脑。
- Flasher Hub-12：SEGGER 的 Flasher Hub-12 是一款用于并行高速批量编程的控制单元。它可直接控制多达 12 个 Flasher Compact 单元，每个单元作为独立通道。若使用 USB 集线器，最多可支持 24 个通道。
- Flasher PRO 烧录器：Flasher PRO 是一款通用的在系统编程（ISP）工具，可对单个微控制器和片上系统（SoC）进行可靠编程。
- J-Link PLUS 仿真器：SEGGER J-Link 系列仿真器是市场上应用最为广泛的调试仿真器产品。无可比拟的性能、丰富全面的功能集、对多种 CPU 的支持以及与主流开发环境的兼容性，共同使得 J-Link 成为一款难以超越的选择。

广州市星翼电子科技有限公司(正点原子) 16D30



M1钳形万用表



DM40数字万用表



LT2智能电桥镊子

产品介绍：

- M1钳形万用表：正点原子 CM1 高精度四位半钳形万用表。最大支持 600A 交直流电流测量，量程覆盖 1000V 直流、750V 交流电压。集成电阻、电容、二极管、通断、频率、占空比、温度测量，配备 NCV 非接触验电与零火线检测。支持多段压降二极管测试，独立通断蜂鸣器响应灵敏；电容测量速度快，兼容离线与在线电阻测量。适用于电工巡检、设备维修、实验室调试。
- DM40数字万用表：正点原子DM40三合一便携测量设备，集成万用表、示波器、信号发生器。搭载 4 位半 60000 计数，支持 TRMS 真有效值测量。三孔接线设计，单孔覆盖 0.01μA–10A 电流测量。内置 10M 带宽示波器、50M 采样率、64Kpts 存储，搭配 1Hz–50kHz 信号发生器。支持 AUTO 自动测量、波形记录、AC+DC 同步测量、相对测量、测温、通断及多段二极管测试。Type-C 长效供电，自带可调支架、完善过载保护，支持数据上传与固件升级。
- LT2智能电桥镊子：正点原子 LT2 第二代便携 LCR 电桥镊子，随身精密检测工具，适配硬件研发、电路维修与元件筛选。最高 100kHz 五档测试频率，精准测量电容 ESR、高频电感、射频元件阻抗。CNC 铝合金一体外壳，屏蔽性能优异；1.47 英寸高清屏支持自动翻转。支持 AUTO 自动识别阻容感，0.1V–1.0V 四档测试电平。升级 ±32V 宽压在线测量，无需拆件断电检修；集成信号发生器、扫频、数值锁定功能。可替代台式电桥完成现场快速检测。

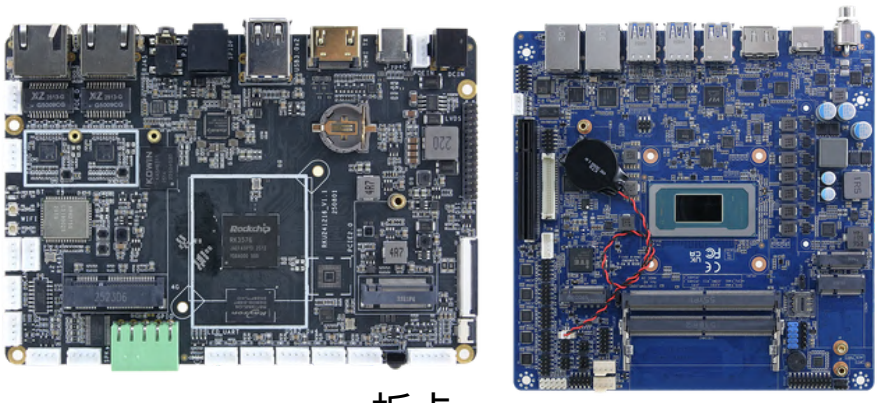
安勤计算机应用科技（上海）有限公司 16D55



行业应用平板电脑



嵌入式计算机



板卡

产品介绍：

- 行业应用平板电脑：安勤科技的平板电脑系列，覆盖多尺寸强固机型，搭载多品牌主流处理器平台，支持宽幅电压输入与宽温运行，适配工业现场复杂工况。产品支持多屏独立显示、丰富工业I/O接口与触控操作，广泛应用于智能制造人机界面、智能医疗终端、智能零售数字标牌等场景，可提供高稳定的边缘交互与数据处理能力，同时支持定制化ODM/OEM服务，满足不同行业的专属部署需求。
- 嵌入式计算机：产品覆盖多系列嵌入式整机与强固系统，适配Intel、兆芯、MTK、RK、NXP等多品牌平台，适配智能医疗、智能制造等场景，提供高可靠边缘计算系统及ODM/OEM定制服务。
- 板卡：安勤嵌入式主板涵盖X86与ARM两大平台。X86平台:支持COM Express/Qseven模块及兆芯国产CPU提供完整产品线。ARM平台:覆盖Rockchip/NXP/MTK/Qualcomm 全方案・提供工控机/平板/SBC/SMARC/OSM模块，兼具高效能、超低功耗与深度定制能力。

>>回目录页

领取参观证件

北京理工雷科电子信息技术有限公司 16B19



“山海”智算模组



RFSOC模组



S5000C通用处理板卡

产品介绍：

- “山海”智算模组：“山海”智算模组是基于国产CPU&GPU打造的面向边缘计算的新质算力产品。产品全面对标NVIDIA Jetson Orin系列，支持硬件Pin-Pin兼容及软件生态兼容，极大降低已有AI应用迁移与部署成本。山海系列覆盖智慧交通、智慧工业、具身智能、低空经济、智慧医疗等领域，为行业客户提供从智能计算模组到系统级应用的边缘智能计算解决方案。
- RFSOC模组：集成高性能射频数据转换器、处理系统及可编程逻辑芯片，支持射频信号实时采集、数字处理、调制解调及编码解码，满足高速数据传输与实时通信需求。
- S5000C通用处理板卡：搭载FT5000C/32核处理器，双精度浮点计算峰值性能可达1TFlops@2.3GHz，具备成熟的软件生态和高性能计算能力，适用于雷达信号处理、数据处理、电子对抗等高性能信息处理场景。

上海临滴科技有限公 16C03



LPS Orin Nano & NX 车控主机



LPS3576 车控主机

产品介绍：

- LPS Orin Nano & NX 车控主机：LPS Orin Nano & NX车控主机基于NVIDIA Jetson芯片平台设计。机身采用全铝材料，无风扇设计以及创新的内部结构组合， CPU和PMU等主要发热器件能够高效导热到外部铝材壳体，将整个机身壳体作为散热材料。该设计让LPS Orin Nano & NX能够在更为严苛的工作环境下表现出色，在多种车载、工业场景等中得到广泛应用。
- LPS3576 车控主机：LPS3576是基于瑞芯微RK3576芯片平台设计的一款车控主机，采用8nm工艺制程，具有低功耗和高算力的特点。集成了四核Cortex-A72和四核Cortex-A53 CPU，主频最高可达2.2GHz，并配备了6TOPS算力的NPU，支持多种深度学习框架和AI算法的高效运行。支持多种视频编解码能力，如4K@120fps的H.265解码、4K@60fps的H.264编码等，适用于车辆的AI应用场景。

广州立功电子科技有限公司 16C25



产品名称：解决方案

产品介绍：

立功科技聚焦芯片增值分销、软硬件定制解决方案两大核心业务，具备完整的工业、汽车电子全链条方案能力，可面向多行业客户提供从器件供应到软硬件一体化的综合技术服务。

>>回目录页

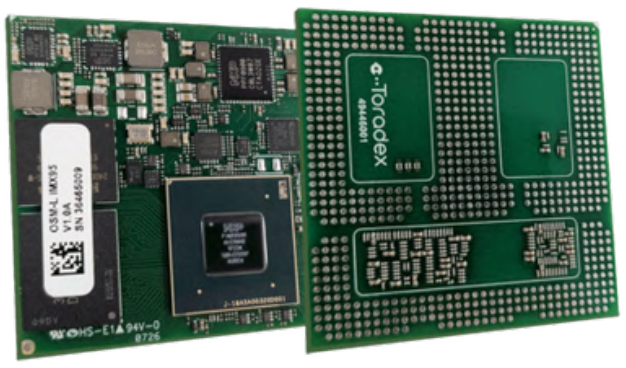
领取参观证件

展前预览——嵌入式展区

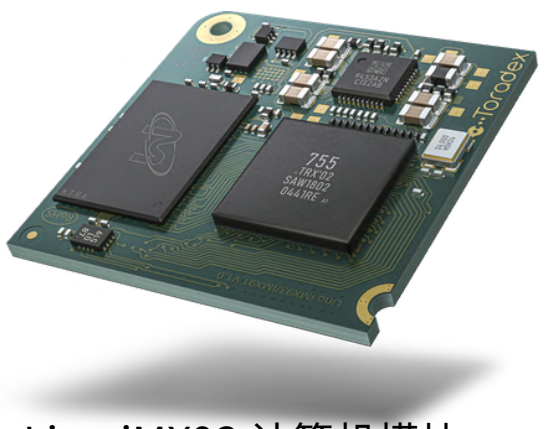
>>回目录页

扫码登记参观

韬睿（上海）计算机科技有限公司 16A06



OSM iMX95 计算机模块



Lino iMX93 计算机模块



Rockchip RK3568J 计算机模块

产品介绍：

- OSM iMX95 计算机模块：NXP i.MX 95 计算机模块 OSM iMX95， 采用了可焊接的OSM 外型封装，搭载6个高性能 ARM Cortex-A55核心，具备2 TOPS NPU, 内置安全防护，面向大规模生产的工业可靠应用领域。
- Lino iMX93 计算机模块：Lino iMX93 计算机模块，专为超紧凑、高能效边缘设备而设计。为空间受限（30x30mm）的工业应用提供可靠的性能，并可选配 AI 加速功能。
- Rockchip RK3568J 计算机模块：Toradex 为基于 Rockchip® RK3568J 处理器的 Verdin RK3568J 模块提供嵌入式 Linux 的免费支持与维护服务, 具备现代化且面向未来的接口、先进的图形与视频处理，集成AI加速，灵活的双以太网，这款嵌入式处理器模块可以涉及广泛的应用领域。

深圳市晟天维科技有限公司 16B06



床旁信息娱乐终端



车载智能显示终端(V7S)



车载智能显示终端(M876)

产品介绍：

- 床旁信息娱乐终端：抗菌易清洁的外壳设计,前面板防护等级为IP65;RK3576 + 4GB/8GB DDR+64/128/256GB eMMC;15.6"/21.5"1920×1080 TFT-LCD面板，支持10点触摸;安卓15操作系统;支持WiFi,蓝牙5.0无线模块，支持4G LTE;支持千兆以太网,支持UPOE+,POE+;内置16MP 前置摄像头;可选阅读灯;支持按键话机扩展,支持VOIP语音呼叫;内置RFID读卡器模块,支持接触式和非接触式读取;支持VESA 100mm x 100mm和75×75mm安装;
- 车载智能显示终端(V7S)：坚固耐用的外壳设计，防护等级 IP65;RK3568 处理器，2.0GHz;4GB DDR+32GB eMMC;7寸1024*600 ，支持高亮，支持多点触摸;Android 14 操作系统;内置 200 万像素 CMOS 前置摄像头，内置立体声扬声器;内置 4G LTE、WiFi、蓝牙、GPS+北斗;内置及扩展 I/O 接口：USB 3.0、SIM、TF卡槽;丰富的I/O接口: RJ45、 RS232、RS485、倒车触发、CAN Bus、AV/AHD输入、ACC、倒车、GPIO等;
- 车载智能显示终端(M876)：8英寸阳光下可视显示屏，亮度高达1000;RK3576处理器，四核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53，2.2GHz;4GB/8GB DDR+64/128/256GB eMMC;Android 15操作系统;内置 500MP 前置摄像头，1600MP后置摄像头;内置WiFi、4G LTE、蓝牙、GPS+北斗导航系统、NFC;支持最多4路AHD摄像头实时视频输入;丰富的I/O接口: GPIO、RS232、RS485、RJ45和CAN Bus;IP65防护等级;

>>回目录页

领取参观证件

芯驿电子科技（上海）有限公司 16A49



特斯拉 Model Y 电子后视镜



AXVU13F 开发板



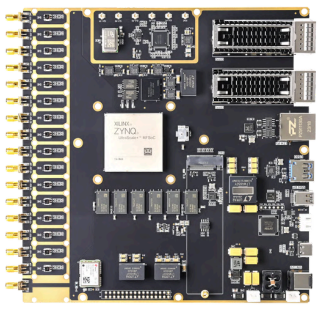
HEA13 开发板

产品介绍：

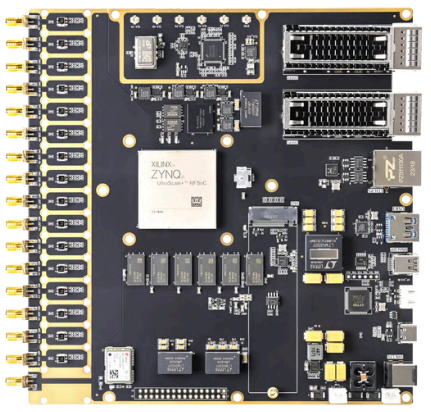
- 特斯拉 Model Y 电子后视镜：是一款车规级CMS电子后视镜，适配特斯拉Model Y，符合GB15084、UN-R46、ISO26262 ASIL D安全标准，分焕新升级版和赛博旗舰版。整套由防水广角摄像头、折叠机构、FPGA视觉主机、车内防眩显示屏组成，端到端延迟≤40ms，140dB HDR成像，-40~85°C稳定工作，视野为传统后视镜2-3倍。搭载BSD盲区预警、转向/倒车视野自动切换、雨雪夜视增强功能，无损对接原车CAN总线。
- AXVU13F 开发板：AXVU13F FPGA 开发板，配备 AMD/Xilinx Virtex Ultrascale+ 系列设备，集成 4 个 FMC+ 接口，兼容多种 FMC 板（数据采集、电机控制、显示摄像头接口、软件定义无线电），为用户提供了功能齐全的测试和验证平台提供高速通信（100G QSFP28+、FMC+）和高速存储（SODIMM，M.2）视频应用（DP）。
- HEA13 开发板：HEA13 FPGA 开发板集成了 AMD（Xilinx）Virtex Ultrascale+ XCV13P FPGA 与 NVIDIA Jetson AGX Orin/Thor 模块，并通过 PCIe Gen3 x8 互联。ACVU13核心板配备20GBDDR4和四个QSFP28（100G）接口。AGX Orin模块可实现高达275 TOPS（最高百分点）的人工智能性能，而Thor模块则有令人印象深刻的2070 TFLOPs。该平台非常适合机器人技术、自动驾驶、边缘人工智能和数据中心加速等领域的应用。

璞致电子科技（上海）有限公司 16A20





FPGA开发板





软件无线电

产品介绍：

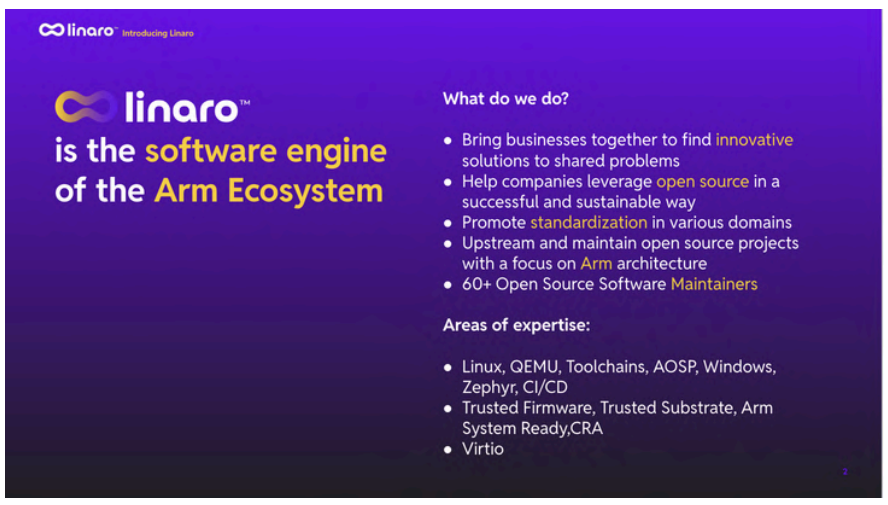
- FPGA开发板：璞致Virtex UltraScale + 旗舰 FPGA 整机开发板，核心采用 XCVU13P 工业级芯片，核心板 + 底板分体式架构，超大逻辑算力、海量 DSP 运算单元、搭载 76 路 GTY 高速收发器、16GB DDR4 缓存，板载 4 路 100G QSFP28 光口、多路 FMC 扩展接口与 PCIe接口。整机经过老化稳定性测试，算力充沛、高速互联能力突出，适用于雷达基带处理、100G 高速通信、多通道射频信号处理、芯片原型验证、高速数据记录回放等工程开发与设备搭载场景。
- 软件无线电：P047PRO 是璞致电子 工业级射频 SoC 软件无线电整机，搭载 XCZU47DR 射频 SoC 芯片，标配8 发射 8 接收射频通道，ADC 最高 5GSPS、DAC 最高 9.85GSPS。产品大功率散热、电源降噪、接口防雷防静电，整机出厂高温老化测试，稳定性更强。配备双 QSFP28 光纤、大容量内存存储、时钟同步接口，支持 PYNQ 快速开发、FPGA 逻辑开发、GNU Radio 适配。多用于相控阵雷达，MIMO 通信原型、信道仿真、射频信号侦收回放、科研项目与外场设备使用。

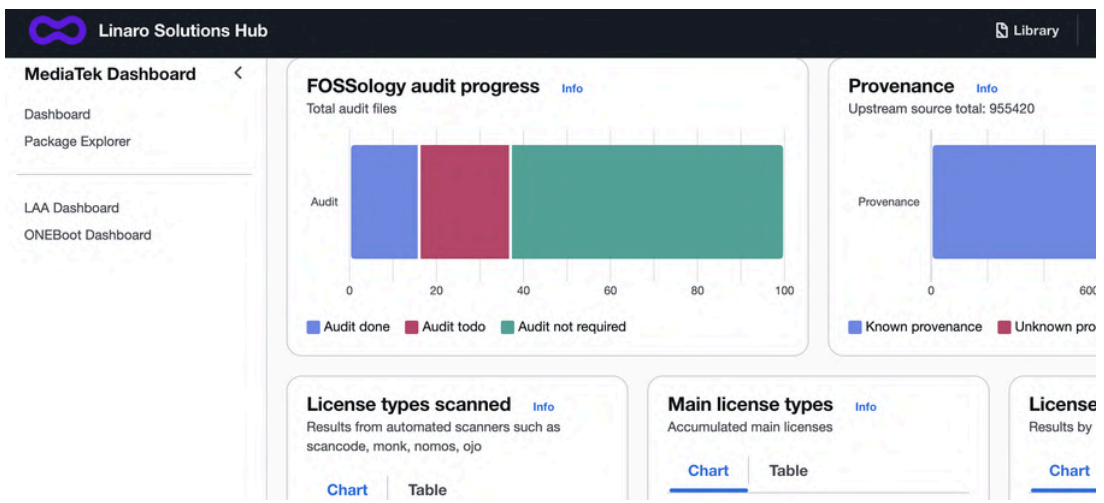
>>回目录页

领取参观证件

Linaro Ltd

16D17





产品名称：Linaro：驱动 Arm 生态的软件创新引擎

产品介绍：

>>回目录页

领取参观证件

作为全球领先的 Arm 软件工程服务商，Linaro 汇聚 60 余位活跃开源核心维护者，长期携手 Arm、Huawei、Google、Qualcomm、Microsoft 等巨头，主导 Linux 内核、虚拟化、工具链及 WoA 等关键领域的演进。依托深厚的上游基因，帮助企业大幅缩短产品上市周期，并化解长期维护难题。面对欧盟 CRA 对网络安全与供应链管理的新规，Linaro 推出端到端软件供应链合规方案。该方案践行“安全内建”理念，将自动化 SBOM 生成、持续 CVE 扫描、许可证合规审计及 CI/CD 实时监控深度融入开发流程，把复杂的法规遵从转化为可持续的工程实践。







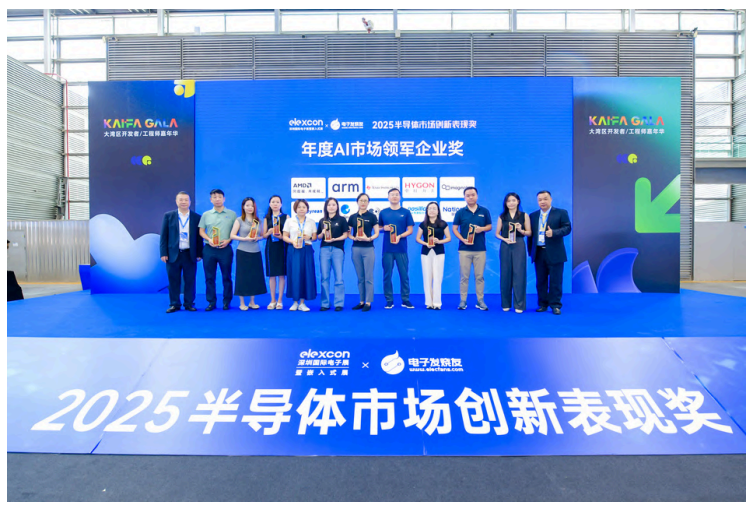












上海贝岭股份有限公司 16E03



MEDS92630



BLG3040



BL1082

产品介绍：

MEDS92630 是一款车规级3通道线性LED驱动器，具有模拟和PWM调光控制，40V输入耐压，由基准电阻器设定的可调恒定输出电流，每通道最大150mA。

BLG3040：其产品的独特优势：器件的全面故障检测和内置保护使其成为可达到中等功率范围的可变强度汽车LED照明应用的理想选择。可广泛应用于尾灯,日间行车灯、驻车灯、雾灯、位置灯、车内照明等领域。

BLG3040是一款内部集成自钳位双向稳压二极管的专用车规级IGBT芯片，具有导通压降低、阈值电压VTH低、击穿电压高、自钳位开关能量高、结温高及ESD耐受能力高等特点。

BL1082：8通道16位200KS/s同步采样SAR ADC芯片

BL108X系列典型产品包括：BL1081/1082 8通道同步采样16位200KS/s模数转换芯片以及BL088 16通道同步采样16位1MS/s模数转换芯片等。其中BL1081/1082集成了8通道模拟前端、1个16位2MS/s的高速SARADC核、超低温漂基准源及缓冲器、数字降采样滤波器，以及并行/串行数据接口。可广泛应用于工业控制、电力保护、轨道交通、自动化测试等领域。

深圳市京泉华科技股份有限公司 16E25



产品名称：中频变压器

产品介绍：

SST中，对SST系统起到绝缘隔离、变压、功率调节功能。

主要应用于智能电网、新能源发电、储能系统、电动汽车充电设施、数据中心供电、轨道交通及偏远地区微电网等高技术要求场景。

台懋半导体（无锡）有限公司 16D01



产品名称：MOSFET（MOS 管）

产品介绍：

信母公司台懋科技 1988 年在中国台湾创立，深耕中低压 MOSFET 领域三十余年。

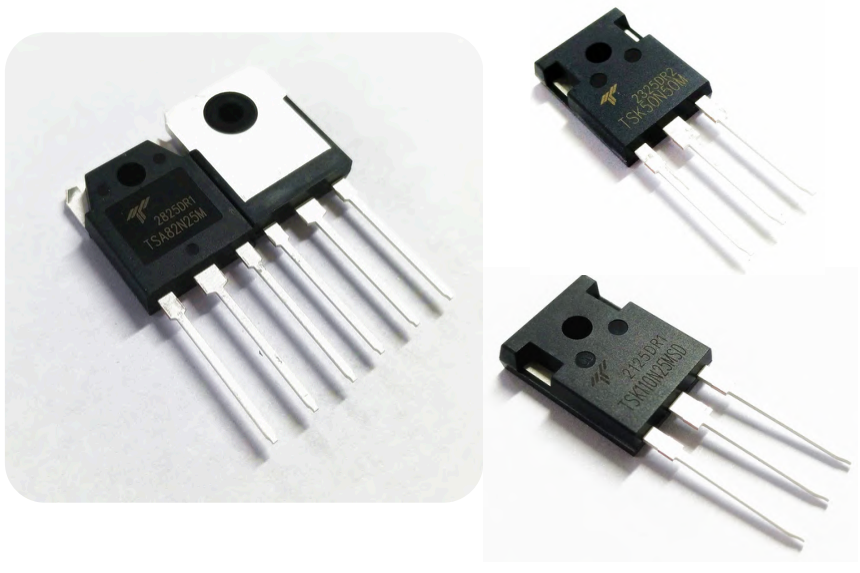
主营各类中低压 MOS 管，配套自有晶圆、封装测试产线，可供应标准现货并支持定制开发，产品适配快充、消费电源、电机驱动、工控设备等场景。

展前预览——功率与电源

>>回目录页

扫码登记参观

深圳市信安半导体有限公司 16A48



产品名称：场效应管

产品介绍：

Truesemi信安半导体，专做中大功率MOSFET。电压段：100V-900V，电流：可达180A。

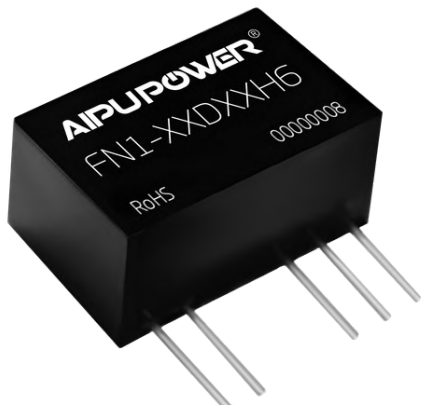
优势应用：光伏、储能、逆变、音响功放、舞台灯光、电焊机、大功率电源等行业。

用“芯”替代国际大牌：性能相当，品质稳定，交期更快，成本更优。让您的产品在全球市场中更具竞争力。

愛浦(香港)電子科技有限公司 16D36



NN2-XXSXXANT



FN1-XXDXXH6



BK40-650SXXW2N4



BK25-500SXXH1N4

产品介绍：

- NN2-XXSXXANT：定电压输入，隔离非稳压单路输出，功率 2W;可持续短路保护；工作温度范围 -40°C to +105°C；小型 SMD 封装，国际标准引脚方式；隔离1500VDC;最高效率可以达到 86%
- FN1-XXDXXH6：定电压输入，隔离非稳压输出，输出功率 1W；转换效率高达 83%；小型 SIP 封装；隔离电压 4200VAC 或 6000VDC；工作环境温度：-40°C～+85°C；塑料外壳，满足 UL94-V0 要求
- BK40-650SXXW2N4：输入电压范围：200-1200VDC（6:1）；输入具有防反接保护、欠压保护；输出具有过流、过压、短路保护；输入与输出隔离 4000VDC；高效率、高可靠性、低纹波噪声； 应用于光伏发电及高压变频；工作温度：-30°C- +70°C；工业级产品技术设计，国际标准体积；转换效率：84%（典型值）
- BK25-500SXXH1N4：超宽超高压范围输入 100-1000VDC（10:1）；输入防反接，输出过压、短路保护； 输入空载电流低至 1.0mA； 输入输出隔离 4000VDC； 输出效率高达 85%； 应用于光伏发电及高压变频

万芯半导体（宁波）有限公司 16D26







产品名称：功率器件、晶圆、电池保护板

>>回目录页

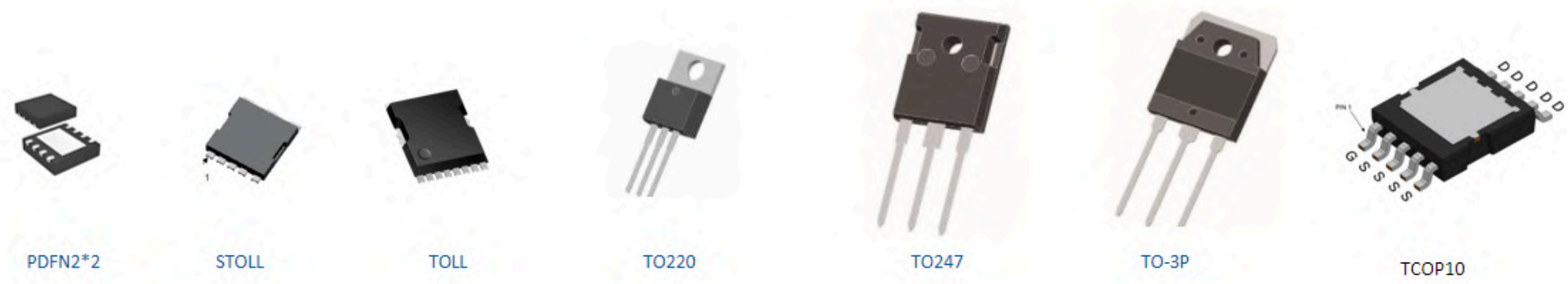
领取参观证件

产品介绍：

主营功率器件，应用于多个场景，如储能、电机、电源等，主推料有WX075N02DP、WX060N10KD、WX012N10LL 、WX070P02SS 、 WX042AN03KD、WP4618、WP3026、WP7N65FA、WP3400SS 、WP3400S3 、WP3401SS 等。

南京江智科技有限公司 16B22



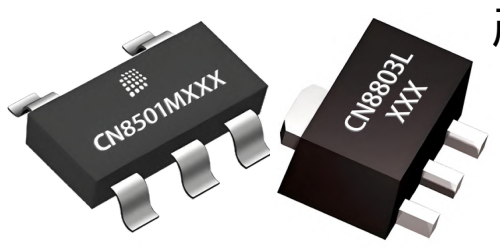


产品介绍：

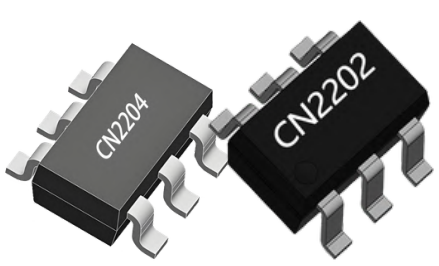
主要产品：

工规、车规 功率MOS、IGBT、SIC MOS、SJ MOS、小信号 MOS、二极管、ESD、TVS、三极管、同步整流器件等。 公司产品种类、规格齐全，用户遍布汽车电子、手机、笔电、平板、机顶盒、电动车、安防、小家电、智能终端、手持终端、电动工具、BMS储能等行业。

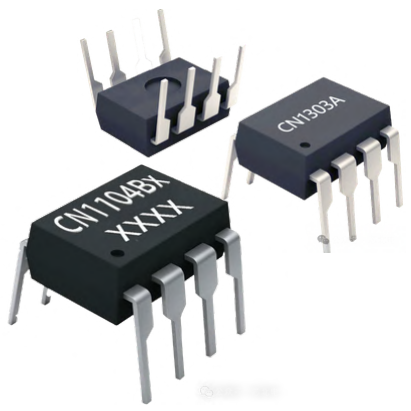
芯北电子科技（南京）有限公司 16A13



LDO线性低压差稳压器



DC-DC电源管理芯片



AC-DC开关电源芯片

产品介绍：

- LDO线性低压差稳压器：CN8501是一款以CMOS工艺制造的超低静态功耗、低压差线性稳压器。稳压器消耗电流约0.8uA，使能关断后功耗为0.01uA（典型）。内置使能控制，输出放电，短路保护，热关断功能，提供SOT89-3、SOT23-5、SOT23-3封装。CN8803L是一款宽电压输入高精度的低压线性稳压器，可提供150mA的输出电流。具有短路保护、过流保护和过热保护功能。 CN8803L提供SOT23-3/5、SOT89-3、DFN2X2-6等多种封装，满足高密度PCB布局与散热要求。
- DC-DC电源管理芯片：CN2204TER是一款高效DC-DC同步降压转换器，具有1A连续输出电流能力。它具有5.5V至38V的宽输入电压范围，适用于从非稳压源进行电源调节的各种应用。CN2204TER集成了主电源开关和具有低RDSON的同步整流开关，可最大限度地降低导通损耗。CN2204TER还具有超低静态工作电流，在轻负载下采用PFM模式，可在整个负载条件范围内获得高效率。 CN2204TER还采用逐周期电流限制、打嗝OCP和输出短路保护以及OVP和热关断功能。 CN2204TER采用SOT23-6L封装。
- AC-DC开关电源芯片：CN1303A集成了PWM控制器和1200V高压MOSFET，用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。CN1303A内置高压启动模块。内置的抖频功能。CN1104BC/D是一款面向工业与电力场景的高性能宽电压输入AC-DC转换器，芯片内置1500V耐压功率MOSFET与PWM控制器，搭载高压启动电路实现超低待机功耗。它采用次级反馈（SSR）架构，输出稳压精度高、负载动态响应特性优异，通过PWM/PFM/Burst混合调制技术实现全负载范围效率优化，搭配集成抖频设计大幅简化系统EMI调试难度

领取参观证件

>>回目录页

展前预览——功率与电源

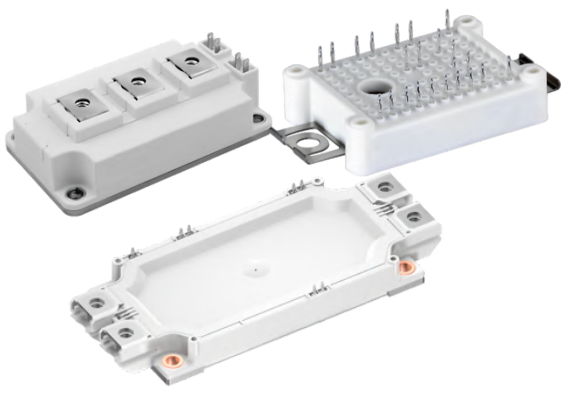
>>回目录页

扫码登记参观

深圳市芯控源电子科技有限公司 16D49



碳化硅MOS/碳化硅肖特基二极管



IGBT模块



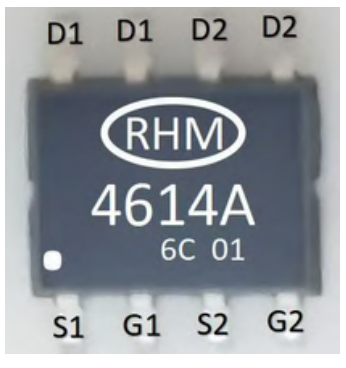
场效应管

产品名称：MOSFET（MOS 管）

产品介绍：

- 碳化硅MOS/碳化硅肖特基二极管：碳化硅（Silicon Carbide，SiC）是一种由硅（Si）和碳（C）组成的宽禁带半导体材料，具有高硬度、高导热性、耐高温、耐腐蚀等优异特性，广泛应用于电力电子、射频通信、光电子、工业制造等领域。核心产品有SiC二极管（肖特基势垒二极管，SBD）：低导通损耗、超快开关速度（纳秒级），适用于高频整流电路；SiC MOSFET：耐压高达
- IGBT模块：IGBT器件电流密度高且功耗低，能够显著提高能效、降低散热需求，适用于高电压、大电流等大功率场景。
- 场效应管：MOSFET管是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管，在大功率半导体领域，各种结构的MOS管更是发挥着不可替代。芯控源电子（AGMsemi)的MOSFET管采用国际前端先进工艺，真空烧结，载流量大，导热性能好，热阻低，绝缘耐压高，每个产品质量都经过了严格考验，性价比高。

深圳市荣和美科技有限公司 16C85







产品名称：4614系列

产品介绍：

应用于三相无刷电机，满足不同等级需求





>>回目录页

领取参观证件

展前预览——电子元器件

>>回目录页

扫码登记参观

深圳市宇阳科技发展有限公司 16A45

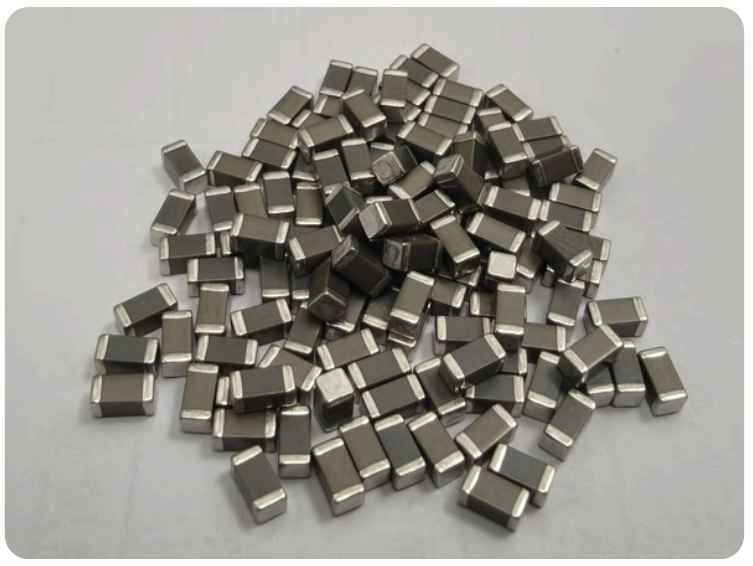


产品名称：片式多层陶瓷电容器

产品介绍：

作为国内MLCC(片式多层陶瓷电容器)行业主要研发生产企业，宇阳科技自2001年成立以来，一直大力投资研发MLCC产品技术，率先在国内推出多款具有国际先进水平的MLCC产品，填补国内空白，推动和提升了国内MLCC技术和产业化水平，为国家基础电子工业发展做出重要贡献。

江苏芯声微电子科技有限公司 16C13



积层陶瓷贴片电容

产品名称：片式多层陶瓷电容器

产品介绍：

- CSA通用型：良好的温度特性，高电容量低损耗。元件结构简单，由诱电体以及内部电极相互积层的表面贴装（SMD）产品。单片式结构保证较优的机械强度和低ESR，ESL，频率特性良好。
- CIA工业级：具有可靠性高与较优的机械强度。跟其他种类电容相比具有更低的ESR，ESL，频率特性良好。可靠性高的需求下，适合室外及工业需求应用。
- CAI汽车级：汽车中使用的包含电容在内的元器件与一般消费电子有所不同，汽车上使用的电子元器件会有相对较高的质量指标要求，对产品性能和稳定性有严格的要求。

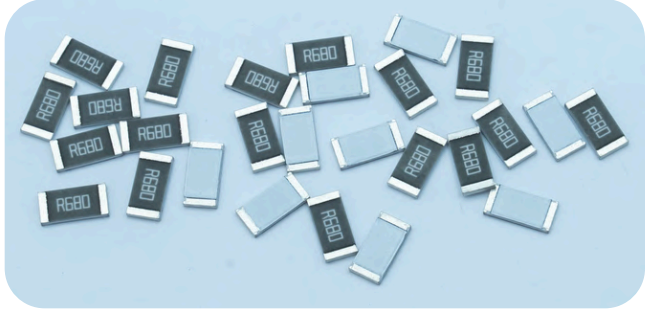
>>回目录页

领取参观证件

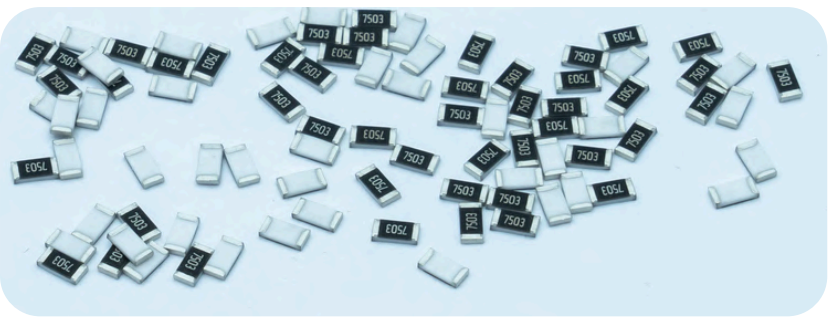
厚声国际贸易（昆山）有限公司深圳分公司 16A15



合金分流电阻器



高精度薄膜晶片电阻器



车规级晶片电阻器

产品介绍：

- 合金分流电阻器：合金分流电阻器采用特种电阻合金制成，具备低温漂、高精度，用于电路电流采样，广泛应用于储能、新能源、工业电源等大电流场景
- 产品采用精密薄膜溅射技术，电阻层采用高纯度合金靶材溅射而成，膜层结构致密，离子间排列有规则，具有良好的高精度薄膜晶片电阻器：温度稳定性及噪音系数、可靠性高，产品可广泛应用于医疗器材、精密测量仪器、通讯及精密工业控制设备中。
- 车规级晶片电阻器：电阻采用高精密厚膜印刷技术制造，特殊的材料和生产工艺生产而成。通过特有的产品设计及制作工艺, 使产品具有极好的耐高电压性能, 耐高电压特性是常规厚膜产品的2 倍多, 可减小电路板的安装空间及节约产品成本，同时可有效降低设备的最终尺寸。且产品具有优异的耐腐蚀性能和抗硫化能力，广泛应用于汽车电子、仪表、矿山机械、农场设备及含硫环境的仪器中。

功得电子工业股份有限公司 16D13



轴向引线和管状保险丝



表面贴装式保险丝 - LTCC贴片式保险丝



电力保险丝

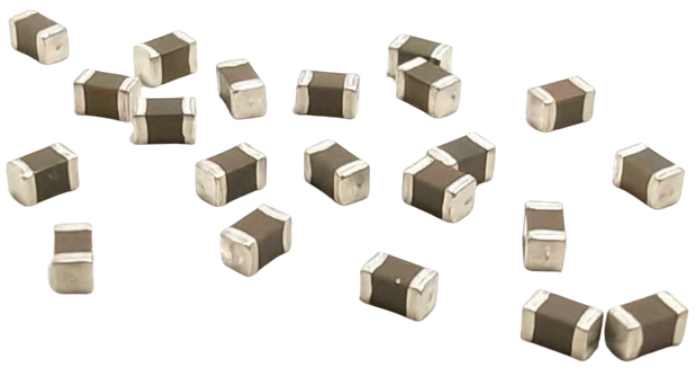
>>回目录页

领取参观证件

产品介绍：

- 轴向引线和管状保险丝：适用于各行各业- 从消费电子产品和通信到家用电器和照明装置。保险丝规格随电流/电压额定值、分断能力、I2t 值、时间电流曲线和安全认证不同而变化，从而确保为各类行业应用提供完善的电路保护。
- 表面贴装式保险丝 -LTCC贴片式保险丝：LTCC结构包含有耐热性极佳、启断额定值很高的保险丝元件，因而此类保险丝能够承受高强度冲击电流。熔断时间精确，可为敏感型电子元件提供终极防护。利用回流焊接工艺将表面贴装式设备结构直接附加在印刷电路板上。LTCC保险丝能够有效兼容各种电路设计。
- 电力保险丝：功得电力保险丝 I2t 值较低，电压额定值可达1000 V，此款保险丝可有效保护大功率交流和直流电路免受过载和短路影响。每根保险丝均由包含高纯度硅砂的超高强度陶瓷导管组成，提高了工作可靠性，增强了电弧淬灭能力。功得的快断、高耐久性电源保险丝特别适用于带有敏感型内部元件的应用设备，包括PV系统和电动车电池充电器。

信维电子科技（益阳）有限公司 16A30



产品名称：片式多层陶瓷电容器

产品介绍：

MLCC 全称多层陶瓷电容器，又叫片式多层陶瓷电容、独石电容，属贴片被动元器件，稳压、滤波作用突出，被称作 “电子工业大米”。

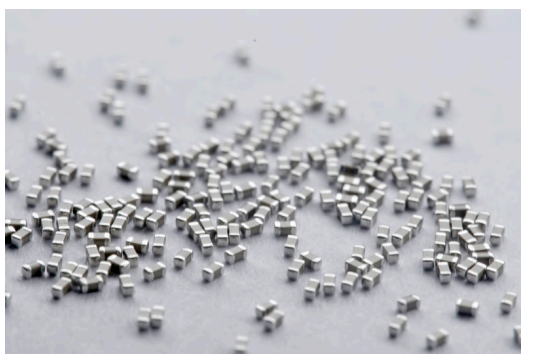
结构上由陶瓷介质与内电极交替叠压烧结，两端加装金属外电极，适配电路板表面贴装工艺。

应用覆盖面极广，手机、计算机、穿戴设备、AI 服务器、通信基站、电源、智能家居、医疗仪器、数据中心等各类带电信号电子产品均有搭载。

广东微容电子科技股份有限公司 14A60





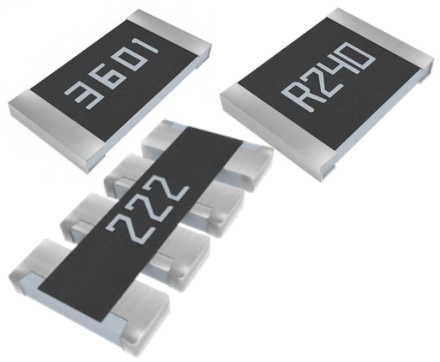


产品名称：贴片陶瓷电容器

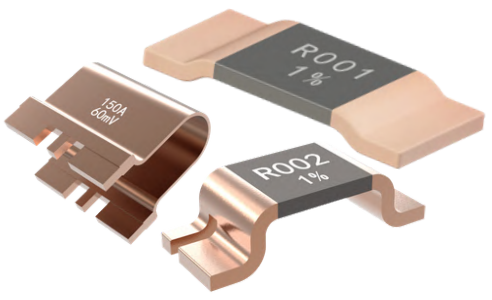
产品介绍：

依托完整自研制造平台，公司在高容量、车规级、高频、超微型等高端MLCC 领域实现全面技术突破：通用高容量产品容值最高可达220μF，并持续向更高容值迭代升级；超微型系列（008004/01005/0201）及射频系列产品已成为行业主流方案，出货量常年位居全球前三；车规级产品覆盖 0201 至 1210 全尺寸，具备高容量、高可靠、耐高温、高稳定性等优异特性。广泛应用于AI 服务器、汽车电子等关键领域.

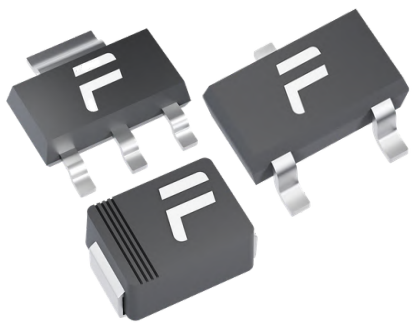
安徽省富捷电子科技有限公司 16A17



贴片电阻



合金采样电阻



半导体分立器件

产品介绍：

- 贴片电阻：富捷贴片电阻涵盖厚膜、薄膜、车规、抗硫化、合金等全品类矩阵，尺寸覆盖01005至2512，阻值范围1Ω至100MΩ，精度最高可达±0.05%，TCR低至±10ppm/°C。产品线包括FRC常规厚膜系列、FRH高精度系列、FRP高功率系列、FRS抗浪涌系列、FRV高压系列、FRQ车规系列及FRR抗硫化系列等，抗浪涌系列采用纳米级浆料与多层复合结构设计，可有效抵御静电冲击与瞬时浪涌；车规系列通过AEC-Q200认证，工作温度范围-55°C至155°C。富捷贴片电阻广泛应用于新能源汽车、工业控制、家电、医疗、通信等领域。
- 合金采样电阻：富捷合金电阻以镍铬、锰铜、卡玛等合金为基材，采用电子束焊接等先进工艺制造，具备低电感、低热电动势、低温漂等特性，温度系数可低至±10ppm/°C。产品涵盖FRM低阻值合金系列、FPM高功率系列、FCM电子束焊系列、FWK四引脚开尔文系列、FCS大电流分流器系列等，阻值最低可至0.5mΩ，精度最高达±0.5%。合金电阻额定功率覆盖2W至36W，可承载大电流，适用于新能源汽车BMS电流检测、工业变频器采样、储能系统分流等强电场景。全系列通过AEC-Q200车规级可靠性测试，在-55°C至170°C宽温范围内稳定工作。
- 半导体分立器件：富捷半导体分立器件构建了“三极管、二极管、MOSFET、IC集成电路”四大核心产品线。三极管涵盖通用、开关、高压、功率、数字晶体管等六大类，封装形式包括SOT-23、SOT-89、SOT-323等。二极管包含普通整流、肖特基、稳压、超快恢复等类型，工作电压覆盖20V至5000V，封装涵盖SOD-123、SOD-323等。MOSFET产品线涵盖Planar MOS、Trench MOS、SGT MOS、SJ MOS四大系列，具备内阻低、栅电荷少、开关速度快、反向恢复特性优异等核心优势，适配电源管理、电机驱动等高效能场景。IC产品线包括LDO、DC-DC转换器等电源管理芯片。

深圳市科达嘉电子有限公司 16D21



紧凑型大电流电感CSBA系列



超级大电流电感CPCFA系列



超级大电流电感CPEX-LV系列

产品介绍：

>>回目录页

领取参观证件

- 紧凑型大电流电感CSBA系列：CSBA系列采用科达嘉自主研发的低损耗金属磁粉芯材料，具有优异的软饱和电流特性与极低的直流电阻；磁屏蔽结构设计，电磁兼容性能优异，可显著抑制高频电磁干扰（EMI）辐射。采用轻薄型设计，适合高密度贴装。在AI服务器电源或新能源设备中，其大电流处理能力和高频适应性能够支持高功率密度的电源设计。
- 超级大电流电感CPCFA系列：CPCFA系列采用扁平线绕组，低阻抗、高饱和、低温升。闭合磁路设计，能有效减少电磁辐射和传导干扰，提升电磁兼容性。该系列电感值和直流偏置能力受温度影响小，具有高稳定性。可广泛应用于DC-DC转换器、大电流开关稳定器、光伏逆变器、工业控制、新能源等领域。
- 超级大电流电感CPEX-LV系列：CPEX-LV系列采用科达嘉自主研制的低损耗磁粉芯材料和扁平线圈设计，具有极低的直流电阻和磁芯损耗。产品具有优异的软饱和特性，能够承受更高的峰值电流。饱和电流最高可达126A，温升电流高达120A，适配小体积、高功率密度的设计需求。耐压高达1500Vac，可广泛应用于DC-DC转换器、大电流开关稳压器、服务器电源、光伏逆变器、高压传动设备、汽车HVDC 800V高压平台等诸多高压大电流领域。

展前预览——电子元器件

>>回目录页

扫码登记参观

岑科科技（深圳）集团有限公司 16E15-A2

领取参观证件



磁胶电感



POC电感

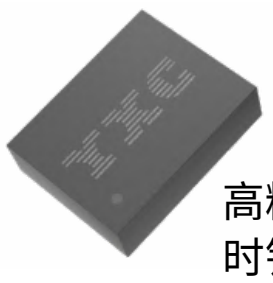


POC电感

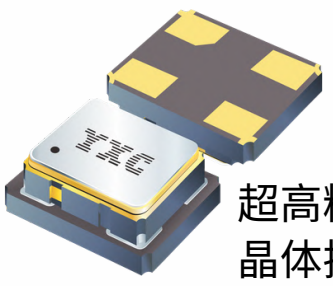
产品介绍：

- 磁胶电感：属于绕线式 SMD 贴片功率电感；先完成线圈绕制，再在外部涂覆填充磁性胶（磁粉 + 环氧树脂），形成磁屏蔽层，不是高温高压粉末压铸，和一体成型电感工艺有本质区别。消费电子为主，也有部分工业、车载辅助电源
- POC电感：一体成型电感是功率储能电感；PoC 电感是信号滤波电感，用于车载 ADAS 摄像头，不是做 DC-DC 储能用。单根 Fakra 同轴电缆，同时传输直流供电 + Gbps 高速视频信号（GMSL2/GMSL3/LVDS），省去单独电源线，简化车载线束、减重降本。
- POC电感：一体成型电感属于贴片功率电感，采用压铸模压工艺，把预先绕制的线圈完全埋入合金磁粉内部，高温高压压铸成一个完整实体，线圈、磁粉融为一体，引脚直接从绕组引出，是 SMD 贴片器件。

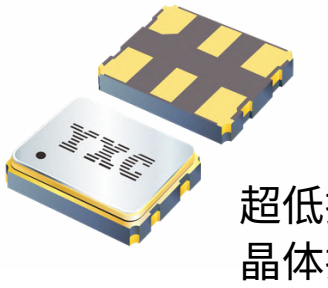
深圳扬兴科技有限公司 16D62



高精度实时时钟（RTC）



超高精度温补晶体振荡器



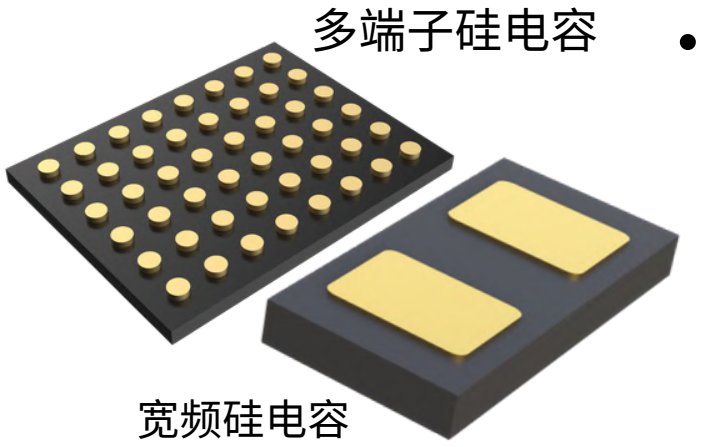
超低抖动差分晶体振荡器

产品介绍：

- 高精度实时时钟（RTC）：集成实时时间、日历、定时及主备电源切换，可在系统断电后持续保持准确计时。计时精度最高可达±3.4ppm@-40°C～+85°C，静态电流低至250nA，，部分型号内置32.768kHz晶体及温度补偿功能，可减少外围器件，提升智能终端、工业设备及物联网系统的计时精度和运行可靠性。
- 超高精度温补晶体振荡器：采用高精度温度补偿技术，可对环境温度变化引起的频率偏差进行有效校正，在宽温范围内保持稳定输出。产品频率稳定度最高可达±0.1ppm，工作温度范围覆盖-40°C～+85°C，相位噪声低至-155dBc/Hz@ 1kHz，适用于高精度定位、卫星通信、惯性导航、激光雷达及精密测量等对频率精度要求较高的应用。
- 超低抖动差分晶体振荡器：面向高速光通信、数据中心及高速数字系统开发的高性能差分时钟产品，具有超低相位抖动、低相位噪声和高频输出等特点。产品最高频率可达2100MHz，RMS相位抖动低至30fs，频率稳定度可达±50ppm，可为200G/400G/800G光模块、高速SerDes、交换机及服务器提供低噪声参考时钟，保障高速数据传输的信号完整性与稳定性。

苏州苏纳光电股份有限公司 16C02

多端子硅电容

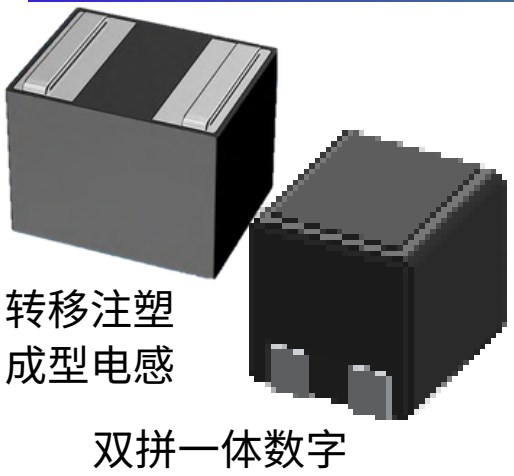


宽频硅电容

产品介绍：

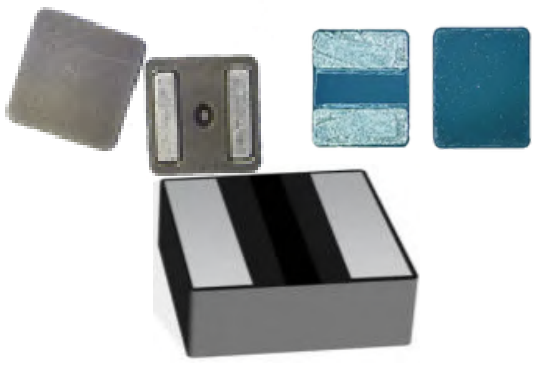
- 多端子硅电容：①极致稳定特性：不受温度、电压、老化工况影响;温容系数（TCC）：0.02%/°C；电压系数（VCC）：5%/V；125°C高温下 TDDB 使用寿命超 10 年；无压电效应，无任何声学噪音。②超低寄生参数；电源分配网络（PDN）优化高端解决方案；容值密度：3μF/mm²；等效串联电感 ESL：＜10pH；等效串联电阻 ESR：＜10mΩ；自谐振频率 SRF：可达 (GHz) 以上。③微米级超高精度；先进封装的理想配套器件；超薄厚度：小于100微米；亚微米级制程精度；可定制多端子结构设计；支持基板内嵌集成。
- 宽频硅电容：高容值密度 2uF/mm²； 稳定性：随温度和偏置电压变化，电容保持高稳定性；超低 ESR ESL等寄生参数；薄型设计灵活贴装：厚度 70 μm。

湖南华晟电通科技有限公司 16C46



转移注塑成型电感

双拼一体数字功放电感



扁线一体成型电感

产品介绍：

- 转移注塑成型电感：采用类似半导体封测工艺的转移注塑成型技术，将线圈与 T-core 外层使用磁性塑封料直接无压一体化封装而成的新型电感器件。转移注塑成型电感是当前 AI 服务器、新能源汽车电子两大高景气赛道的主力配套产品,已成为电感行业技术升级与国产替代的核心主力产品之一。
- 双拼一体数字功放电感：采用低损耗合金磁粉芯设计，具有优异的软饱和特性，能处理高瞬态电流峰值而不饱和；二合一低耦合结构设计，节省安装面积的同时大幅提升信噪比，降低谐波失真，实现高音质和低失真；磁屏蔽结构，抗干扰能力强，可最大限度降低集成式电感器之间的串扰，非常适合作为数字功放的低通滤波电感HUM 数字功放电感值范围 1.0~22.0μH，饱和电流范围4.30~50.0 A。符合AEC-Q200、RoHS、REACH等标准。工作温度：-40°C ～ +125°C (包含线圈发热)。
- 扁线一体成型电感：抗电磁干扰(EMI)性能强，一体成型结构，超低蜂鸣噪音， 低损耗，高效率，符合AEC-Q200、RoHS、REACH等标准，工作温度：-40°C ～ +125°C (包含线圈发热)，广泛应用于汽车电子、AI服务器、工业电源、无人机、智能穿戴、通讯、笔电等领域。

广东德鸿感应微电子有限公司 16D10



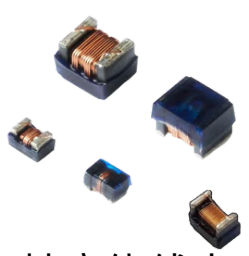
一体成型电感



NR电感



组装屏蔽电感



精密绕线电感



共模电感



开放功率电感

产品名称：贴片电感

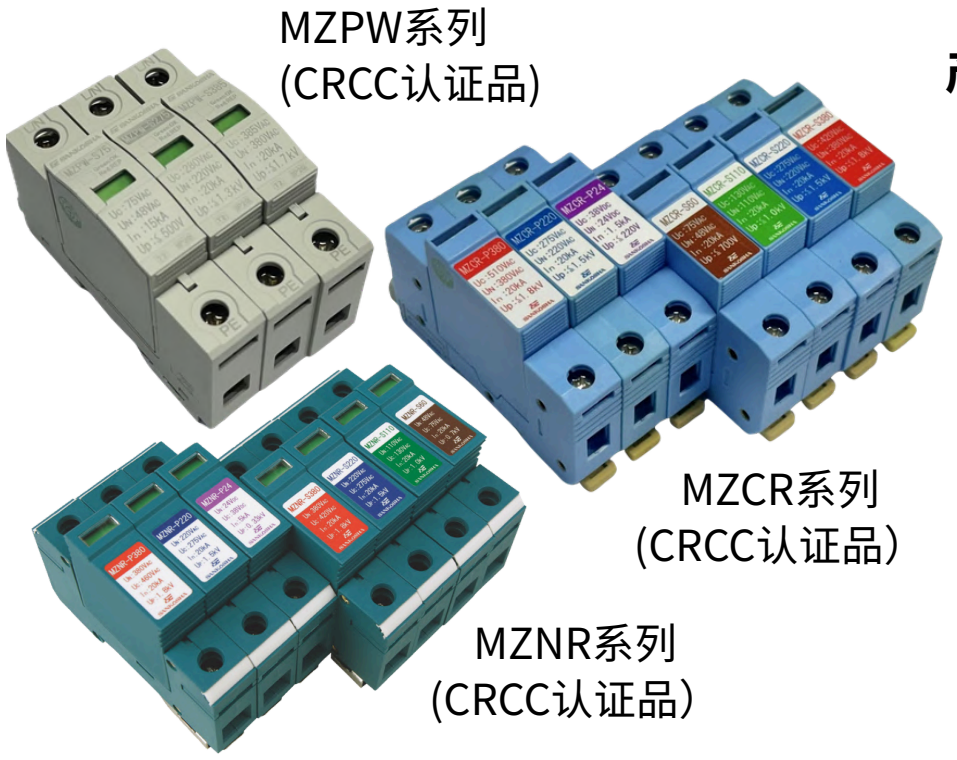
产品介绍：

>>回目录页

领取参观证件

一体成型贴片电感采用铁粉芯一体压铸工艺，整体全屏蔽密闭结构，一体成型无缝设计，具备低磁漏、低阻抗、大电流、高饱和、耐高温、抗干扰、稳定性强等核心优势。产品体积小巧、贴片式安装，适配自动化SMT贴装，焊接性能优良，一致性高，不易磁饱和、不易发热，耐用性远超普通绕线电感。广泛应用于AI算力服务器、工控主板、新能源电源、车载电子、智能家居、通讯设备、LED电源、医疗设备、充电适配器、精密数码产品等各类高端电子电路。

广州圣科萨防雷科技有限公司 16A03



MZPW系列
(CRCC认证品)

MZCR系列
(CRCC认证品)

MZNR系列
(CRCC认证品)

产品介绍：

- MZPW-S385/MZPW-S275/MZPW-S75；本产品是在ZPW-2000的系统铁路信号设备用交流电源用SPD,执行TB/T2311-2017铁道行业标准，保护电源设备免受电源回路中诱导引起异常电压损坏的劣化显示功能电源用SPD。
- 特征：最大放电电流高达40kA(感应雷电波形 8/20μs)；带有劣化显示功能(已连接警告接触输出端子)；插入式，DIN 导轨可安装 (35mm)；圆形压接端子 M5(安装尺寸小于12mm)；
- 应用：低压配电，控制设备中的电源电路 (DC24V/AC220V/AC380V)；低压配电，控制设备中的电源电路 (AC48V/AC110V/AC220V/AC380V)

东莞必德电子科技有限公司 16C08



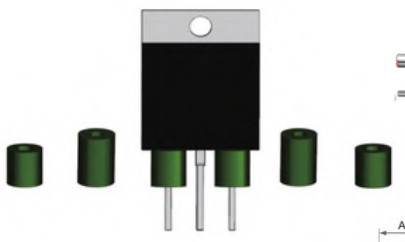
R5H磁珠



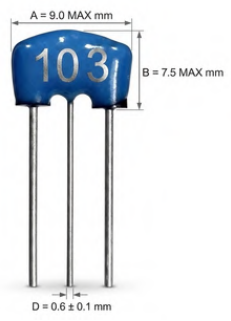
非晶磁珠



插件穿心磁珠



功率电感





插件穿心磁珠

三端子LCL-T型滤波器

产品介绍：

- 贴片磁珠：高密度与大电流场景的高频守护者。 在微型化封装中实现对1MHz以上噪声的高效滤除，尤其适合大电流（IDC≤17A)的电源路径与高密度PCB布局场合。
- 非晶磁珠：低频噪声的终极抑制者。凭借其独特的低频高感量特性，令KHz级的电源纹波与开关噪声无处遁形，实现电源端的深度净化。
- 功率电感：特别适用于需要高效率、稳定高频性能和强功率处理能力
- 插件磁珠滤波器：高频滤波的稳定基石。专为抑制1MHz以上的电路噪声而设计，至今仍是工业与通信设备中高频EMC防护的可靠选择。
- 贴片磁珠滤波器：高密度与大电流场景的高频守护者。 在微型化封装中实现对1MHz以上噪声的高效滤除，尤其适合大电流（IDC≤17A)的电源路径与高密度PCB布局场合。
- LCL-T集成滤波器 (2024)：宽频滤波的微型化突破。 以“一容锁定频率，双珠滤净杂波”的集成拓扑，能从几十KHz至几百MHz的宽频带内实现>40dB 的卓越衰减，在微型尺度上重新定义了LC二阶滤波的效能边界。

中山市汉仁电子有限公司 16C01



BMS变压器



RJ45连接器



网络变压器

产品介绍：

- BMS变压器：确保电池组安全、高效通信的核心组件，设计满足高压隔离、抗干扰及严苛环境适应性等要求
- 网络变压器：支持不同的网速10/100Base-T，1000Base-T，2.5G/5G Base-T，10G Base-T，18G Base-T等，支持PoE，PoE+，PoE++等
- RJ45连接器：支持不同的网速100Base-T，1000Base-T，2.5G/5G Base-T等; 支持内置不同的线路保护功能（ESD, EFT, CDE 等）；支持不同的 PoE （IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt等)

西普尔电子(东莞)有限公司 16C19



产品名称：功率电感、磁珠、共模电感、高频及平面变压器、无线充电发射与接收线圈及相关模块。

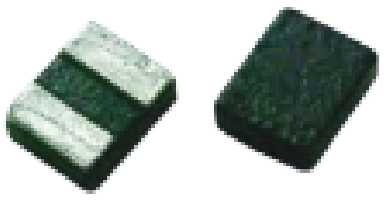
产品介绍：

- 主营业务：磁性元件、EMC电磁兼容元件、高频变压器及无线电力传输解决方案的研发、制造与销售。
- 产品介绍：主要产品包括功率电感、磁珠、共模电感、高频及平面变压器、无线充电发射与接收线圈及相关模块。

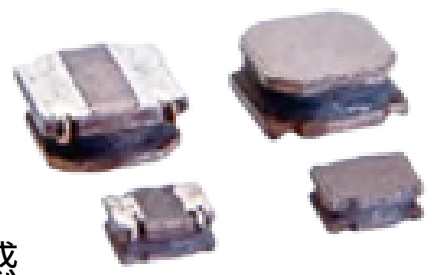
>>回目录页

领取参观证件

广东今凯电子科技有限公司 16C07



PM系列小一体功率电感



NRS 系列合金磁胶功率电感



MD系列一体成型功率电感

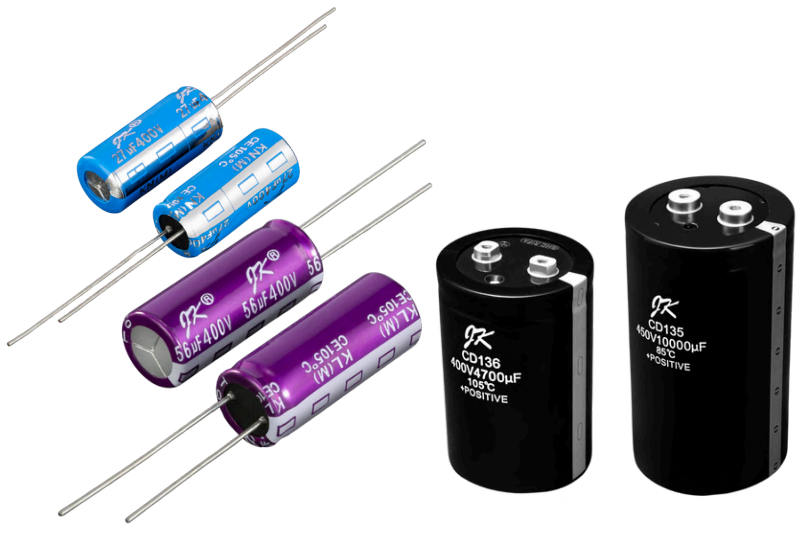


NR 系列磁胶功率电感

产品介绍：

- PM系列小一体功率电感：极低的直流电阻（DCR）；高功率密度；可处理高瞬时电流尖峰；无声音干扰和无泄露磁场。用于CPU/GPU/RAM 等高功率电源的直流-直流转换器； 笔记本电脑、个人数字助理（PDA）等便携式设备；电池供电设备
- MD系列一体成型功率电感：低电阻 大电流；磁粉一体成型压铸工艺；一致性高；广泛应用于各式电源电路中
- NRS 系列合金磁胶功率电感：采用合金磁芯；相比于NR系列拥有更大的额定电流；磁性胶水涂覆结构极大减少了蜂鸣声；直接在磁芯上金属化电极，抗跌落冲击强，经久耐用；闭合磁路结构设计，漏磁少，抗EMI能力强；常用于DC/DC电路
- NR 系列磁胶功率电感：磁性胶水涂覆结构极大减少了蜂鸣声；直接在磁芯上金属化电极，抗跌落冲击强，经久耐用；闭合磁路结构设计，漏磁少，抗EMI能力强；同等尺寸，额定电流特性较传统电感高出30%以上；常用于DC/DC电路

东莞市军康电子科技有限公司 16C28

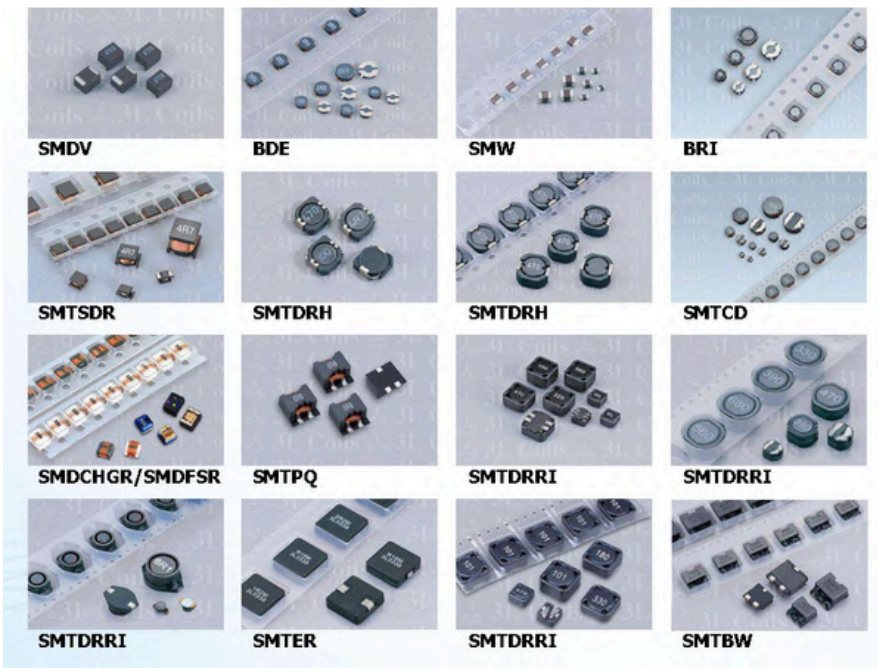


产品名称：铝电解电容器

产品介绍：

- 产品涵盖液态、固态、插件、贴片、焊片及螺栓型等多种类型，全面满足不同应用场景对电容器的性能与结构需求的客户群体。依托三十余年的技术积累与制造经验，军康电子可为客户提供高度定制化的解决方案，支持按需订制各类尺寸、形态、容量及特殊电气特性的铝电解电容器。

武汉三乐益电子有限公司 16A07



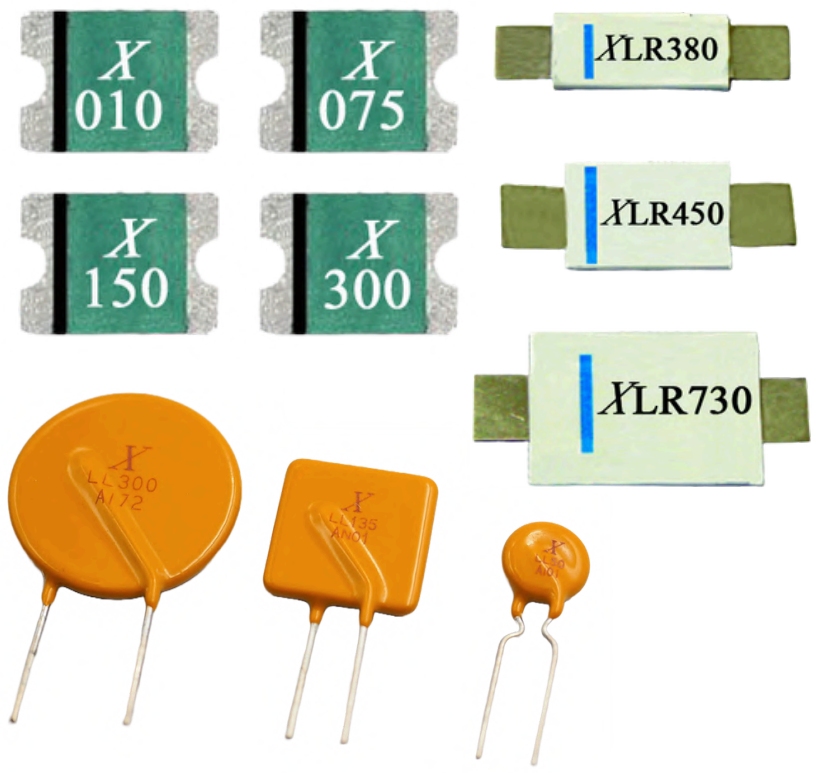
产品名称：

产品介绍：

- 专注于电子磁性元器件的研发、制造与销售，核心产品包括模压功率电感、表面贴装型铁氧体扼流圈、插件类差模和共模电感、变压器、互感器。
- 产品广泛应用于开关电源、DC-DC转换、EMI/EMC滤波、医疗电子、汽车电子、工业控制及消费电子等领域。

领取参观证件

東莞艾芙司電子有限公司 16B03



产品名称：X-Fuse自恢复保险丝(PPTC Resettabe Fuse)

产品介绍：

是由碳黑颗粒和聚合物材料组合成的导电粒子，经过特殊的工艺加工而成。在“正常工作条件”下，装置保持极低的电阻(毫欧姆),允许电流无限制地流过装置。电极和引线接串联在电路两侧以保护电路。当过电流条件出现时，聚合物PTC材料发热，电阻急剧增大。这种急剧增加的电阻(达到绝缘状态)会切断电路中的电流，从而保护电路中的元件和装置。在排除故障电流后，PPTC Resettable Fuse保险丝冷却，其电阻降至原来的极低值。可复位保险丝“复位”允许电流再次流过电路。因PPTC材料之电阻值对热极为敏感，业界亦称之为PTC 热敏电阻。

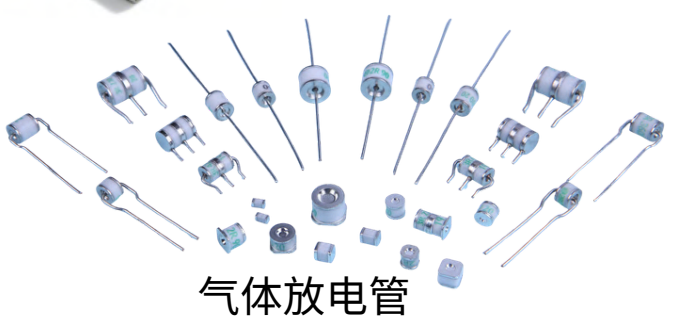
东莞市金华电子有限公司 16D03



高压保险丝



保险丝



气体放电管

产品介绍：

- 高压保险丝：采用高强度陶瓷高压封装结构，耐压等级高、分断能力强，可稳定承受高压瞬时冲击；阻值稳定、灭弧性能优异，不易炸裂，安全冗余度高，适配高压交直流电路，服务器电源，充电桩，广泛用于电力设备、新能源高压端口过载与短路防护。
- 保险丝：采用贴片低阻抗结构，具备优异大电流承载与短路分断能力，有效抵御电路瞬时浪涌冲击；支持SMT自动化贴装，节约PCB布局空间，经过宽温与振动可靠性测试，适配服务器电源，电动工具，无人机大功率直流回路安全过流保护方案。
- 气体放电管：采用密闭陶瓷结构，具备大通流、极间电容低特性，有效泄放雷电浪涌冲击；直流击穿电压规格齐全，绝缘阻抗高，响应速度快，耐反复雷击，适配高频讯号保护，电信户外基站、电源端口多级防雷保护方案。

深圳市灿昇科技有限公司/韩国三和电容有限公司 14A61



产品名称：贴片电容

产品介绍：

- 韩国三和MLCC系列产品，本次展会主要展出：ESD保护系列、C0G高稳定系列、汽车和AI服务器专用的高可靠性系列，还有X8R高温应用系列。
- 这些产品可靠性高、容值覆盖全，全面覆盖汽车、工控、低空及AI服务器相关产业的应用。

>>回目录页

领取参观证件

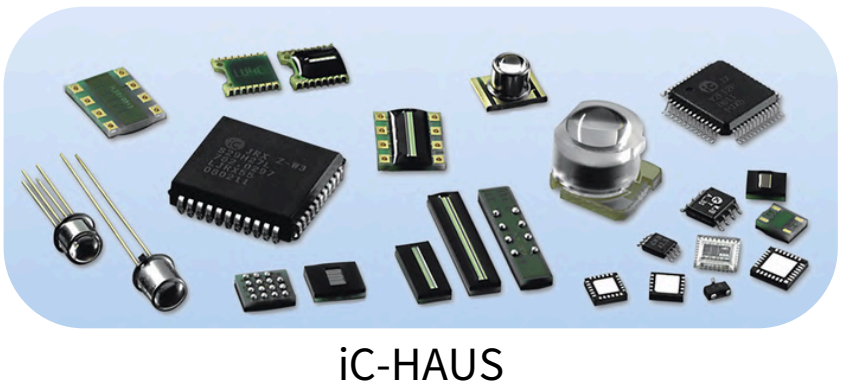
创意电子有限公司 16A43



TE连接器



KOA精密电阻



iC-HAUS



黑金刚铝电解电容

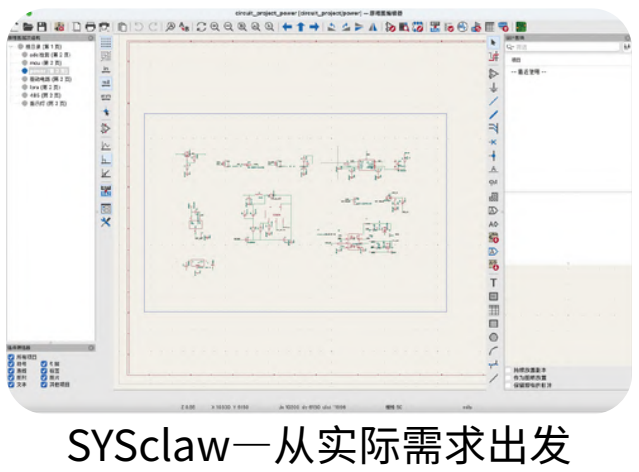
产品介绍：

- 泰科电子五十多年来一直占据行业领先地位，为全球数千种消费类产品和工业产品提供无源电子器件，主要产品包括：连接器、继电器、端子及压接机等。并广泛应用于医疗电子、通讯设备、消费类电子、家用电器、工业机械、仪器设备和照明市场。
- CHEMI-CON,简称NCC，国内一般称嘉美工或贵弥功，俗称黑金刚，是全球最大的铝电解电容生产商。产品在军载、新能源、通讯、工控、家电、医疗、PC、照明等市场均有广泛应用。
- iC-Haus作为数模复合信号集成电路和系统芯片解决方案的专家，致力于设计和生产特殊应用标准产品以及定制ASICs逾30年。iC-HAUS提供创新、可靠以及FMEA认证的集成电路和微系统，实现工业、医疗和汽车领域的应用。
- 全球知名的电阻生产厂商，提供高品质及高稳定性产品，产品质量和信誉深得世界各地客户的信赖。KOA除了提供各类的固定电阻以外，还生产热敏电阻、压敏电阻、电感及陶瓷基板等产品。

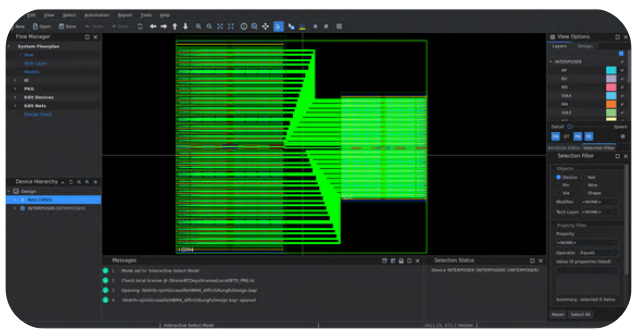
>>回目录页

领取参观证件

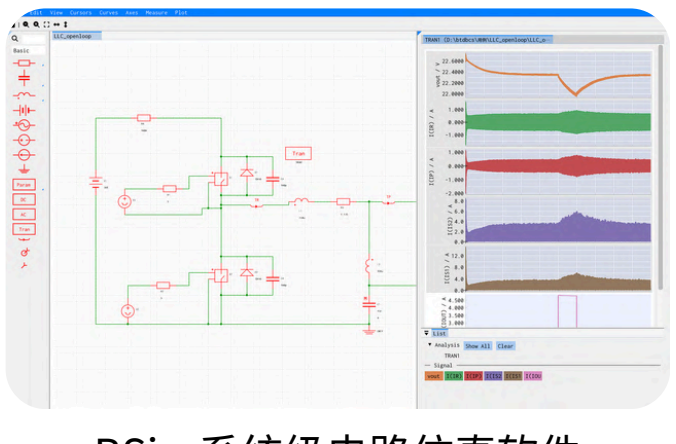
深圳比昂芯科技有限公司 16E06



SYSclaw—从实际需求出发
实现AI生成PCBA



ArrangeX—AI优化驱动的微系统和
先进封装规划与设计工具

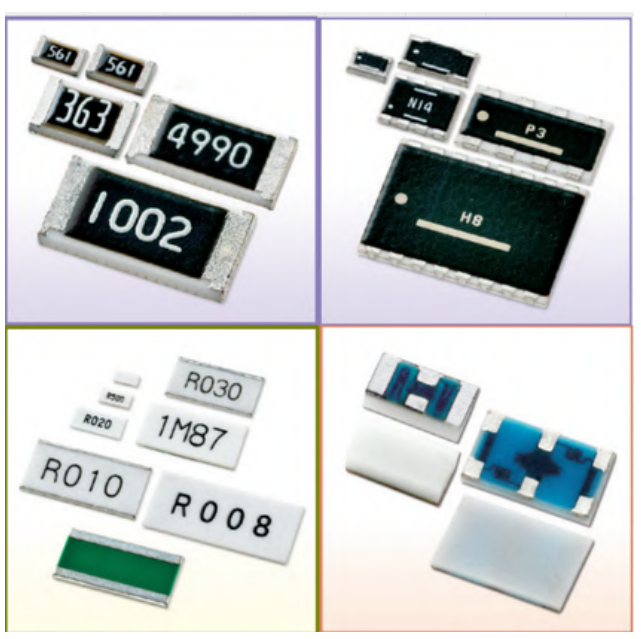


BSim系统级电路仿真软件

产品介绍：

- SYSclaw—从实际需求出发，实现AI生成PCBA：SYSclaw是AI驱动的PCB产业数字化升级解决方案，推动PCB设计从传统工具辅助阶段迈入智能生成新阶段。产品贯穿设计、制造、供应链全流程，补齐行业智能化数字化基建短板，有效破解研发效率偏低、生产成本高、产品质量波动等核心痛点，助力产业构建自主可控的智能设计制造能力。
- ArrangeX—AI优化驱动的微系统和先进封装规划与设计工具：ArrangeX 提供面向先进封装架构设计阶段的AI优化驱动左移设计环境。平台以芯粒模型（含Pin Pattern、几何等物理模型）、IBIS接口模型、封装对象、工艺规则和系统指标为基础，把架构布局、互联规划、资源分配、候选方案生成、快速仿真评估、外部仿真传递和结果回填在同一工程上下文完成，形成可复用、可审计的工程闭环。
- BSim 是比昂芯科技自主研发的高精度电路仿真工具，内置增强版SPICE与分段线性双引擎，快速实现模拟及数模混合电路的全面分析验证。帮助工程师提前排查设计缺陷，减少实物样板迭代次数，缩短研发周期、降低预研投入成本。为数字能源、汽车电子、具身智能、AI智算等前沿领域提供高性能国产通用电路仿真解决方案。

进工贸易（上海）有限公司 16A71

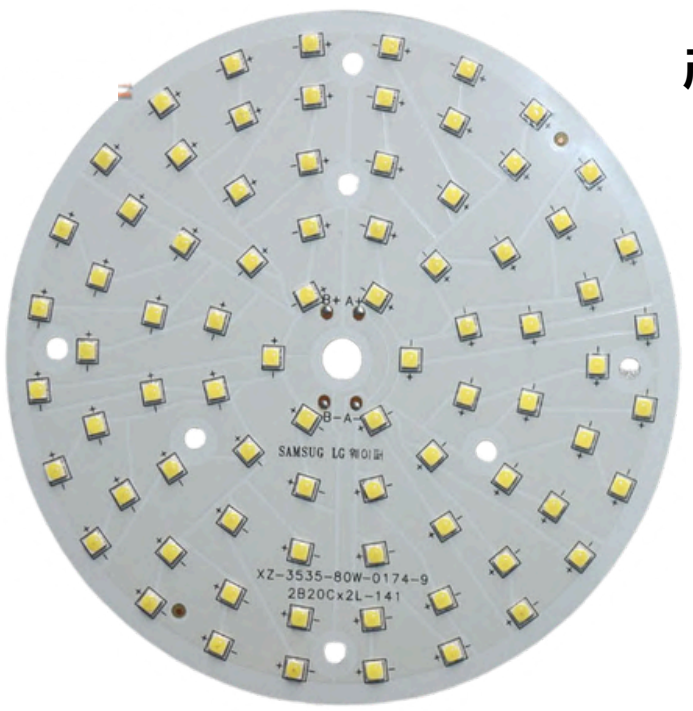


产品名称：高精度薄膜贴片电阻器

产品介绍：

- 高精度薄膜贴片电阻器 URG系列、RG系列、RGT系列、RGV系列、RS系列、PRG系列、HRG系列、RGA系列、RM系列、RMA系列
- 电流检测用采样电阻器 MSR系列金属板电阻器、MBRAS系列大电流金属板分流电阻器、KRL系列长边电极、KRL系列短边电极、KRL系列4电极、PRL/RL系列长边电极、RL系列短边电极
- 高频表面贴装元件 RFD系列、ATS-FD系列、ATF系列、PAT系列、P*V系列、PS系列、PCS系列、HPT系列

深圳市亿卓电子有限公司 16D61



产品名称：LED灯板模组

领取参观证件

产品介绍：

- (YZ)XZ-3535-80W 圆形LED铝基板灯板，一款专为高亮度照
- 高性能光源配置：采用三星/LG 3535封装LED灯珠，单颗灯珠功率1W，整板共64颗灯珠组成，额定功率80W，光效高、显色性好，色温可选（冷白/正白/暖白），满足不同照明需求。
- 高效散热铝基板：采用金属基铝基板材质，导热系数高，能快速导出灯珠工作产生的热量，有效降低灯珠结温，大幅延长灯具使用寿命，同时提升发光稳定性，减少光衰。
- 优化电路设计：电路采用2B20C×2L串并结合的设计（2并20串×2组），适配常规恒流驱动电源，电流分布均匀，避免灯珠因电流不均导致损坏，降低电源

珠海市东恒电子有限公司 16D18



巴伦变压器



方形空芯电感



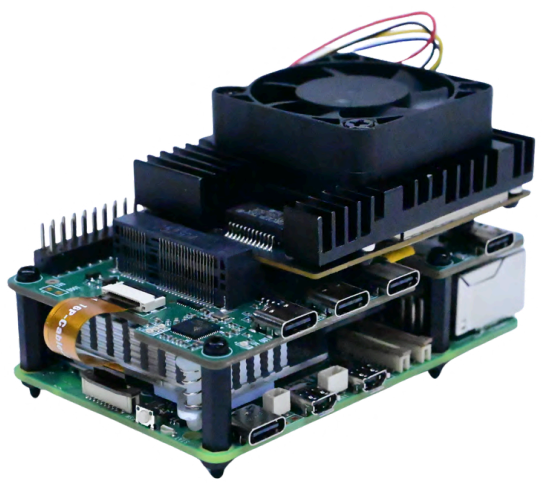
电力载波PLC耦合变压器

产品介绍：

- 巴伦变压器：广泛应用于5G小基站,放大器模块,野外干线放大器,数字电视机顶盒,车载流媒体后视镜,汽车自动驾驶辅助系统,无线麦克风,数字对讲机,车用充电桩,军用雷达,移动直放站等多种终端设备。
- 方形空芯电感：超小型高频贴片方形空心电感射频绕线线圈使其适用于窄带RF放大器匹配/调谐/5G基站/通讯/对讲机等终端应用
- 电力载波PLC耦合变压器：电力载波PLC耦合变压器/耦合变压器，它通常用来隔离、转换和匹配信号，主要是用于电力设备，新能源充电桩通信模块等，它通常用来隔离、转换和匹配信号。专业生产8PIN贴片电力线载波变压器，满足市场多样化需求,推出了匝数比不同的产品：1:1:1/1:4:3/1:1等PLC耦合变压器

>>回目录页

深圳中电港技术股份有限公司 16C62

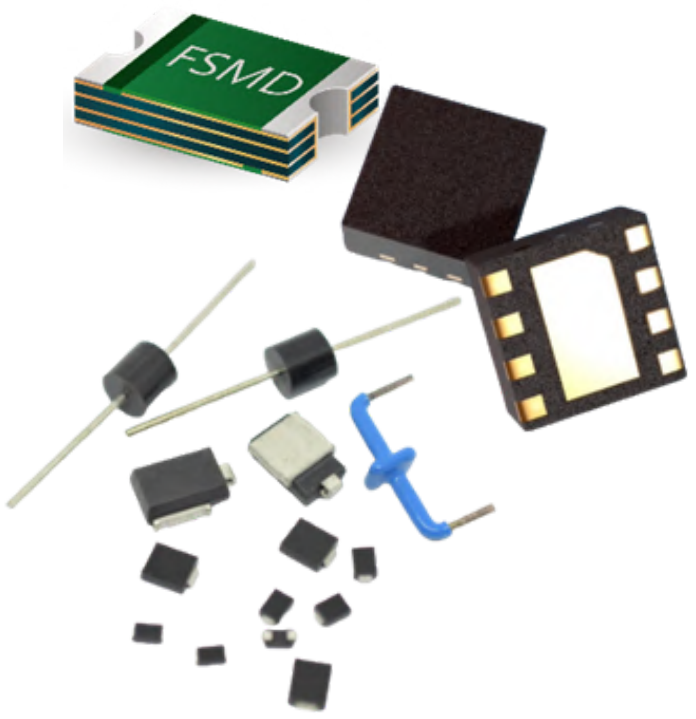


产品名称：萤火工场高算力开源AI BOX

产品介绍：

- 该方案通过阿加犀 RhinoBoost Q86 高性能 AI 算力单元，搭配萤火工场自主设计的定制化转接板，将树莓派 5实现最高 120TOPS 的端侧 AI 推理算力。
- 整套方案简化了硬件适配与底层移植工作，能够帮助开发者高效完成端侧 AI 平台的快速搭建，降低边缘 AI 应用的开发门槛。

富致科技股份有限公司/苏州富鼎商贸有限公司东莞分公司 16E23



产品名称：自恢复式保险丝

产品介绍：

- 本公司專注於高分子正溫度係數自復式保險絲（PPTC）之研發、製造與銷售，並積極拓展過電壓保護元件（MOV、TVS）、功率半導體 MOSFET及創新複合式元件等領域，致力成為保護元件整體解決方案的領導廠商。
- 電子產品皆需仰賴各類電子元件，而無論主動或被動元件，皆須透過保護元件來防止電路因過電流、過電壓或雷擊而受損。
- 相較於傳統一次性熔斷及其他保護元件，PPTC自復式保險絲以ESG為設計概念，因其在電流恢復正常後自動復位，可重複使用、兼俱節能、環保、減少返修與智能化等優勢。凡是使用電力或訊號的產品，皆需要自復式保險絲之保護

领取参观证件

东莞精途实业有限公司 16A02



产品名称：低压开关和插座

产品介绍：

- 插座及USB连接器。通过了ISO 9001认证，并在2010年获得GMC认证确定本厂在中国符合高品质生产。2014年取得了TS 16949和USB-IF认证，并在2018年取得了ISO 14001认证，以满足ISO质量管理标准。所有产品均自2005年1月符合RoHS标准，同时也符合REACH欧盟和美国的CPASI的，EN71-3环保要求。

深圳市奥宇达电子有限公司(CCTA) 16D45



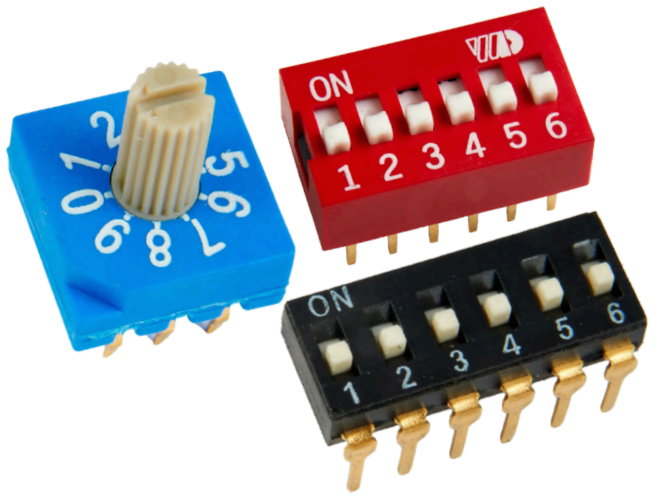
产品名称：SMD3225系列

产品介绍：

- 高精度小公差抗跌落耐高温性能显著。 声表谐振器系列、声表滤波器系列、陶瓷谐振器系列、陶瓷滤波器系列等，有源钟振、贴片型、插件 型各种常规型号，非常规定做频率。

>>回目录页

温州市万达电子有限公司 16D46



产品名称： DIP开关

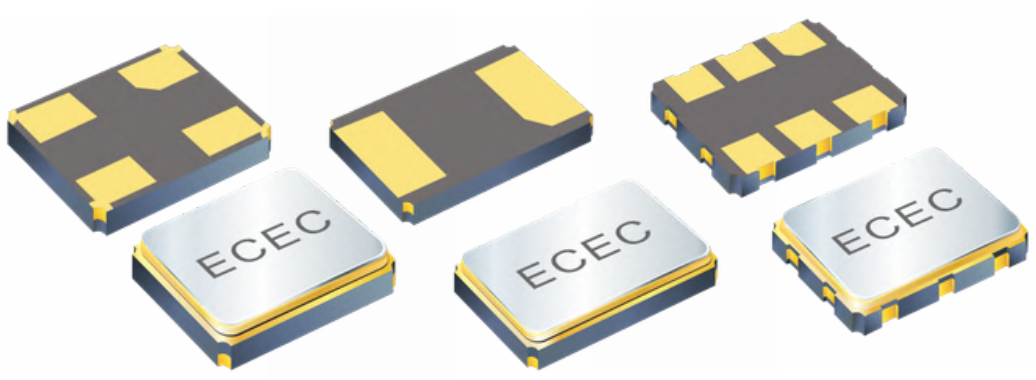
产品介绍：

>>回目录页

领取参观证件

- 专业生产DIP拨码开关。
- 产品涉及计算机系统、网络和通信、仪器仪表、安全系统、消费电子产品和家用电器等行业。汽车电子、光电子和电力能源。

东晶电子金华有限公司 16C05



产品名称： 石英晶体

产品介绍：

消费电子,汽车电子/新能源汽车,工业电子/自动化,通信/5G/6G,医疗电子,物联网/智能家居,人工智能 / 机器学习,电脑和周边设备,电源与能源,显示/Mini-Micro LED,服务器/数据中心,安防与安保

东莞市五盈电子有限公司 16D48



按键开关

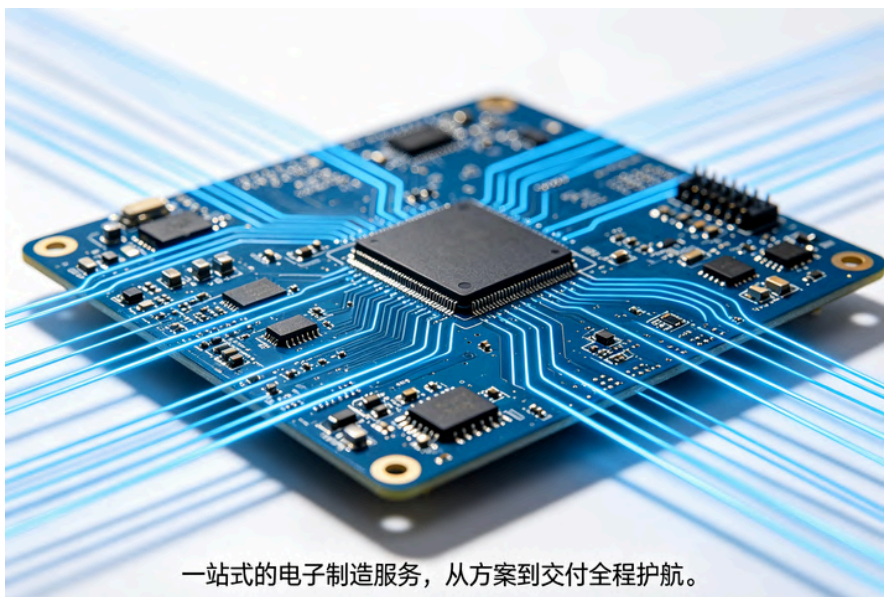


带灯轻触开关

产品介绍：

- 带灯轻触开关、带灯按键开关、带灯按钮开关、按键开关、钮子开关、按钮开关、船型开关、金属开关、防水USB TYPE-C、 AC/DC插座、保险丝座等。
- 产品广泛应用于家用电器、专业音视频设备、智能家居、安防器材、医疗美容、舞台灯光控台、仪器仪表、机械自动化、汽车船舶、电脑周边等产品

广州市柯洱斯电子有限责任公司 16B05



产品名称： 全流程专属电子制造服务，电子OEM，EMS

产品介绍：

广州市柯洱斯电子有限责任公司（KEHORSS ELECTRONICS），以专属智工场合作模式，专注于为行业客户提供全流程专属电子制造服务（电子OEM、EMS）

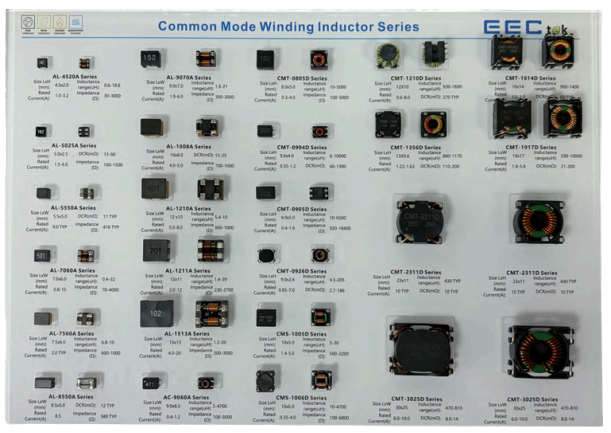
展前预览——电子元器件

>>回目录页

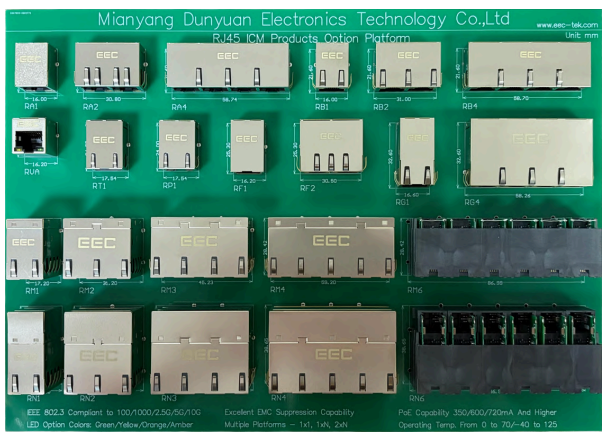
扫码登记参观

绵阳敦源电子科技有限公司

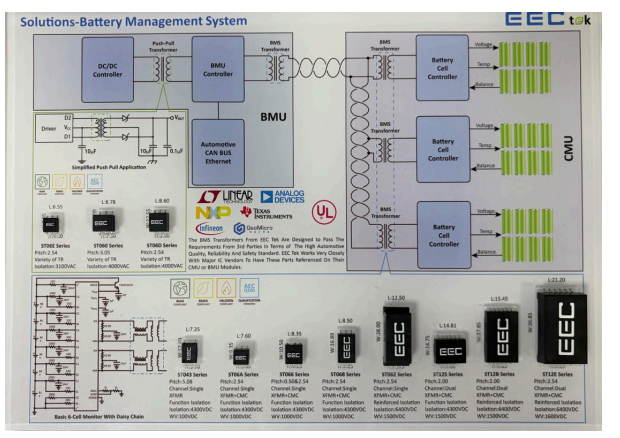
16C35



Common Mode Winding Inductor Series



RJ45



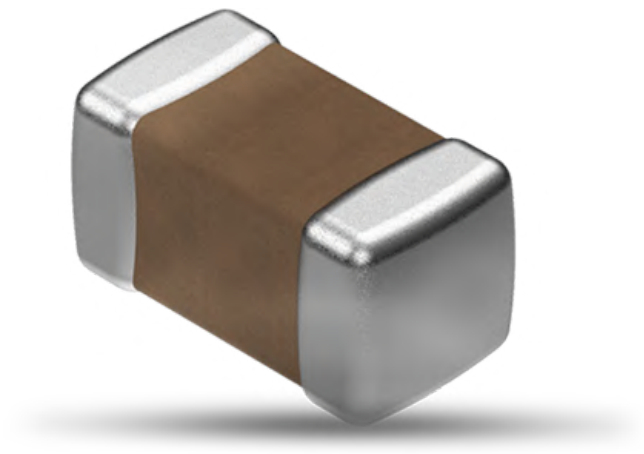
Solutions-Battery Management System

产品介绍：

- Common Mode Winding Inductor Series：EEC TEK 共模绕线电感系列品类齐全，覆盖贴片小型化 AL 系列、扁平 CMT 系列、微型 CMS、环形 AC 系列多种封装。产品电感、额定电流规格丰富，具备低直流电阻、优异共模噪声抑制能力。产品满足 RoHS、REACH、无卤环保标准，适配高速信号线路滤波、电源 EMI 滤波场景。广泛用于网通设备、工业控制、汽车电子、电源适配器、储能及消费电子，可针对千兆以太网、车载电路、开关电源提供成熟 EMC 滤波方案，支持多规格选型，满足不同尺寸、电流、阻抗设计需求。
- RJ45：绵阳敦源电子 EEC 提供全系列 RJ45 集成网络连接器（ICM）方案，覆盖单口、多口模组。产品兼容 100M/1G/2.5G/5G/10G 以太网，符合 IEEE 802.3 标准，支持 PoE 供电，输出电流可达 350/600/720mA 及以上。产品具备优异 EMC 抑制性能，LED 灯色可选，工作温度覆盖 0~70°C、-40~125°C宽温区间。提供 1×1、1×N、2×N 多种结构平台，广泛应用于工业网络设备、通信网关、安防、车载及 ICT 基础设施，可灵活满足不同设备端口布局需求。
- Solutions-Battery Management System：EEC TEK 推出完整 BMS 电池管理系统隔离变压器解决方案，适配新能源车载动力电池场景。方案实现 BMU 主控单元与 CMU 电池监测单元之间电源、通讯隔离传输，支持菊花链拓扑，完成电芯电压采集、温度监测与均衡管理。旗下 ST 系列隔离变压器覆盖多款封装规格，具备功能隔离、加强隔离等级，隔离耐压规格齐全；产品符合 AEC-Q200、UL 认证，满足 RoHS、REACH 环保标准，深度兼容 ADI、TI、NXP、英飞凌等主流厂商 BMS 芯片，满足车载严苛可靠性与安全要求，可应用于新能源汽车、储能设备电池管理系统。

深圳市新永利电子有限公司

16C13



产品名称：MLCC 多层陶瓷贴片电容通用系列

产品介绍：

- 尺寸：01005~1812
- 电压：6.3V~3kV
- 材质：X7R/X7S/X6S/X5R/C0G/M3L
- 容值范围：0.1pF~100uF

>>回目录页

领取参观证件









展前预览——芯片

>>回目录页

扫码登记参观

上海灵动微电子股份有限公司 16C36



灵动MM32L0180



灵动MM32G0005



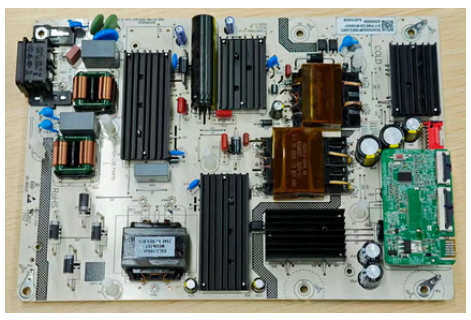
灵动MM32SPIN0260

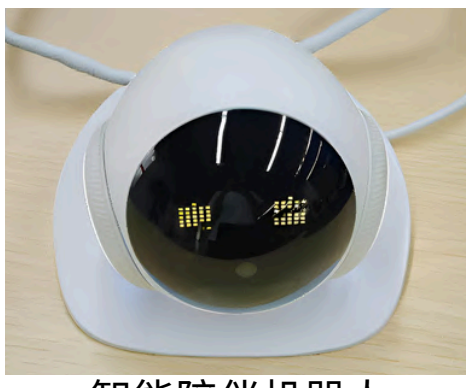
产品介绍：

- 灵动MM32L0180：搭载 Arm® Cortex ®-M0+ 内核，最高工作频率达 48MHz。内置 256KB Flash 存储器、5KB Data Flash 和 24KB SRAM；2 个 16 位通用定时器、2 个 16 位基 本定时器、4 个低功耗定时器和 1 个 RTC 计数器；内置多种省电工作模式:低功耗运行（Low Power Run）、睡眠（Sleep）、低功 耗睡眠 （Low Power Sleep）、停机（Stop）、深度停机（Deep Stop）和待机 （Standby）模式；封装形式： LQFP48，LQFP64 和 LQFP80。
- 灵动MM32G0005：强劲内核：Arm Cortex-M0+ 内核，48MHz主频，提供高效的运算能力；卓越可靠：内置硬件CRC校验单元、96位唯一芯片ID(UID)，增强系统安全性与可靠性；便捷开发：支持标准SWD调试接口，开发调试更高效功耗模式：支持睡眠(Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)等多种低功耗模式，显著延长电池供电设备续航；适合于多种应用场合：①智能控制节点：传感器、远程控制器等；②消费电子：无线充电器、智能玩具、LED照明控制等；③工业控制：电机驱动、消费设备等；④产品升级：完美替代传统8/16位MCU，提升性能与功能；⑤需要高可靠性、宽温、宽压、低功耗的各类应用场合
- 灵动MM32SPIN0260：MM32SPIN0260系列是灵动MindSPIN旗下高性能的电机控制专用微控制器产品，使用高性能的 Arm® Cortex-M0+为内核的32位微控制器，工作频率可达 96MHz，32位硬件除法器和硬件开方器。主要配置：128KB Flash支持 ECC，8KBSRAM，针对电机应用内置，2个12位ADC，多达17ch，采样速率1Msps(3.3V) / 2Msps(5V)，1个针对电机控制的PWM高级定时器和4个通用定时器，2个轨到轨模拟比较器，4个OPA/PGA（x32 max），1个I2C接口、3个USART接口重点应用在电机驱动和应用控制等领域。

深圳市航顺芯片技术研发有限公司 16B46


卷发棒


TV电源板


智能陪伴机器人

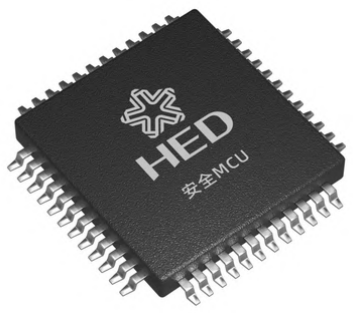
产品介绍：

- 卷发棒：智能卷发棒搭载航顺 HK32L088KBU6 国产低功耗 MCU 主控，精准闭环恒温控制，多级安全防护，待机功耗低、外设资源充足，Pin-to-Pin 平滑替代，优化 BOM 成本，适合便携锂电款、插电款美发电器规模化量产。
- TV电源板：TV 电源板搭载航顺 HK32C030F8P7 国产 32 位 MCU 主控，精准实现电源闭环控制、多维度保护与通讯交互，宽温稳定、抗干扰强，Pin-to-Pin 兼容易替代，优化 BOM 成本，适合液晶电视整机规模化量产。
- 智能陪伴机器人：本款智能陪伴机器人以航顺 HK32F103RBT6A作为主控核心，搭载国产 32 位 Cortex-M3 高性能 MCU，算力稳定、外设资源丰富。支持语音交互、动作驱动、传感器采集、USB 通讯等多功能协同运行；芯片软硬件 Pin-to-Pin 兼容，开发迁移便捷，供货稳定、性价比突出。整机实现人机对话、早教互动、智能感应、肢体动作控制，可为儿童早教、家庭陪护提供温情智能陪伴，稳定可靠，易于量产落地。

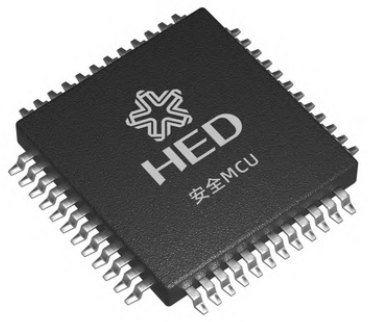
>>回目录页

领取参观证件

北京中电华大电子设计有限公司 14A52



超值通用
CIU32F0系列安全MCU



超低功耗
CIU32L0系列安全MCU

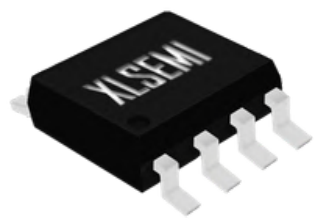
产品介绍：

- 限公司超值通用CIU32F0系列安全MCU：超值通用CIU32F0系列安全MCU基于Cortex-M0+内核，最高频率48MHz, Flash最大容量64KB,工作电压1.8V-5.5V,内部集成多种定时器、高速通信接口、高精度ADC和低功耗比较器等常用外设，集宽电压、宽温幅、低功耗、高可靠性于一体，可以提供多种存储容量和封装类型，为成本敏感型应用提供更多灵活选择。典型应用包括照明设备、显示设备、智能家电、电机控制、BMS电池管理、智能玩具、电子烟等产品。
- 超低功耗CIU32L0系列安全MCU：超低功耗CIU32L0系列安全MCU基于ARM Cortex-M0+内核，最高频率可达48MHz，具有超低功耗、高集成度、高可靠性、高安全的特点。内部集成LCD、ADC、VREFBUF、低功耗COMP、多种定时器、多个USART/12C/SPI等丰富的外设资源，同时提供了SM4、AES、TRNG、PUF等信息安全外设，通过商密二级及EAL4+认证。典型应用包括智能燃气表、智能水表、温控器、报警器、便携医疗、智能门锁等电池供电的产品。

上海芯龙半导体技术股份有限公司 16D32



35W 5A 60V高电压
大功率音频功率放大器



0.4A 150KHz 100V降压型
DC-DC转换器



直流载波通讯专用的
硬件编解 码芯片

产品介绍：

- 40kPa 数字I2C输出表压传感器：XL252是采用MEMS技术制作的压阻式表压传感器。内置温度传感器及信号调理芯片对传感器的偏移、温漂和非线性进行数字补偿，可输出高精度的压力值和温度值。
- 35W 5A 60V高电压大功率音频功率放大器：XL2050A是一款AB类单通道音频功率，放大器，专为高电压、大功率、高效率优化设计。在35W输出功率下最大限度的提高了音频信号的保真度。
- 0.4A 150KHz 100V降压型DC-DC转换器：XL7005A是一款高效、高压降压型DC-DC转换器，固定150KHz开关频率，可提供最高0.4A输出电流能力，低纹波，出色的线性调整率与负载调整率。
- 直流载波通讯专用的硬件编解 码芯片：XL1193是一款符合家庭数据总线标准，支持硬件编解码，具有接收与发送数据功能的芯片。支持直流载波，支持无极性连接，总线拓扑方式灵活。

>>回目录页

领取参观证件

天津速显微电子科技有限公司 16C40







产品名称：GPU显示芯片及系统

产品介绍：

在技术创新上，速显微实现了从GPU IP、SoC到操作系统、开发工具的全生态自主研发布局，是国内首家打通芯片底层到工具链全链条的企业。其GC90系列芯片已累计出货超500万片，最新获奖的“端侧大模型推理GPU芯片及软硬件生态”项目，凭借自研TH1100具身智能计算GPU芯片及TUCA开发者平台，在2026年人工智能场景创新应用大赛中从200余项目中斩获唯一一等奖。

展前预览——芯片

>>回目录页

扫码登记参观

深圳唯创知音电子有限公司 16E07









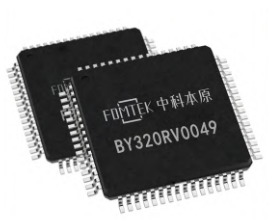
产品名称：WT3000A-M06文生图AI模块

产品介绍：

AI 文生图打印机是一款基于 WT3000A-M06 语音交互模组打造的端云融合创新产品。产品以"别让灵感溜走，把它变成贴纸"为核心理念，将语音交互、AI 文生图、热敏打印三项技术融合于一体，用户只需对着设备说出创意，AI 引擎即可在数秒内将语音转化为图像并打印输出。

该产品面向儿童创意教育场景，打破传统"说→写→画"的创意表达链路，实现"说→AI 生成→即时打印"的极简交互闭环。孩子对设备说出天马行空的想法，AI 引擎即刻将想象变为可触摸的实体贴纸，让灵感不再等待。

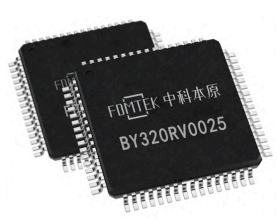
青岛本原微电子有限公司 16C71



BY320RV0049



BY320RV00137



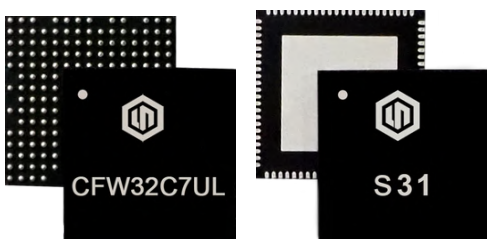
BY320RV0025

产品介绍：

- BY320RV0049：RISC-V内核版实时控制类DSP。采用中科本原自研的浮点DSP内核——SummerCore。SummerCore集成TMU、VCU、VCRC、FINTDIV等增强计算模块，同时配备一个独立的控制律加速器（CLA），采用CLA处理时间敏感事件，可以释放主核性能，使主核能并发处理其他系统与通信任务。
- BY320RV00137：RISC-V内核版的实时控制类数字信号处理器。它采用了中科本原自研的浮点DSP内核——SummerCore。成本和封装尺寸相比BY320RV0025更加优化。其最小封装尺寸VQFN32可达5mm × 5mm，可广泛应用于各种小型化设备。
- BY320RV0025：是一款RISC-V内核版的实时控制类数字信号处理器。它采用了中科本原自研的浮点DSP内核——SummerCore。SummerCore采用RV32IMAFCB-Ext指令集架构，大幅增加了三角函数计算、快速傅里叶变换、维特比译码、循环冗余校验、快速整数除法、伽罗华域计算等227条领域专用扩展指令。

码灵半导体 16D39





产品名称：工业以太网EtherCAT芯片、嵌入式处理器、微控制器

产品介绍：

- CF110x系列是EtherCAT从站控制器ASIC，为实现EtherCAT从站提供了一种经济高效且紧凑的解决方案。
- 该系列在硬件中处理EtherCAT数据链路协议，确保了高性能和实时功能，独立于任何下游从属微控制器和相关软件。
- CF110x系列通过了ETG一致性测试认证，以其全面的性能和灵活的应用，成为EtherCAT设备的通用解决方案。

>>回目录页

领取参观证件

展前预览——芯片

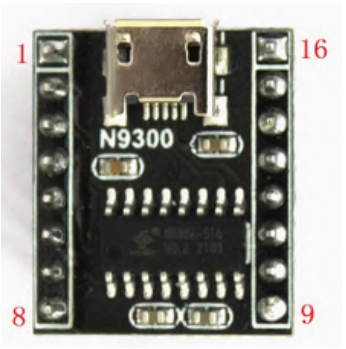
>>回目录页

扫码登记参观

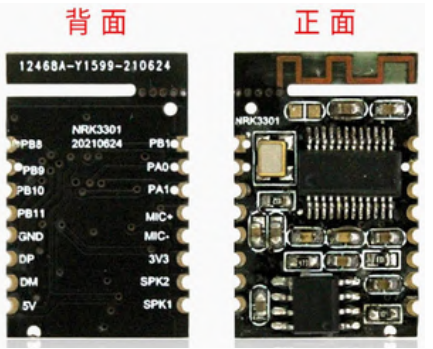
广州市九芯电子科技有限公司 16C72



可擦除语音芯片NV256H



语音模块N9300



语音识别模块NRK3301



音频解码芯片N930X

>>回目录页

领取参观证件

产品介绍：

- 可擦除语音芯片NV256H：NV256H语音芯片内置一款高性能的 16 位单片机，运行频率高达 32MHz，具有256K闪存,能存400秒语音，用于高性能处理音频算法，支持WPM输出和DAC输出。支持 8 位普通一线指令，最多支持 223 段语音，16 位一线多地址指令，最多可以支持 3327 个地址数据。广泛应用于智能家居、家用电器、医疗器械、安防报 警等产品上。
- 语音模块N9300：N9300模块是一个提供串口的MP3硬解码语音模块。它上面拥有N9300的MP3芯片，，支持电脑直接更新spi flash 的内容，支持FAT16、FAT32 文件系统。通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐，自带3W功放可以直接接扬声器，供电3.5-5V供电
- 语音识别模块NRK3301：语音识别模块可以识别中文/英文100条指令，模块自带3W功放，可以直接接扬声器，有串口输出，也能通过串口发码播放声音
- 音频解码芯片N930X：N930X 是一个提供串口的 MP3 芯片，完美的集成了 MP3 的硬件解码芯片。它包括了四种不同型号的 MP3 芯片，即 N9300、N9301、N9302 和 N9303 MP3 芯片，支持 TF 卡驱动，支持电脑直接更新 spi flash 的内容，支持 FAT16文件系统。通过简单的 UART 串口指令或一线串口指令控制，也可定制录音功能。

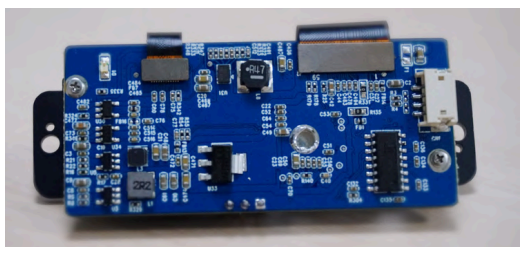
珠海凌烟阁芯片科技有限公司 16B20



凌烟阁黑光相机



凌烟阁Magpie-G1 MCU



凌烟阁RGB-D深度相机



凌烟阁360相机

产品介绍：

- 凌烟阁黑光相机：400万像素，F1.0大光圈镜头，黑光环境中使用；全天24小时工作，低功耗电池产品；有异动快速抓图；1440p@30fps、1080p @30fps、720p @30fps；视场角 109.8°D；夜视距离 8~10米；带 2.4T 算力，可以运行简单的 AI 算法（如人形侦测）。场景用途：户外：矿区、野外森林、树林、岩石、门口、庭院内墙壁、庭院外墙壁、农场、栅栏、篱笆，野外露营安全防护，生态保护。室内：客厅、卧式、玄关等。主要用途：儿童安全防护等。
- 凌烟阁Magpie-G1 MCU：Magpie-G1 MCU在积塔半导体40nm设计制造平台流片并成功点亮。通过外围接口，能现场演示手势识别、单点TOF测距，通过LoRa通讯模块接收远端黑光相机的实时信号，并在OLED屏上显示多种信息。凌烟阁Magpie-G1 MCU搭载Crista-G40，根据不同的应用需求添加不同的指令。
- 凌烟阁RGB-D深度相机：单个摄像头即可达成 360° 环视；完成初步镜头畸变校正；主控板采用双核 A7 CPU @1.2GHz（Sigmastar 9381），带 1TOPS NPU；4K (3840*2160) MJPEG/H.264/H.265 编码；iMX586 CIS 芯片；输出格式：4K@30 fps（3840*2160，分割图像输出）；2560*1440@30 fps（分割图像输出）;2752*2752@30 fps（全图像输出）；视场角 360°H x 50°V

elexcon&IICIE——芯片

>>回目录页

扫码登记参观

达摩院玄铁 14B50

C950



玄铁C950是64位高性能多核处理器，采用超标量、乱序执行、8译码宽度微架构。兼容RISC-V RVA23 Profile，同时支持Vector Crypto、Zacas、Zama16b、Smmtt、CoVE、RAS、AIA以及Zalasr等其他扩展。C950采用了先进的微结构技术以实现高性能，包括基于TAGE的分支预测算法、Private L2 Cache、可调节的数据预取机制等。C950 SPECint2006性能分数超过22/GHz。

澜起科技股份有限公司 14B52

时钟芯片



澜起科技凭借在数模混合芯片设计、核心IO技术和PLL模块等关键技术上积累的深厚经验，成功布局高性能时钟芯片市场，提供时钟发生器、时钟缓冲器和展频振荡器系列时钟芯片解决方案。该系列产品可广泛应用于数据中心、通讯电子、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域，满足行业对高性能时钟芯片日益增长的需求。

苏州国芯科技股份有限公司 14B50

超高性能云安全芯片CCP917T



CCP917T基于国芯科技自主RISC-V架构的CRV7多核处理器设计，主频1.4GHz，集成NPU，是面向云场景的高性能安全芯片，内嵌国密/国际算法硬加速引擎并支持硬件虚拟化，适用于高性能计算、高速数据处理和AI推理等复杂场景。它具备超高性能、高安全性、高可靠性和高扩展性，参数优异，可满足对安全、性能及稳定性要求高的场合，应用于云计算、数据中心、金融和通信等领域。

北京君正集成电路股份有限公司 14B65

CW080



CW080专为AI眼镜、智能穿戴、微型视觉终端打造，采用 QFN90 7mm*11mm超小封装；内置 1Tops@INT8 NPU，支持4K@30fps H.265编码、12MP 拍照、双摄拼接、端侧EIS 防抖；内置DDR，休眠功耗约1mW，运行功耗较前代降30%；兼顾高性能与长续航，是穿戴AI视觉的旗舰方案。

合肥芯动力科技有限公司 14B72

AE7103



AE7103采用14nm工艺、19x19mm FCBGA封装，芯片基于自研可重构并行处理器（RPP）架构设计，可全面覆盖云、边、端全场景AI部署需求，原生兼容DeepSeek、Qwen、Llama等主流大模型，支持PyTorch、TensorFlow等主流AI框架及ONNX模型格式；同时深度适配CUDA开发生态与OpenRT推理框架，开发者可直接复用现有代码资产与开发经验，实现模型一键平滑迁移，有效降低部署成本，大幅缩短项目落地周期。

珠海泰芯半导体有限公司 14B62

AI大模型音视频SOC



2.4GHz Wi-Fi + BLE双模，内置MJPEG编解码器，Audio+Video同步处理，玄铁E803内核，主频240MHz。TXW81X已接入DeepSeek、豆包、通义千问、百度文心、扣子、讯飞聆思、酷旗、探鸽八大主流大模型平台，方案商拿到SDK即可开发产品。 应用方向：AI玩具、陪伴机器人、AI儿童相机、英语听力宝、儿童音视频对讲机。

成都华微电子科技股份有限公司 14B55

CSD7Z020CLG484I



主要特性： 电源电压 核心电压1v、IO电源电压1.2-3.3v； 千万系统门； 最高系统频率800M； 内嵌BRAM容量4.9Mbits； PL 宽范围用户IO数200个； PS 通用IO数128； PL DDR3接口速率800Mbps； PS DDR3接口速率1066Mbps； 全流程自主开发工具。 应用场景： 可广泛用于电力行业、轨道交通、工业自动化、有线和无线通信、医疗内窥设备等领域。

合肥云联半导体有限公司 14B62

光通讯安全加密芯片



光通讯加密安全芯片：具备自主可控的加密算法内核，支持国密算法全适配，可实现光传输链路数据加密、身份认证、防篡改、防窃听全流程安全防护，适配5G、F5G、数据中心高速光传输场景。芯片集成加密、解码、校验多功能模块，无需外挂加密器件，集成度高、传输延迟低，可适配400G/800G高速光模块传输需求，填补国内中高端光通讯安全芯片国产化短板，摆脱海外芯片垄断依赖。

>>回目录页

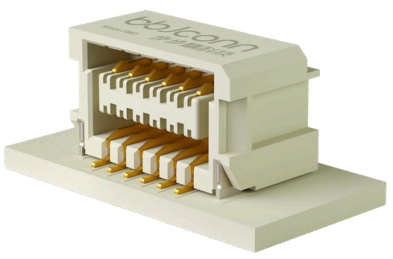
领取参观证件

展前预览——连接器

>>回目录页

扫码登记参观

深圳市步步精科技有限公司 16B70



针座连接器



USB3.1母座



USB-A/C融合母座



DP连接器

产品介绍：

- 针座连接器：Wafer作为步步精的主力产品线，在深圳园区制造，品质可靠、品类齐全，广泛应用于消费电子、汽车电子及工业控制等领域。凭借稳定性能和优质工艺，步步精Wafer连接器正逐步实现国产替代进口，成为客户值得信赖的核心选择。
- USB3.1母座：USB3.1 A-Type是步步精的专利旗舰产品，融合高速传输与广泛兼容性，支持更快的数据传输速率与稳定的电力供应。凭借自主研发和专利优势，步步精在连接器领域树立了高端标杆，为客户提供高性能、可靠的一体化解决方案。
- USB-A/C融合母座：USB-A/C融合母座是一款兼容双接口的连接器产品，满足多样化设备的高速数据与电源传输需求。步步精公司前后投入500万进行研发，目前该产品已实现稳定量产，品质可靠、交付保障，为客户提供更高效的一体化连接解决方案。
- DP连接器：DP连接器（DisplayPort连接器）是一种高速数字视频接口，广泛用于电脑、显示器和显卡之间的音视频传输，支持4K/8K超高清分辨率和高刷新率显示，并兼容HDMI、DVI等接口。近年来，步步精公司已成功实现DP连接器的快速量产，产品在信号稳定性和工艺精度上表现突出，广泛应用于高端显示设备及工业领域。

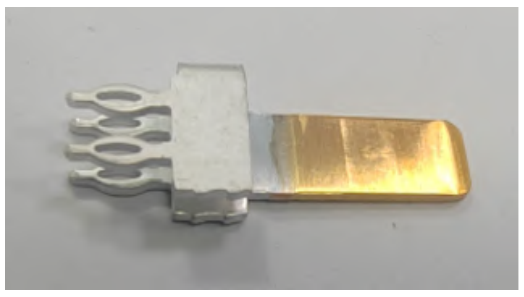
广东厚为电子有限公司 16B18



智能网联（接插件）类端子

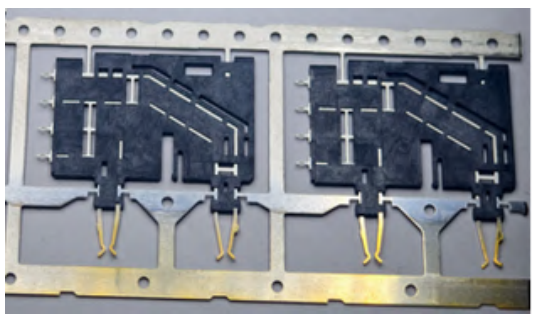
产品介绍：

- 智能网联（接插件）类端子：智能网联（接插件）类端子是专为智能网联汽车、车路协同及物联网通信场景打造的高性能连接端子，核心承担车载传感器、域控制器、V2X 通信模块、激光雷达等关键部件间的信号传输与电力分配任务，满足车载高速数据传输需求，广泛应用于智能驾驶、车联网 T-BOX、5G-V2X 路侧单元、智慧交通等领域，提供高可靠互连解决方案。



鱼眼端子

- 鱼眼端子：非标鱼眼端子是按需定制的高性能接地连接部件。其核心特征为端子头部带有鱼眼状环形压接结构，可与螺栓、螺柱牢固锁定，实现导线与设备外壳、接地排的可靠电气连接，防松脱、抗振动性能优异。可灵活调整孔径规格、环形内径、压接槽形状及尾部导线焊接 / 压接形态，支持紫铜、黄铜、磷青铜等材质及镀锡、镀镍、镀银等多种镀层选型，适配不同电流等级与防腐要求。可满足非标间距、非标线径、异形装配空间等特殊工况需求。广泛应用于新能源电池包接地、光伏逆变器、汽车电子、工业配电柜、通信基站等领域，为特殊接地连接场景提供专属高可靠解决方案。



非标定制高速插拔类端子

- 非标定制高速插拔类端子：非标定制高速插拔类端子针对通用标准端子无法适配的特殊工况按需定制，专为高频次插拔场景打造，可匹配设备专属的空间布局、性能参数与装配需求。 可灵活调整针径、孔径、开槽结构、焊接端头形态，支持不同镀层厚度、特殊材质选型，适配航空插头、工业防水接头、精密传感接插件等非标准装配场景。 产品实现模具设计、打样确认到批量生产全链路自主完成，适配汽车电子、通讯、医疗精密仪器等领域特殊连接需求，提供专属高可靠连接解决方案。

领取参观证件

>>回目录页

展前预览——连接器

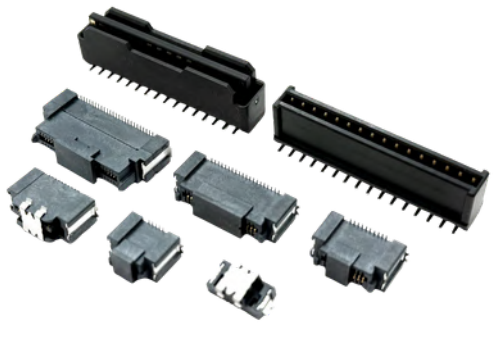
>>回目录页

扫码登记参观

深圳市硕凌电子科技有限公司 16B17



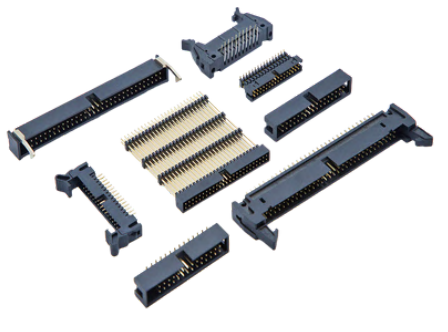
航空头连接器



板对板连接器



排针排母

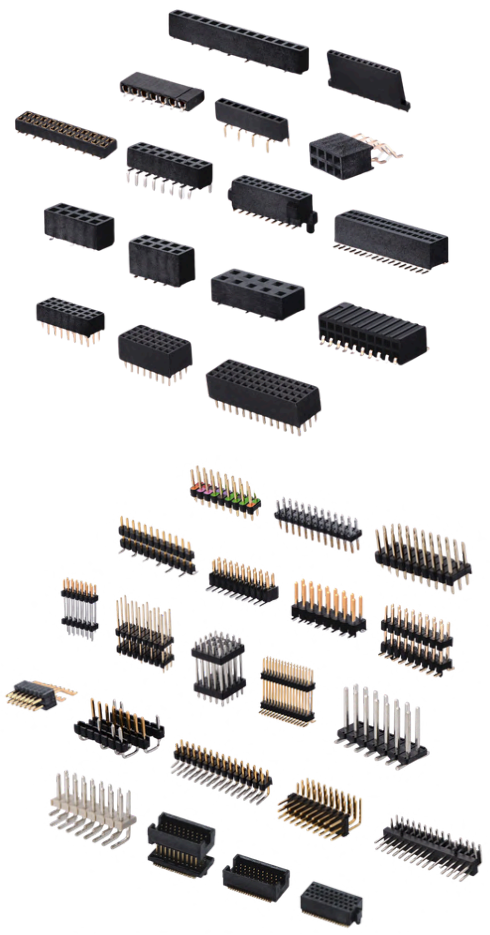


简牛牛角

产品介绍：

- 航空插头，经受得起耐酸碱不腐蚀生锈，做到绝对的防水防尘，电压输入或输出稳定，防误插等要求。我们工控机和工业平板电脑等产品上，几乎产品都是用到航空插头，以保证客户高品质的机器运算，满足不同客户在复杂多样的工业环境运作需求。
- 板对板（BTB）连接器用于连接印刷电路板（PCB），这些电子元件以准确和可重复的方式在绝缘基座的表面印有导电图案。BTB连接器上的每个端子都与PCB相连。一个BTB连接器包括外壳和特定数量的端子。端子由导电材料（主要是铜合金）制成，并进行电镀以提高导电性和防锈。端子在通过BTB连接的PCB之间传输电流/信号；外壳由绝缘材料（主要是塑料）制成。
- 排针广泛应用于电子、电器、仪表中的PCB电路板中，其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用，构成板对板连接;或与电子线束端子配套使用，构成板对线连接;亦可独立用于板与板连接。
- 排母是连接器的一种，英文名称:Female Header。这种连接器广泛应用于电子、电器、仪表中的PCB电路板中，其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起电流或信号传输的任务。通常与排针配套使用，构成板对板连接;或与电子线束端子 配套使用，构成板对线连接;亦可独立用于板与板连接。

东莞市宇熙精密连接器有限公司 16A46



产品名称：排母连接器

产品介绍：

- 排母,连接器的一种。应用：这种连接器广泛应用于电子、电器、仪表中的PCB电路板中。作用：其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用，构成板对板连接；或与电子线束端配套使用，构成板对线连接；亦可独立用于板与板连接。间距分为：0.8mm 1.0mm 1.27mm 2.0mm 2.54mm 3.96mm 5.08mm
- 排针连接器广泛应用于电子、电器、仪表等中的PCB电路板中，其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用，构成板对板连接；或与电子线束端子配套使用，构成板对线连接；亦可独立用于板与板连接。间距分为：0.8mm 1.0mm 1.27mm 2.0mm 2.54mm 3.96mm 4.0mm 5.08mm

>>回目录页

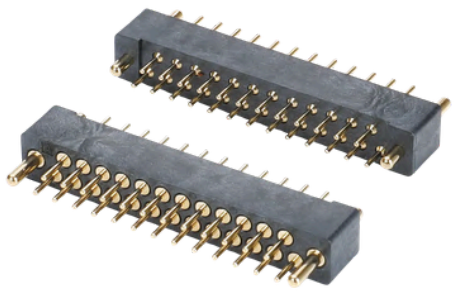
领取参观证件

展前预览——连接器

>>回目录页

扫码登记参观

深圳市帏达鑫科技有限公司 16D05



产品名称：排针排母

产品介绍：

各种规格排针排母



产品名称：SMC 连接器

产品介绍：

1.27mm Pitch SMC 连接器系列

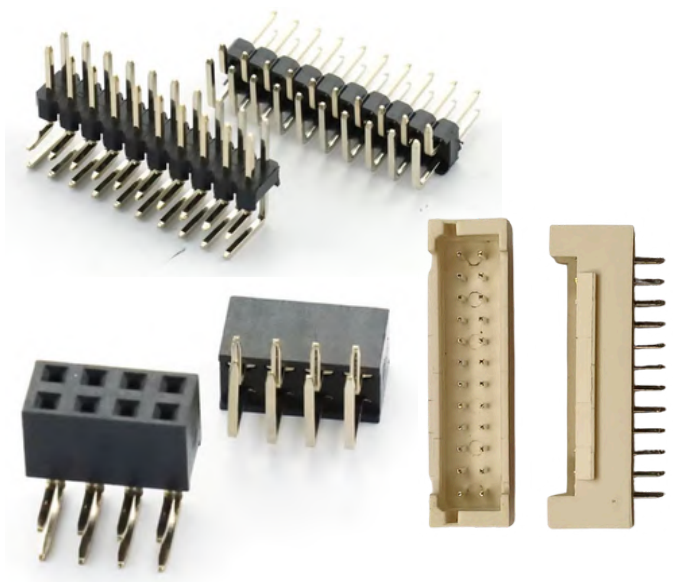


产品名称：板对板连接器

产品介绍：

各种规格板对板连接器

深圳市创豪欣电子科技有限公司 16B09

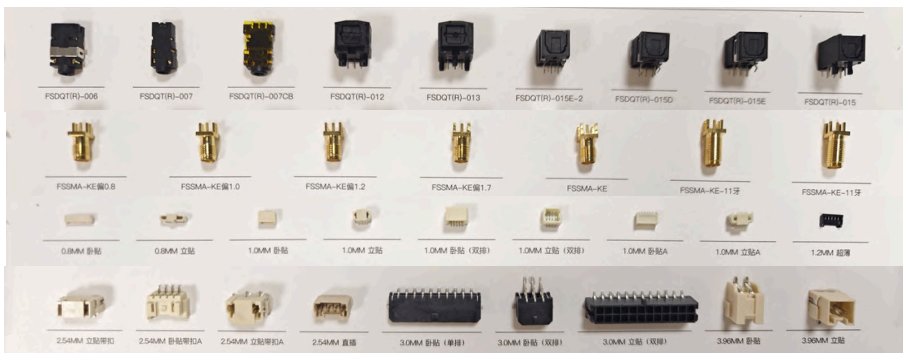


产品名称：排针排母 、FPC/FPC、POGO-PIN、板对线WAFER针座、轻触/拨动开关、RJ45/RJ11、TYPEC

产品介绍：

线对板waferPHB-2.0间距带扣直针系列：PIN 距：2.0mm；PIN 数：2×2P-2×20P；产品核心优势：全包塑胶，防开裂，防脱落，可靠性增强。排针排母1.27mm，2.0mm，2.54mm通孔回流焊系列；PIN 距：1.27mm，2.0mm，2.54mm；PIN 数：双排2×2P-2×40P, 单排1P-2×40P；产品核心优势：插件物料编带包装可同贴片物料一同上机；提升生产效率，增加良品率，节约人工成本。

东莞市福顺电子科技有限公司 16C15



光纤插座_RF射频同轴_欧式连接器



Type-c插座_USB3.0_HDMI_DP



耳机插座_卡侬座_HP音响插座

产品名称：排母连接器

领取参观证件

产品介绍：

- 光纤插座采用阻燃PC合金料，符合ISO/IEC11801标准，低损耗传输光信号，适用于弱电箱及通信设备。RF射频同轴支持DC-18GHz频率，50/75Ω阻抗，耐-65~165°C，500次插拔，适配通信与微波设备。欧式连接器符合DIN41612标准，2.54mm网格，-55~125°C稳定工作，用于工业控制与医疗电子，三者为电子系统提供可靠连接。
- Type-C、USB3.0、HDMI和DP接口，Type-C支持正反插，USB3.0传输速度达5Gbps，1GB文件约3秒传完。HDMI和DP支持4K@60Hz高清输出，兼容HDR，画面清晰流畅。带过流、过温保护，适配Windows、macOS等系统，即插即用。适用于笔记本、手机等设备，办公娱乐皆可。
- 耳机插座支持3.5mm等规格，DC 30V/0.5A，接触电阻≤0.03Ω，5000次插拔寿命，适用于消费电子。卡侬座采用平衡传输，抗干扰强，支持远距离传输，3000次插拔，用于专业音频设备。HP音响插座适配大功率设备，耐高压，保障音响系统稳定。均符合RoHS，覆盖消费电子、专业影音等领域。

展前预览——设备、材料、其他

扫码登记参观

太阳油墨贸易(深圳)有限公司 16C45



产品名称：感光性阻焊干膜

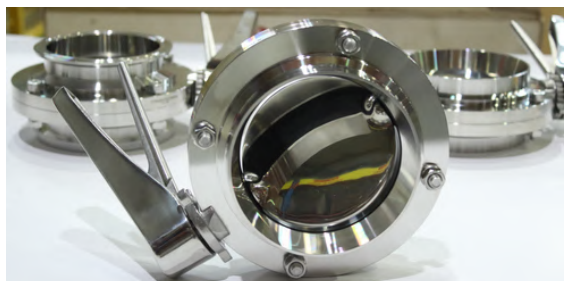
产品介绍：

感光性干膜AUS系列，其优异的产品性能（如分辨率、附着力、耐电镀性）在高端IC载板和先进封装领域等高端市场具有较高的认可度。

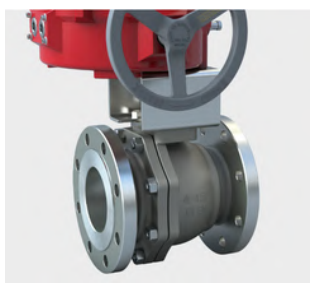
>>回目录页

领取参观证件

博雷（中国）控制系统有限公司 16B45





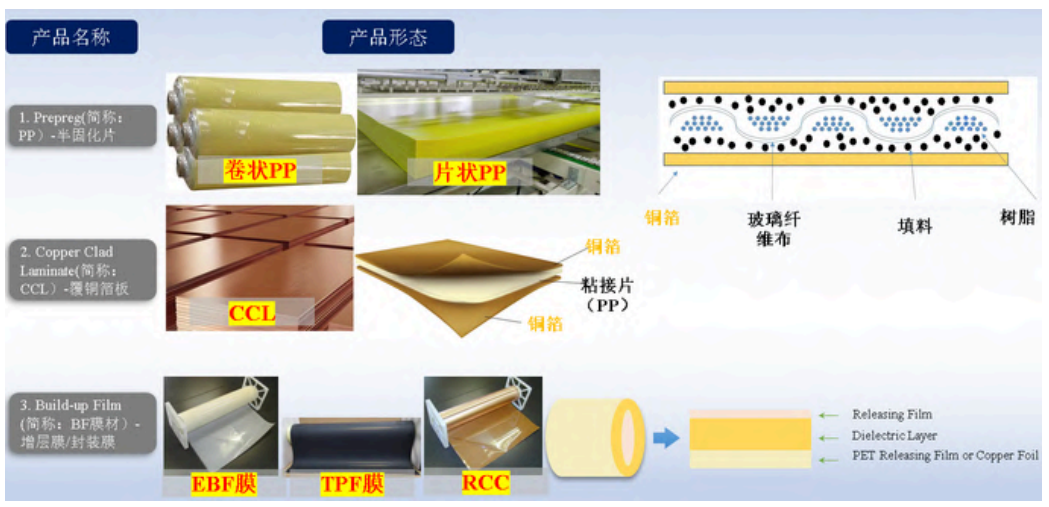


产品名称：双偏心、F15、 S7000/8000、EBV、S3G、S3Y、执行机构

产品介绍：

双偏心（不锈钢大号）、F15、 S7000/8000、EBV、MINI球阀、S80、各类阀座、减压阀、S21/S22 PTFE、气动调节蝶阀、座阀、气动蝶阀/球阀、手动蝶阀、S3G、S3Y、S15V+S98、电动座阀不锈钢、平衡阀（4个）、S4X＋阀板抛光、S72执行器

广东伊帕思新材料科技有限公司 16E05



产品名称：覆铜板，半固化片，积层膜

产品介绍：

伊帕思是一家专业从事半导体电路基材研发、生产、销售的国家高新技术企业与专精特新企业，其BT基板材料、BF积层膜及极低损耗高频高速材料的性能已经达到国际领先水平，为半导体行业提供技术先进的基础材料及解决方案；公司主营产品：IC封装基板、LED封装基板、Mini&Micro LED显示类基板、高速FR4基板、FR4基板、EBF增层胶膜、TPF封装胶膜，JBS导热胶膜。

深圳市拓普微科技开发有限公司 16A01



产品名称：LMT101GNLFWA-NND, 10.1寸彩色TFT, 1280x800 CTP LVDS

产品介绍：

IP65正面防尘防水，

1280x800高分辨率，显示画面清晰，

850cd/m^2高亮度，阳光下可见，

电容式触摸屏，灵敏流畅

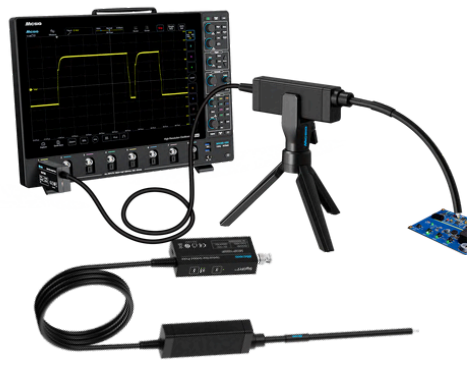
展前预览——设备、材料、其他

扫码登记参观

深圳麦科信科技有限公司 16E21



12位高分辨率
示波器 MHO6系列



第三代SigOFIT 光隔离
探头MOIP系列



第六代高分辨率平板示波器
MHO1系列

>>回目录页

领取参观证件

产品介绍：

- 12位高分辨率示波器 MHO6系列：MHO高分辨率示波器6系，1GHz带宽、6GSa/s的实时采样率、8 个模拟通道、1800Mpts的存储深度、12位垂直分辨率； 其高带宽和8通道特点适合于更高速的电路分析和更多的信号同步测试。
- 第三代SigOFIT 光隔离探头 MOIP系列： 麦科信第三代光隔离探头MOIP系列，带宽覆盖200MHz-1GHz，支持测量±0.01V至±20kV差模信号。基于独家SigOFIT™光隔离技术，MOIP系列在100MHz时共模抑制比高达128dB，隔离电压85kV，底噪低至0.3mVrms，是判定其他电压探头所测信号真实性的终极裁判。第三代MOIP系列搭配独家ADHOMT模数混合激光调制技术，真正实现零温漂、免校准、开机即用、无需预热，支持 24 小时连续稳定输出，测量精度优于1%。同时支持0dB/20dB双量程切换，有效提升信噪比；输入电容最低仅1pF，适用于SiC/GaN栅极驱动、高压高频功率测试等场景，且衰减器与光纤长度均支持定制。
- 第六代高分辨率平板示波器 MHO1系列：麦科信 MHO1 系列是一款极致便携的专业级高分辨率示波器，内置 12bit 高精度 ADC，具有高达 200MHz 带宽、4 个模拟通道、1GSa/s 的实时采样率、110Mpts 的存储深度。机身厚度仅 3.1 厘米，轻松放入背包，内置大容量锂离子电池，更支持 Type-C 接口充电。

广东中科微精光子制造科技有限公司 16D60



高精度激光切割设备

激光剥线设备

激光屏蔽片焊接设备

产品介绍：

- 这是一款精密激光切割设备系列，专为芯片模组、摄像头模组、TYPE-C等模组的全自动分板切割而设计。设备支持0.02mm至4mm厚度材料加工，加工精度达±30μm，最小成品孔径50μm，孔径精度±0.01mm。采用全自动上料与摆盘系统，配备双头激光切割检测，切割边缘无裂纹；直线电机驱动，精度高、速度快，可一次性完成切割与自动裂片。配置多功率切割头，灵活满足不同产品需求。
- 这是一款专为高速线缆组件设计的激光剥Mylar设备。设备采用方通钢架平台与直线模组，结构稳固；搭载定制二氧化碳激光器，高效稳定。结合CCD视觉定位，可无缝集成自动化产线。双振镜加工模块支持上下同时加工，大幅提升效率。内置除尘模块有效防止产品表面氧化与废料飞溅，保障加工洁净度。精准去除Mylar层与内被，不损伤导体，适用于高速线缆精密加工。
- 这是一款专为高速连接器工艺制程中屏蔽片焊接而设计的高精度低损伤激光焊接设备。设备采用桌面式结构与快拆式治具定位设计，配备XZ轴伺服平台，结合CCD视觉定位，可轻松集成自动化产线，兼顾试产与量产过渡需求。定位精度达0.02毫米，重复定位精度0.01毫米，焊点直径≤0.2毫米，热影响区域<50微米，拉拔力>5N，并具备±1%能量波动控制能力。特别适用于0.1mm级薄壁屏蔽片的微米级精密焊接，在保证高强度连接的同时，最大限度降低热损伤，显著提升产品良率与可靠性。高效、精准、稳定。

广州市鸿利光显科技有限公司 16D56

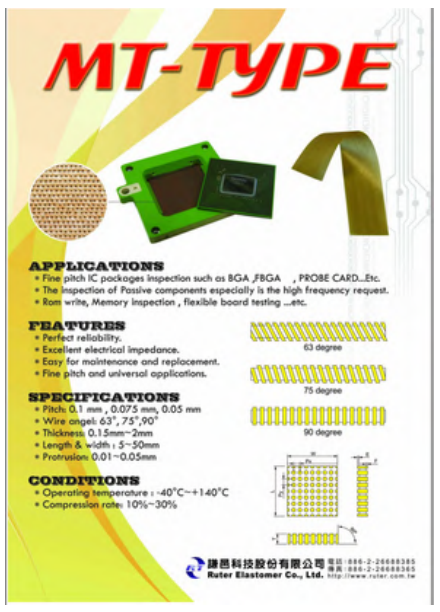


产品名称：高光效2835 最高光效250LM/W可批量作业，前装车规系列 满足16949和AEC-Q102认证

产品介绍：

- SMD LED 封装光源：依托鸿利智汇自研自动化无尘产线，覆盖 TOP、CHIP、EMC 大功率、RGB 全彩系列灯珠。背光类 LED：电视、显示器、工控屏专用背光灯珠，发光均匀、功耗低、使用寿命长，适配各类液晶显示配套；照明类 LED：室内商用照明、户外亮化光源，光效稳定、散热性能优异；RGB 全彩灯珠：高一致性色彩，为室内外 LED 显示屏、亮化工程、氛围灯光提供核心发光单元；车规级 LED 光源：通过严苛车规认证，用于汽车大灯、日间行车灯、车内氛围灯，耐高低温、抗震动，安全性与稳定性达标车载使用标
- COB 集成光源、直插 LEDCOB 集成光源聚光性强

謙邑科技股份有限公司 16A05







>>回目录页

领取参观证件

产品名称：導電膠

产品介绍：

應用於各種封裝後的芯片及被動元器件等多項產品測試

深圳市江山来电子制造有限公司 16B01



直流散热风扇



直流散热风扇

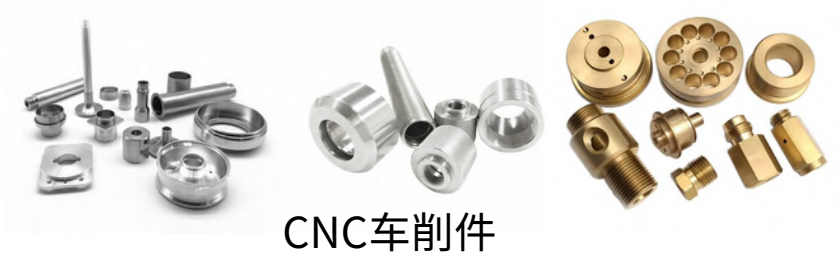


直流鼓风机

产品介绍：

- 直流散热风扇：黑色烤漆铝合金压铸（工业级）或PBT+30%玻纤（阻燃UL 94V-0标准），PBT注塑一体成型，增强结构稳定性，PWM调速、FG转速反馈、堵转自动重启，-30°C～+85°C（工业级）/ -10°C～+70°C（民用），工业级标配，寿命＞60,000小时（40°C环境）
- 直流散热风扇：尺寸仅20×20×6.5mm³，重量极轻，可集成于微型设备内部（如传感器模组、便携设备），最大限度节省空间。支持-30°C至85°C环境温度连续工作，高温不降速，低温启动稳定，适用于极端工况。支持PWM/电压调速（5V/3V双电压兼容），可根据设备温度动态调节转速，平衡散热与能耗。运行噪音≤25dB（图书馆环境≈30dB）无共振设计，适合医疗仪器、办公。
- 直流鼓风机：50×50×15mm³（长×宽×高），微型涡轮离心结构，轴向进风+径向出风设计，扇叶及框架采用PBT+30%玻纤增强材料，符合UL 94V-0阻燃标准，支持PWM调速、FG转速反馈、堵转报警及自动重启功能，反接保护设计，避免误操作损坏

深圳市庭锋五金制品有限公司 16D37



CNC车削件



压缩弹簧、扭转弹簧、拉伸弹簧、电池弹簧



螺丝

产品介绍：

- 庭锋五金专业定制精密CNC车削件，采用日本津上/西铁城走心机加工，稳定公差±0.005mm，表面粗糙度Ra 0.2-1.6μm。适配铝合金、不锈钢、黄铜、钛合金等多种材质，可做阳极氧化、电镀、钝化、PVD等表面处理。支持车铣复合、多轴联动加工，广泛应用于消费电子、汽车电子、通讯及新能源领域。
- 庭锋五金可定制各类精密弹簧，涵盖压簧、拉簧、扭簧、电池接触弹簧等品类。可依据图纸或样品开发生产，可选碳钢、不锈钢、铜合金等材质，适配多种表面处理工艺。产品弹力稳定、公差精密、抗疲劳性能优异，可满足高盐雾耐腐蚀需求。广泛应用于新能源、无人机、汽车电子、医疗器械、智能家居等领域。
- 庭锋五金供应各类精密螺丝，覆盖盘头、杯头、沉头、防松点胶等多种规格，现货 SKU 达 10000+。产品包含机牙螺丝、自攻螺丝，支持标准件现货采购以及非标定制。具备优异精度与耐腐蚀能力，可做镀锌、镀镍、达克罗、氧化等多种表面处理，实现高盐雾要求，最高可达1000+小时盐雾。适配军工、新能源、汽车电子、医疗器械、消费类电子等行业。

东莞市纳百智造技术有限公司 15B91







产品名称：導電膠

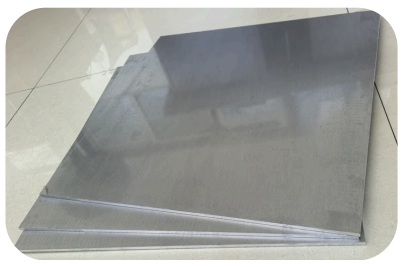
产品介绍：

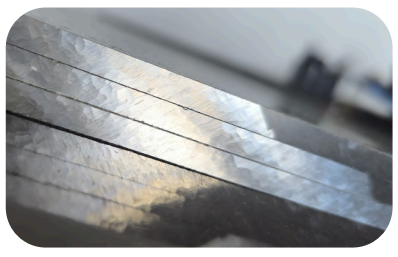
半导体、储能、新能源、医疗、智能机器人等设备机壳、结构件加工。

>>回目录页

领取参观证件

海阳潼源凯新材料科技有限公司 16D28





产品名称：微晶复合板

产品介绍：

潼源凯微晶复合板，是针对电子制造波峰焊工艺专属研发的铝基新型合金材料，依托微晶合金改性技术，兼具耐高温、低形变、易加工、可回收、低成本等核心优势，是传统合成石、钛合金波峰焊治具的优选替代材料，旨在全面解决传统治具材料在加工、使用、环保、成本端的痛点问题，是波峰焊治具制造的升级优选材料。

东莞市迈强电子科技有限公司 16D20



UTG9000T+系列 函数/任意波形发生器



UTS7000A系列 信号分



UPO70000系列
数字荧光示波器



MSO8000HD系列 高分辨率示波器

产品介绍：

- UTG9000T+系列是旗舰级函数/任意波形发生器，以极致性能满足严苛测试需求。采用先进DDS技术，输出频率高达500MHz，满足高速数字与通信应用。优利德自主Ultra Arb（UA）技术保证信号极致纯净与精度，实现万分之一斜波对称性精度，10Hz超低频仍完美如初，性能较国外同级产品提升10倍。通道隔离度达近端87dB、远端124dB，四通道支持任意耦合、合并与跟踪，配合优化的IQ模式，为无线通信与雷达仿真提供强大支持。
- UTS7000A系列信号分析仪，最大可测量频率40GHz，支持交流和直流耦合，直流耦合状态最小可测量2Hz，全频段频率计精度低至0.01Hz。显示平均噪声电平为 -166dBm，相位噪声在1GHz载波，偏移10kHz下为 -108dBc，扫描点数高达100,001个扫描点，采用11.6英寸电容触摸屏，分辨率为1920*1080。机箱采用4U标准高度，适合标准机架使用。
- UPO70000系列数字荧光示波器，包含两个型号（UPO71304，带宽13GHz，UPO71004，带宽 10GHz），全系列标配每通道 40GSa/s 采样率。提供 4 个模拟通道和 1 个外触发通道，提供每通道2Gpts 和 4Gpts 存储深度可供选择，此外还有多种硬件和软件分析功能供您灵活配置，充分满足您日益增长的测试需求。
- MSO8000HD 高分辨率示波器，8GHz带宽与20GS/s采样率强强组合，准确捕获并显示高速的信号能力，为高速信号的测量提供强有力的支持。12bit分辨率适合高速信号的测试场景，在观测信号的同时，避免失真或截断。小优AI助手的加持，实现测量决策辅助、信号异常检测等功能，显著提升测试效率与精度。广泛应用于包括通信、半导体、计算机、集成电路设计、工业电子，汽车电子研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试。

深圳市模量科技有限公司 16E27

产品介绍：



MoVi视触觉



MoGlo
数采手套



MoTe压力分布测试系统

- MoVi: 模量科技全栈自研的高精度视触觉产品，凭借超 15 万个有效感知点与超灵敏分辨率，实现六维力的高保真实时采集。
- MoGlo数采手套：模量科技全新自研数采手套，感知点覆盖手掌及五指关键区域，凭借超高空间分辨率与灵敏响应，精准捕捉抓握压力及多维触觉信息
- MoTe压力分布测试系统：柔性薄膜压力传感器，依托高灵敏度柔性传感材料与分布式阵列设计，实现接触面压力分布的实时可视化。

上海智恒胜新材料科技有限公司 16D16



产品名称：碳化硅模块灌封

>>回目录页

领取参观证件

产品介绍：

具有双85高温高湿（85°C/85%RH,1000h零分层）、抗冷热冲击（-45°C~150°C 1000 cycles）、高Tg、优异电绝缘性、低氯含量、低收缩等优异性能。

上海贺利氏工业技术材料有限公司 14C50



产品名称：Welco超细间距焊锡膏和先进封装助焊剂

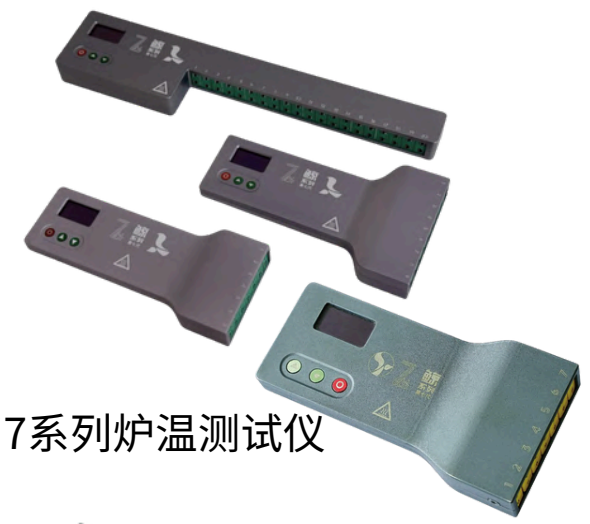
产品介绍：

- MoVi: 模量科技全栈自研的高精度视触觉产品，凭借超 15 万个有效感知点与超灵敏分辨率，实现六维力的高保真实时采集。
- 模量科技全新自研数采手套，感知点覆盖手掌及五指关键区域，凭借超高空间分辨率与灵敏响应，精准捕捉抓握压力及多维触觉信息
- 柔性薄膜压力传感器，依托高灵敏度柔性传感材料与分布式阵列设计，实现接触面压力分布的实时可视化。

武汉锦久微技术有限公司 16C33



ROS残氧穿梭机



i7系列炉温测试仪



PIS炉温曲线智能监控系统

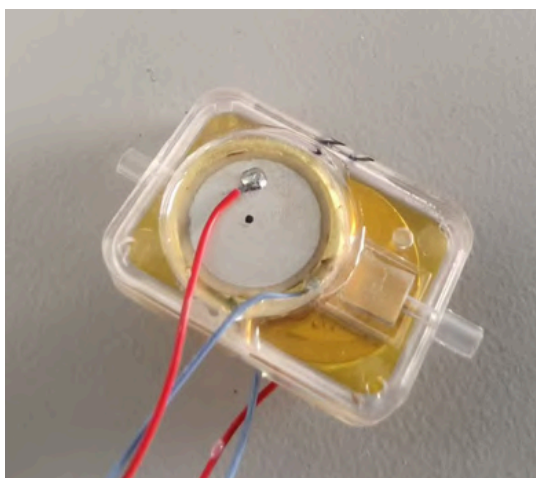
>>回目录页

领取参观证件

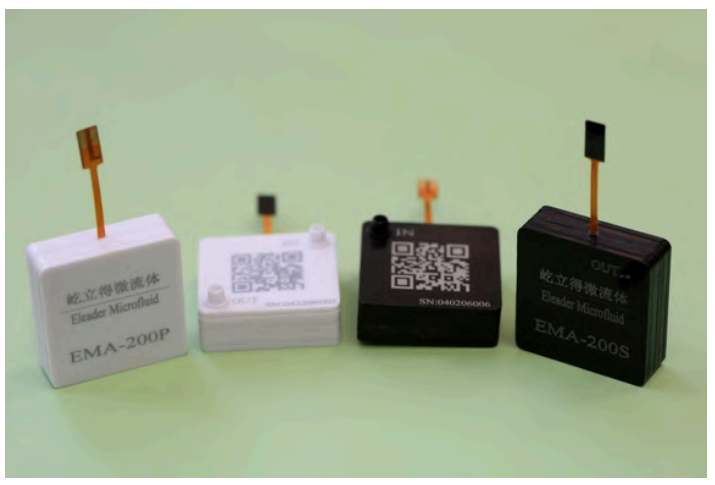
产品介绍：

- ROS 残氧穿梭机是专为氮气回流炉、真空回流焊打造的一体化检测设备。能够跟随产线链条走完整个炉膛，一次性覆盖全部温区，精破除监测盲区。同步采集残氧浓度、炉膛温度、轨道振动三组数据，生成完整氧分布曲线。可用于校准工艺参数，严控制程、稳良率、帮助企业降本增效。
- 工业级高精度智能测温设备，集成无线传输、独立液晶屏及AI预测技术，实现炉温检测，保障测试安全高效，降低人工干预；使用场景：焊接工艺：回流焊、氮气回流焊、波峰焊、选择性焊接设备测试。精密制造：半导体封装、新能源电池温控验证。涂装拱干：汽车/工业涂装烘炉温度检测。核心功能：4小时超长续航、隔热耐温、曲线仿真、报告自动化、可视化管理、制程自适配、模块化配置、大容量存储、存储兼容优化；适用行业：汽车电子、半导体、军工、新能源、涂装、SMT电子制造、精密焊接等。
- 实现 365 天 24 小时不间断监控炉温曲线，实时显示 SPC/CPK 制程图表、氧含量、UPH 统计及九宫格看板，并支持轨道振动与热风马达转速监控；行业首创：真空度在线监测系统，填补真空回流焊的数据盲区，多通道实时采集真空度、温度、压力，确保制程工艺稳定。

吉林屹立得微流体科技有限公司 16D66



压电液泵



大流量压电气泵

产品介绍：

- 压电液泵：可以输送大部分低粘度液体，体积小，17mm/12mm/4mm(长宽高)，10mm/10mm/4mm(长宽高)
- 大流量压电气泵：大流量压电气泵，结构紧凑，静音工作，尺寸30mm*30mm*7mm，可用于供气，增压，负压，等领域，最大流量2.0L/min ,最大压力30KP

东莞市盟拓智能科技有限公司 14C85



产品名称：引线键合3D AOI、高精度3D SPI/植球3D AOI二合一检测设备、基板涨缩分选设备

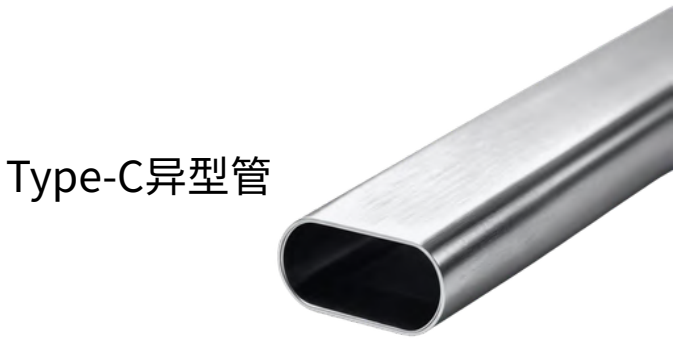
产品介绍：

- 引线键合3D AOI是Mini LED显示、半导体封装专属检测设备，依托高精度视觉检测技术，全自动识别金线断线、偏线、弧度异常、键合虚焊、压点不良、塌陷等各类键合缺陷。设备针对高密度金线阵列场景专项优化，检测稳定、精度高，可完全替代人工目检，搭配完善的数据追溯功能。
- 高精度3D SPI/植球3D AOI二合一检测设备部署于锡膏印刷工序之后，是 Mini/Micro LED、板级封装、基板植球产线前端关键质控设备。针对大量微小焊球在键合前检测难点(如球距不均、共面性等)、微焊盘、高密度阵列基板微小锡膏难以精准检测的行业痛点，设备采用高速三维相位重建光学方案，非接触式采集锡膏三维形貌，高精度测量锡膏厚度、实际体积、覆盖面积、坐标偏移量。
- 基板涨缩分选设备针对基板高温制程引发的涨缩形变问题，搭载高精度视觉测量系统，自动检测基板 X、Y 方向形变数值，并按照涨缩区间完成智能分级分选。

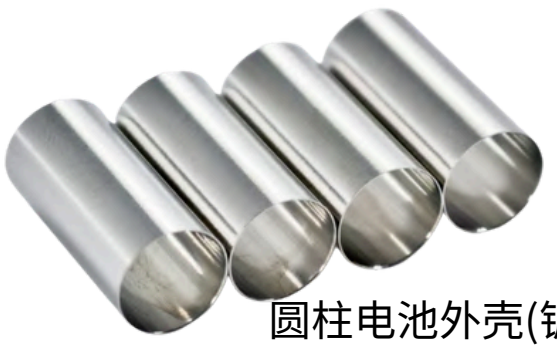
中山市擎钢不锈钢制品有限公司 16D06



304连接套管



Type-C异型管



圆柱电池外壳(镀镍不锈钢)

产品介绍：

- 该SUS304精密锥形管件主要应用于医疗器械、精密自动化设备及流体控制系统，例如内窥镜组件、微创手术器械、半导体设备、实验分析仪器及机器人精密机构中，作为导向套、连接套、定位件或流体通道组件使用。凭借高精度加工能力和优异的不锈钢性能，可满足高可靠性、高洁净度及长期稳定运行的应用需求。
- Type-C接口精密异型不锈钢管是专用于USB Type-C数据线金属连接器外壳制造的高精度原材料。产品采用优质不锈钢材料，通过精密拉拔、异型成型及激光加工等工艺制造，具备高尺寸精度、高强度、耐磨耐腐蚀及优异表面质量等特点。该产品可精准匹配Type-C连接器结构要求，满足后续冲压、切割及自动化组装需求
- 圆柱形锂离子电池高精度金属壳体,采用优质不锈钢基材，表面经精密电镀镍工艺处理，兼具卓越的耐腐蚀性,适用于新能源汽车、储能系统、消费电子等领域

>>回目录页

领取参观证件

热门会议——嵌入式大会

>>回目录页

扫码登记参观

作为华南地区唯一的**电子与嵌入式核心专展，elexcon第23届深圳国际电子展暨嵌入式展**展会同期还将围绕行业前沿热点举办多场主题会议论坛，聚焦产业落地与趋势发展，为行业同仁提供深度技术交流与资源对接的平台。展会同期还将举办多场嵌入式、电子、光电与半导体领域专业会议及技术活动。同时还将为**工程师开发者打造Kaifa Gala大湾区开发者/工程师嘉年华**，以线下实战呈现前沿硬件应用。 集中研讨嵌入式系统、边缘AI、汽车电子与先进封装产业的创新路径与发展机遇，相关会议 如下：

▶第八届中国嵌入式技术大会聚焦三大产业刚需赛道：

- **嵌入式与边缘 AI 融合落地**

围绕端侧大模型轻量化部署、MCU/NPU 异构算力调度、低延迟边缘推理、软硬协同功耗平衡展开深度探讨，破解 AI 算法落地硬件时性能不稳、功耗超标、适配周期长等行业普遍痛点，加速智能终端、感知设备的 AI 规模化商用。

- **机器人嵌入式**

面向工业机器人、服务机器人、国产人形机器人赛道，解析多轴协同控制、实时伺服调度、环境感知嵌入式架构、安全冗余设计等关键技术。针对机器人高精度、高动态、高可靠的运行需求，输出整套嵌入式控制系统成熟方案，支撑本土机器人产业规模化扩产升级。

- **工业与能源管理嵌入式调控**

紧扣绿色低碳转型大势，覆盖工业设备能效管控、储能变流器、光伏风电、充电桩、楼宇能耗调节等场景。依托嵌入式实时调度实现负载动态匹配、精细化能耗节流、设备故障预判与安全防护，助力制造、新能源行业降本增效，适配双碳政策下的产业升级要求。

部分参与企业

中电港、ARM、NXP、达摩院-玄铁、Linaro、安勤科技、瑞萨电子、ADI、研华科技、兆威机电、苦芽科技、灵动微、睿赛德、航顺芯片等

>>回目录页

领取参观证件

热门会议——嵌入式大会

>>回目录页

扫码登记参观

热点议题，覆盖全维度需求

>>回热门主题会议页面

领取参观证件

时间	演讲者	演讲主题
主题演讲 主持人：何小庆 大会主席&嵌入式系统联谊会秘书长		
9号10:30-10:55	Arm 高级嵌入式市场经理 杨瑞	ExecuTorch on Arm
9号10:55-11:20	恩智浦大中华区高级市场经理 申靓	边缘智能时代的嵌入式演进NXP Seminconductors
9号11:20-11:45	研华科技 资深产品经理 林思源	AI赋能边缘新局，产业转型全面启动
9号11:45-12:10	达摩院-玄铁 RISC-V 解决方案部门核心骨	RISC-V 在 NPU 设计中的优势与探索
9号12:10-12:35	Linaro Ltd,Linaro expert,Stefan Schmidt	从嵌入式Linux基础到CRA合规: Linaro LTS一站式解决方案，助力中国设备商出海欧洲
9号12:35-13:00	**边缘AI创新奖颁奖**	
嵌入式AI与边缘AI技术		
9号14:00-14:25	芯科科技	芯科科技
9号14:25-14:50	瑞萨电子 高级应用工程专家 凌滔	《构建端侧智能技术生态，加速产业AI落地》
9号14:50-15:15	深圳中电港技术股份有限公司 中电港萤火工场 副总经理 沈奕鹏	中电港端侧AI的创新发展策略：技术启新，生态致远，具身拓局
9号15:15-15:40	安勤计算机应用科技(上海)有限公司 总经理 林德丰	边端智变·芯启未来——边缘算力与端侧多元应用
9号15:40-16:05	华南理工大学 副教授 毕盛	端侧AI到具身智能：嵌入式系统的全栈开发与工程实践
机器人关键技术 主持人：毕盛 大会专家委员会&华南理工大学计算机科学与工程学院副教授		
10号 10:00-10:25	中山大学 教授 陈刚	面向机器人视觉感知的硬件加速器设计
10号 10:25-10:50	Analog Devices, Inc. ADI 中国区产品市场经理 张一峰	ADI技术助力人形机器人创新发展
10号 10:50-11:15	研华科技 资深产品经理 田仁俊	研华科技：物理AI与机器人的核心构建模块
10号 11:15-11:40	上海苦芽科技有限公司（Kubuds） 联合创始人 吴伟	RISC-V 在具身智能机器人场景中的应用
10号 11:40-12:05	深圳市兆威机电股份有限公司 副总经理 陈毅东	具身智能大赛道下灵巧手电控技术探讨
工业与能源管理 主持人：林金龙 大会专家委员会&北京大学软件与微电子学院教授		
10号 13:30-13:55	瑞萨电子 高级现场应用工程专家 王莎莎	《瑞萨MCU/MPU：赋能安全、智能和可靠的自动化制造》
10号 13:55-14:20	上海睿赛德电子科技有限公司 华南区商务总监 李涛	RT-Thread睿擎工业开发平台加速国产升级
10号 14:20-14:45	上海灵动微电子股份有限公司 MCU市场经	智控电机，聚力智造 —灵动微 MM32系列芯片赋能工业能效革新
10号 14:45-15:10	深圳市航顺芯片技术研发有限公司 航顺芯片创始人/董事长/CEO 刘吉平	航顺HK32 M0→M3→M4再迭代升级，极致性价比拉爆
10号 14:45-15:10	重庆邮电大学 副教授 陈昌川	红外成像与测温在工业上的应用
10号 15:35-16:00	长沙理工大学 教授/院长 谢国琪	ZVM嵌入式虚拟化实时操作系统

*以上会议以最终实际为准。

▶新能源汽车电子创新技术论坛

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展打造新能源汽车电子创新技术论坛，聚焦电动化与智能化深度融合的痛点与突破，包含**车载中央计算平台、功率半导体应用、车载嵌入式系统、热管理、智能座舱与自动驾驶硬件**方案，汇聚整车厂、Tier1、元器件供应商技术负责人，分享最新研发进展与量产实践，直面车载硬件国产化过程中的各类技术与认证难题，搭建汽车电子产业链高效沟通桥梁，为行业打造技术攻坚与产业落地的关键平台！

热点议题，覆盖全维度需求

时间	演讲者
10:00-10:10	主办方致辞
10:10-10:40	自动驾驶跨域融合电子架构-林大洋，北汽研究总院智能网联中心，专业总师
10:40-11:10	构建面向AI时代的整车电子电气架构-谢彬，德赛西威，部门经理
11:10-11:40	汽车电子磁性器件解决方案-岑科科技(深圳)集团有限公司 新能源总经理 杜军
12:10-13:30	午休及展区参观 Lunch Break&SiP Zone
13:30-14:00	AI大模型驱动下的整车电子电气架构重构 重庆长安汽车软件科技有限公司
14:00-14:30	经典工艺、创新应用，贝岭特高压平面MOS应用于BMS等，实现降本增效 上海贝岭汽车电子市场经理 张飞
14:30-15:00	面向中央计算与区域控制E/E架构的车用基础平台与量产实践 普华
15:00-15:30	从L3智驾域控到舱驾融合-均胜电子
15:30-16:00	面向中央计算与区域控制E/E架构的车用基础平台与量产-普华
16:00-16:30	从舱驾一体到国产芯片落地：东风天元智舱平台的开量实践与思考-东风研究院

**以上会议以最终实际为准。*

elexcon联合**汽车产业链服务平台OE汽车举办2026深圳国际汽车电子创新技术论坛**，探讨汽车电子技术的创新与发展。同期举办**汽车电子专场采供对接会**，为企业精准匹配供需资源，缩短沟通链路。

>>回热门主题会议页面 >>回目录页

领取参观证件

▶SiP China第十届系统级封装大会

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展联合主席单位**芯和半导体、天孚通信、阿里云**同期举办**“SiP China第十届系统级封装大会”**，在三展联动背景下，共启**“AI 算力时代下的系统级革新：CPO 技术演进与先进封装创新”**的新篇章！

领取参观证件

热点议题，覆盖全维度需求

- **主论坛：宏观趋势与生态共建**
- 聚焦行业顶层逻辑，探讨封装如何重塑系统价值

- **分论坛一：2.5D/3D Chiplet异构集成**
- 聚焦AI算力芯片与存储的极限挑战

- **分论坛二：光电互连与供电**
- 本届大会最大特色板块，首次引入光互连与极致供电技术

- **分论坛三：工艺、材料与设备**
- 聚焦先进封装落地的物理实现与良率保障

>>回目录页

>>回热门主题会议页面

时间	演讲者	演讲主题
主论坛：宏观趋势与生态共建 主席：芯和半导体科技（上海）股份有限公司 创始人&董事长 凌峰博士		
9号10:15-10:25	大会杰出贡献奖颁奖	
9号10:25-10:50	主席开幕演讲 创始人&董事长 凌峰博士	芯和半导体
9号10:50-11:15	康宁 先进封装和玻璃晶圆事业部全球业务拓展总监 張建之	先进封装的创新材料解决方案
9号11:15-11:40	长电科技 副总裁，技术服务事业部总经理 吴伯平	异构集成与芯粒封装解决方案
9号11:40-12:00	苏州苏纳光电有限公司 电学被动元件产品线总经理 吴海华	AI算力浪潮下的硅电容解决方案
9号12:00-12:25	上海图灵智算量子科技有限公司 副总经理 战永兴	光量子计算：从芯片集成到系工程化
9号12:30-13:30	午休及展区参观	

**以上会议以最终实际为准。*

热门会议—SiP China

>>回目录页

扫码登记参观

时间	演讲者	演讲主题
分论坛一：2.5D/3D Chiplet异构集成 分论坛主席：阿里云智能集团 首席云服务器架构师和研发总监/CXL和UCIe董事会成员 陈健		
9号13:30-13:55	西门子EDA 全球副总裁、亚太区技术总经理 Lincoln Lee	西门子EDA AI高效提升异构封装设计及验证效率和性能
9号13:55-14:20	中茵微电子（北京）股份有限公司 CEO特别助理 董超	中茵微AI ASIC定制平台及先进封装
9号14:20-14:45	深圳市比昂芯科技有限公司 研发总监 吴晨	智驱左移：AI优化驱动芯粒/系统级EDA设计与验证迭代
9号14:45-15:10	锐杰微先进封装研究院院长兼郑州公司总经理 张龙	先进封装技术从制造到创造
9号15:10-15:35	天芯互联科技有限公司 产品总监 张伟杰	先进封装在光电共封中的应用
9号15:35-16:00	心动微电子科技（北京）有限公司 IP与定制芯片事业部市场运营副总裁 王刚	突破DDR和Serdes速度极限打造AI大模型高带宽内存和高速互联引擎
分论坛二：光电互连 分论坛主席：天孚通信		
10号09:30-10:00	签到及入场	
10号10:00-10:25	艾为电子技术有限公司 芯片封装首席专家 史洪宾博士	泰超大尺寸玻璃基CPO封装的工艺可靠性挑战及解决方案
10号10:25-10:50	烽火通信科技股份有限公司 互连技术专家 汤荣耀	应用于下一代NPO交换机的互连及仿真技术
10号10:50-11:15	联合微电子中心有限责任公司 硅光中心主任 冯俊波	CPO加速硅光集成技术迈入2.0阶段
10号11:15-11:40	武粤光电 联合创始人/副总经理 刘思旸	硅光迈入片间互连时代的发展与挑战
10号11:40-12:05	上海易卜半导体有限公司 技术开发部经理 顾人杰	深耕光电融封，共探技术演进之路
10号12:30-13:30	午休及展区参观	
分论坛三：工艺、材料与设备（制造与硬科技） 分论坛主席：启诺迪 全球电路金属化产品总监 肖应强		
10号13:30-13:55	上海贺利氏工业技术材料有限公司 贺利氏电子 | SEMI业务开发经理 谢志杰	贺利氏先进封装材料解决方案
10号13:55-14:20	启诺迪 全球电路金属化产品总监 肖应强	赋能先进封装：启诺迪关键材料方案
10号14:20-14:45	盟拓智能 董事长 唐阳树	AI驱动的封装良率闭环：从键合到集成，智能检测赋能全流程质量追溯
14:45-15:10	高算力驱动下的先进封装与封装基板技术演进及趋势	奥芯半导体 CEO/CTO 莫建勇
15:10-15:35	ersa	ersa
15:35-16:00	上海天承科技股份有限公司 首席技术专家 韩佐晏	玻璃赋能先进封装：聚焦 TGV 通孔金属化

领取参观证件

*以上会议以最终实际为准。

>>回热门主题会议页面 >>回目录页

热门会议——固态变压器

>>回目录页

扫码登记参观

▶固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛

由elexcon联合AI PowerDC 、世纪电源网共同举办，本次固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛与主题展，聚焦 SST全产业链技术创新与产业落地，**打通「科研 - 器件 - 整机 - 应用 - 标准」全链路**，汇聚顶尖高校、头部整机厂、核心器件商、数据中心运营商等全产业链力量，打造 SST 领域最具影响力的技术交流、产业对接、品牌展示平台。

热点议题，覆盖全维度需求

时间	演讲者	演讲主题
9号10:00-10:30	伊顿 研发副总裁 郑大为	迈向AIDC的供电架构发展机遇
9号10:30-11:00	村田（中国）投资有限公司 资深产品工程师 肖坤	村田电源关于SST应用中SiC驱动DC-DC的技术考虑
9号11:00-11:30	艾德克斯 技术工程师 宋辰辰	固态变压器（SST）从研发到产业化：如何构建完整的测试验证体系？
9号11:30-12:00	威派森 研发总监 郑庆杰	SST功率电感损耗分析与测试
9号12:00-12:30	午休及展区参观 Lunch Break & SiP Zone	
9号14:00-14:30	浙江大学 副教授 李楚杉	面向AIDC的固态变压器关键技术与35kV接入方案思考
9号14:30-14:50	深圳市京泉华科技股份有限公司 研发总工 谢光元	浅谈MFT产品的工程落地和量产管控
9号14:50-15:10	维谛 Power解决方案部产品专家 李	AI动态电力集群的供电方案趋势及挑战
9号15:10-15:30	哈尔滨工业大学 教授 李彬彬	固态变压器的进展与挑战探讨
9号15:30-16:00	河北工业大学 教授 张哲	面向固态变压器（SST）的高频双向直流变换拓扑及其控制方法

**以上会议以最终实际为准。*

部分参与企业

伊顿、村田、艾德克斯、威派森、京泉华、维谛等

>>回热门主题会议页面　　>>回目录页

领取参观证件

热门会议——AI数据中心

>>回目录页

扫码登记参观

▶AI数据中心光电融合技术创新论坛 | 聚焦NPO

本次论坛汇聚NPO行业专家与产业链龙头企业，围绕 NPO 方案、连接器件选型、产业链协同、标准化建设、AI 集群落地案例展开深度研讨，剖析技术痛点与产业化挑战，**打通从器件到整机落地的协作链路，共同探索 NPO 落地，助力我国 AI 数据中心光电融合技术高质量发展。**

时间	演讲主题
10号 13:30-13:40	领导致辞 深圳市连接器行业协会 先进基础材料专业委员会 周明亮 执行主任
10号13:40-14:05	CPO 场景中的光电融合与连接器技术发展 中国科学院计算技术研究所研究员 郝沁汾
10号14:05-14:30	最新SNPO规范和阿里云实践经验 阿里 系统架构师 韩天
10号14:30-14:55	立讯技术-高可靠 小间距 6.4Tbps NPO Socket 立讯技术 产品经理 程云
10号14:55-15:20	智算时代，技术与成本下的铜光共舞 胜蓝股份 CTO 周国奇
10号15:20-15:35	茶歇
10号15:35-16:00	为AI光芯片NPO互联保驾护航 是德科技 王兵
10号16:00-16:25	高速光电互连的形态演进与测试重构 微特精密 副总经理 胡保民
10号16:25-16:50	智算时代，铜创未来 — 面向大模型时代的AIDC高速互连用材料创新 博威合金 板带技术市场部 杨泰胜经理

**以上会议以最终实际为准。*

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展紧跟光电融合时代高速连接前沿发展风向，锚定连接器产业新周期的技术重心，目前已有众多连接器厂商确认亮相！

>>回热门主题会议页面　　>>回目录页

领取参观证件

▶Kaifa Gala大湾区开发者/工程师嘉年华

Kaifa Gala工程师/开发者嘉年华立足于大湾区，持续关注工程师群体的智慧与力量，用本土智慧打开全球视野,助力工程师快速把握AI落地脉搏。

同期，联合21ic 电子网重磅打造AI 开发板创新技术与应用实战工坊，共建全场景 AI 生态展示与工程师实战交流平台。

实战工坊——让技术看得见、摸得着、用得上

实战工坊以**沉浸式演示+ 真机实操 + 权威评选 + 媒体曝光**，让技术看得见、摸得着、用得上。

全场景 AI 方案集中展示覆盖通用 AI 到极致端侧的全栈能力，从通用 AI 技术、边缘 AI到端侧智能。

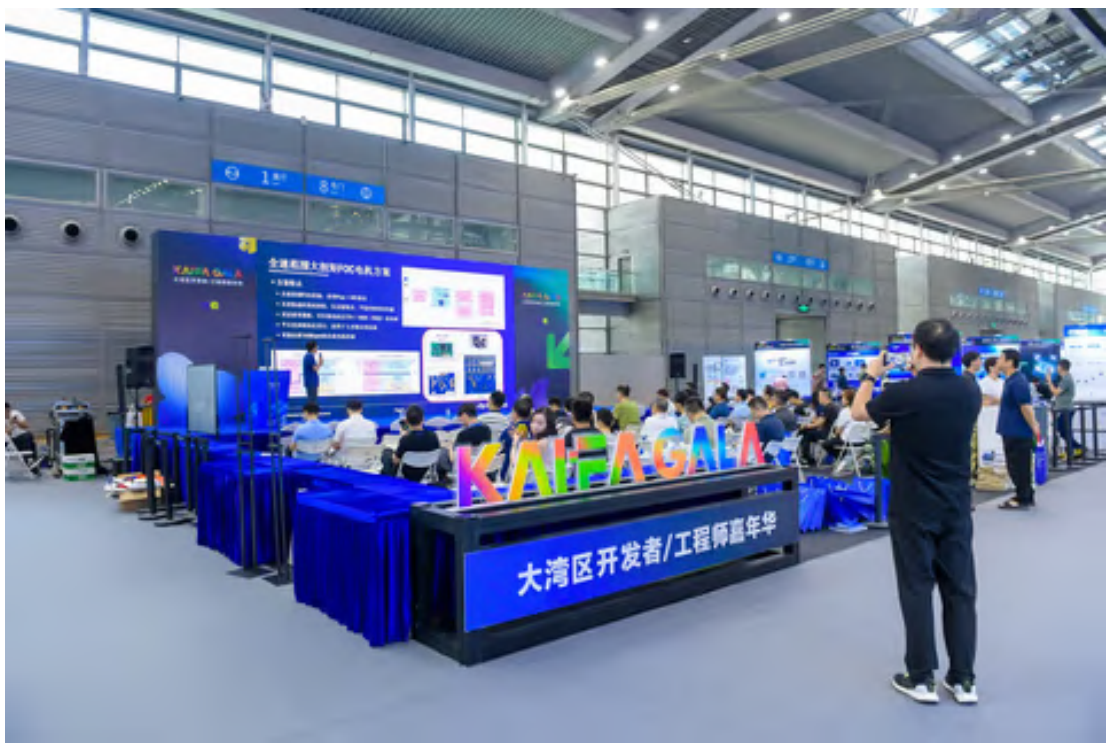
更有**专家现场演示，现场展示开发板跑分、Demo实时大屏同步**，效果直观可见。实操体验区工程师可0距离上手多款AI开发板，体验底层驱动、算法开发与应用部署技术对话。

此外，21ic 电子网“2026 最受欢迎边缘 AI 开发板”也面将于展会期间公布获奖名单！

参与Kaifa Gala大湾区工程师/开发者嘉年华，感受大湾区独特的工程师文化 —— 这里不仅有前沿技术论坛与社群碰撞，更有丰富的开发资源等你解锁。

>>回目录页

>>回热门主题会议页面





三展联动一站赋能AI算力、消费电子、汽车、具身机器人与智能制造产业链资源对接

三展联动，一证通览！构建电子嵌入式-光电-半导体一体化

elexcon第23届深圳国际电子展暨嵌入式展同期同地将举办CIOE 中国光博会以及IICIE国际集成电路创新博览会（IC创新博览会），本届三展联动，规模达到**32万平方米**，预计汇聚**超5000 家参展企业**、吸引逾**24万名专业观众**， 共同打造集技术展示、行业交流与商业合作为一体的国际化高端平台，为电子与嵌入式系统、光电、集成电路等 关键领域注入强劲创新动力；展会围绕 **AI 算力、消费电子 & AR/VR 、智能汽车与具身机器人、半导体与智能制造**四大核心赛道，打通上下游技术、供应链与商业对接通道，加速跨产业融合创新，加速产业链融合与协同发展。

▶赋能 AI 算力基础设施，构建光存电芯一体化产业生态

领取参观证件

AI 算力规模化落地是覆盖芯片、服务器、高速光互联、海量存储、供配电、数据中心集群的系统性工程，行业核心发展要素可概括为**光、存、电、芯**四大板块，三展精准分工、互补联动，完整覆盖算力全链路需求：

- **光：算力集群高速光互联底座**

解决大模型训练、推理场景下服务器间超高速数据传输需求，是算力网络互通核心载体；

- **存：海量 AI 数据承载核心**

支撑大模型海量数据集存储、高吞吐读写需求，破解算力场景存储带宽瓶颈；

- **电：智算中心稳定节能保障**

面向大规模算力集群提供高效电源、功率器件、散热配套，降低算力运营能耗；

- **芯：AI 算力性能底层上限**

GPU/ASIC/SoC、先进封装、半导体工艺材料决定算力硬件基础能力。

>>回目录页

赋能AI算力

>>回目录页

扫码登记参观

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——补齐 AI 算力集群终端配套硬件，聚焦高速存储模组、大功率电源管理、功率半导体、嵌入式边缘 AI 主板、高速互连元器件等，适配超大规模智算机房高吞吐、高密度供电需求，提供整机、板卡、嵌入式系统级完整硬件方案。

部分展示企业：

- **存储芯片：**长江存储、长江万润半导体、朗科、东芯半导体、宇瞻、科摩思、德明利、喻芯半导体、博雅、华迅、迈德迩、金胜电子、舜铭、华芯星、威刚、豪杰创新、捷龙存储等；
- **嵌入式：**研华科技、SEGGER 中国（哲戈微）、安勤科技、璞致电子、芯驿电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro、拓普微、临滴、睿赛德、研江等；
- **功率器件及电源：**京泉华、上海贝岭、爱浦、荣和美、台懋半导体、信安半导体、江智科技、鹆善电源、万芯半导体、芯北电子、汉仁等；
- **连接器：**步步精、硕凌、宇熙精密、福顺、创豪欣、精途、帎达鑫、万达、五盈、厚为电子等；

领取参观证件

CIOE中国光博会 ——信息通信展聚焦高速数据传输的核心环节，集中展示高速光模块、LPO/NPO/CPO方案、高性能光芯片、OCS 全光交换、算力组网核心高速连接器、光测试测量设备、光无源器件等，完整覆盖智算互连全链路。

部分展示企业：

- **光芯片：**COHERENT高意、MITSUBISHI ELECTRIC、SICOYA、SIFOTONICS、WD PHOTONICS、芯思杰、奇芯、铌奥光电、长光华芯、赛勒、羲禾、国科光芯、仕佳、鼎芯、剑桥、云岭、曦智科技；
- **光模块：** 海思、光迅、华工正源、新易盛、纳真科技、剑桥、立讯技术、联特、智禾光通、德科立、昂纳、长芯博创、迅特、COHERENT高意、SOURCE PHOTONICS、钧恒；
- **光纤光缆：**CORNING、长飞、亨通、长飞、中天、特发、烽火、永鼎、LIGHTERA、华信藤仓、中住光纤、通光、飞瓯、远东，日海、仕佳、雅信通；
- **交换机与服务器：**新华三、锐捷网络、烽火、光库、德科立、汇信特、博达、光派、三石园、光隆科技、星融元、丰润达、创新胜为、孛璞半导体、希力通讯；

IICIE国际集成电路创新博览会 ——半导体全产业链专业展示平台，IICIE承担着全链条底层工艺支撑的重要作用。展会不 仅展示AI核心芯片，还将集中呈现半导体关键材料、晶圆制造设备、封测设备、2.5D/3D 先进封装、混合键合异构集成等 核心技术与产品，AI算力下看先进封装如何突破芯片“内存墙”。

部分展示企业：

- **晶圆制造及封装服务：**晶合集成、武汉新芯、积塔半导体、华天科技、芯植微、佰维存储、时代民芯、锐立平芯、新 核芯、安吉海万欣…等；
- **半导体设备：**盛美上海、拓荆科技、华海清科、微崇半导体、华煜半导体、精测电子、北京中电科、中科飞测、隆友 德、华卓精科、迈为技术、东方晶源、维嘉科技、三丰精密、容道社、冠礼科技、光粒半导体、理纯洁净、海目芯微、 津上智造、钧华半导体、致和半导体、微法尔、四元数、海浥半导体、艾恩、博涛智能、芯慧联芯、佳智彩、运泰利、 伊创、幂帆科技，昌鼎电子、稳顶聚芯、华封科技、西斯特；
- **半导体材料：**沪硅产业、天科合达、安集科技、中船特气、上海新阳、清溢微、西陇科学、方大炭炭、木林升、奔朗 新材、亦盛科技、中宝新材、贵研半导体、华熔科技、道川半导体材料、云升新材、昆吾、洽美斯、宇腾、晨日 科技、 玻芯成、创格、基迈克、爱科迈、沃尔德、抚顺特钢、中色东方集团、YINCAE 英凯等；

>>回目录页

*以上仅部分代表企业，排名不分先后

赋能AI算力/消费电子

>>回目录页

扫码登记参观

三展联动相关会议

时间	会议名称	会议地点	展馆号
09/09下午	AI时代高速光传输技术创新论坛	9号馆二楼9A	9号馆
09/09下午	光电产业高峰论坛--光电“芯”未来	13号馆馆内会议室	13号馆
09/09下午	2026中国MicroLEDCPO产业链创新发展高峰论坛	14号馆二楼14B会议室	14号馆
09/09-/09/10	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1	16号馆
09/09全天	固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛	北登录大厅二楼媒体中心C	18号馆
09/09 全天	AI数据中心光电融合技术创新论坛：聚焦NPO	北登录大厅二楼媒体中心 A	北登录大厅
09/09-/09/10	第十届中国系统级封装大会——AI算力与CPO	北登录大厅二楼媒体中心 B&C	北登录大厅
09/10 全天	AI算力集群光互连技术发展论坛	9号馆二楼9B	9号馆
09/10 全天	光电融合技术与产业发展论坛	9号馆二楼9C	9号馆
09/10 上午	AI浪潮下的光电技术：行业深度洞察	13号馆馆内会议室	13号馆
09/10 下午	ePIXfab中欧硅基光电子论坛	13号馆馆内会议室	13号馆
09/10 全天	AI算力时代硅光产业峰会	14号馆内会议室-高峰论坛区	14号馆
9/10全天	先进封装与测试技术论坛	14号馆二楼14C会议室	14号馆

**会议名称以现场为准*

▶全链条赋能消费电子、AR&VR创新及发展

领取参观证件

三展联动整合消费电子、AR&VR全产业链资源，一站式集中展示光学成像及感知、新型显示、AI嵌入式、精密连接器、芯片与存储、AR/VR终端及器件、测试测量等，七大技术板块完整覆盖消费电子及AR/VR空间感知、视觉交互、端侧智能、高速互联、算力存储、性能检测全技术链路，全链条赋能消费电子、AR&VR创新及发展：

- **光学成像/感知：**高精度二维成像与三维感知，破解终端影像采集、空间交互识别难题；
- **新型显示：**打造低功耗高清柔性沉浸式视觉交互界面；
- **AI嵌入式：**端侧轻量化算力，实现设备实时智能运算与自适应调控：
- **精密连接器：**高频高速微型连接，适配轻薄化终端电子电气架构：
- **芯片与存储：**高算力核心与高速存储，支撑终端高负载运行与数据读写：
- **AR/VR终端及器件：**轻量化近眼模组，构建沉浸式虚实融合交互场景；
- **测试测量：**全维度性能检测，保障产品标定与量产可靠性管控。

>>回目录页

消费电子

>>回目录页

扫码登记参观

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——深耕电子硬件与嵌入式系统赛道，覆盖全品类电子元器件、存储芯片及模组、功率半导体、电源解决方案、边缘嵌入式 AI、连接器等硬件基础组件，补齐终端产品底层硬件供应链。

>>回目录页

领取参观证件

部分展示企业：

- **芯片及模组：**华大电子、航顺芯片、灵动微、码灵、速显微、凌烟阁、本原微、唯创知音、九芯电子、芯龙半导体等；
- **嵌入式：**研华科技、SEGGER 中国（哲戈微）、安勤科技、璞致电子、芯驿电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro、拓普微、临滴、睿赛德、研江等；
- **电子元器件：**厚声、微容、宇阳、扬兴科技、信维电子、德鸿感应、进工、芯声微、富捷科技、CCTA品牌晶振、华晟电通、军康电子、灿昇、岑科等；
- **电源：**京泉华、上海贝岭、爱浦、荣和美、台懋半导体、信安半导体、江智科技、鹆善电源、万芯半导体、芯北电子、汉仁等；
- **连接器：**步步精、硕凌、宇熙精密、福顺、创豪欣、精途、帏达鑫、万达、五盈、厚为电子等；

CIOE中国光博会 ——集中展示光学材料及元件、光学镜头及模组、3D视觉、激光雷达、光谱传感、Micro LED、硅基OLED、微显示、光波导、AR&VR一体机等。

部分展示企业：

- **光学材料及元件：**HOYA、OHARA、肖特、新华光、戈碧迦、蓝特光学、爱特蒙特光学、水晶光电、联合光科、伯恩光学、永新光学、纳宏光电、激埃特光电；
- **光学镜头及模组：**舜宇光学、凤凰光学、宇瞳光学、AAC Optics、联合光电、特莱斯光电、弘景光电、歌尔光学、福光股份、永新光学、中光学集团、成都光明、光电集团、蓝特光学、联合光科、 立讯精密；
- **3D视觉：**艾迈斯欧司朗、芯视界、睿熙科技、瑞识科技、志强视觉、见行科技、美芯晟科技；
- **光谱传感：**彩谱科技、高谱科技、光芯智谱、优尼科、多谱光学、吉林求是、spectricon、巨哥科技 辰昶仪器、中达瑞和、西湖智能视觉、光引科技、光寻智能、Spectricity NV、鹿起科技、高光特光电；
- **Micro LED & OLED：**水晶光电、微玖、宏禧科技、思坦科技、昀光科技、睿显科技、镭昱光电、 诺视科技、视涯、国兆光电、芯视佳、芯屏半导体、晶湛半导体、斯多福；
- **光波导及AR&VR：**中科融合、立讯精密、歌尔光学、首镜科技、理湃光晶、AAC Optics、谷东科技、小象光显、鲲游光电、诠视科技、InsEye, Raontech、鸿石、MyRias,IIIusion、万有引力、康耐特、海联晶盛、微宇视界、Brilliance、泰美克，慕德微纳、拓比Tobii；
- **光学测试测量:** 基恩士、卡尔蔡司、泰勒·霍普森、翟柯 ZYGO、布鲁克、松下、全欧光学、三丰、 海克斯康、中图仪器、优可测、复享光学、东正光学、宇川光学、马波斯、中图科技、英特飞、 兆丰、星庆、图谱、昂科、知常、拓界、麦克奥迪、书敏、华中精密、科峰、光衡、台湾超微；

IICIE国际集成电路创新博览会 ——汇聚消费级芯片及芯片设计厂商，集中展示 AI 算力芯片、主控 SoC 、蓝牙 BLE 射频 芯片、电源管理 PMIC 、专用场景 AI 芯片等核心集成电路产品；

部分展示企业：

中兴微电子、华润微电子、比亚迪半导体、爱特微、北京君正、兆芯集成、澜起科技、紫光国微、广 立微、复旦微电子、灿芯半导体、谱瑞集成、极海半导体、成都华微电子、国芯科技、算能科技、京微齐力、鸿芯微纳、 珠海芯动力、进迭时空、隼瞻科技、合肥乾芯、二进制半导体、乘翎微电子、达摩院、美创希、清芯智研、中德工业、 华沅微、思凯迈、珈港科技、妙存科技、 一微科技、智现未来、泰芯半导体、象帝先、智芯科、澜昆微、 Advinno 等。

消费电子/汽车电子

>>回目录页

扫码登记参观

三展联动相关会议

时间	会议名称	会议地点	展馆号
09/09 下午	全球空间计算产业发展论坛	2号馆馆内会议室	2号馆
09/09 下午	AR/VR 光学技术应用高峰论坛	2号馆二楼2B	2号馆
09/09 下午	智能家居发展趋势高峰论坛	6号馆二楼6A	6号馆
09/09下午	RISC-V产业生态创新大会	14号馆二楼14C会议室	14号馆
09/09下午	第三届AI赋能消费电子创新论坛	14号馆馆内会议室	14号馆
09/09-/09/10	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1	16号馆
09/10上午	端侧A1芯势力：2026智能终端芯片生态峰会	14号馆馆内会议室	14号馆
09/10 全天	全球微显示产业发展论坛	2号馆馆内会议室	2号馆
09/10 全天	AI AR眼镜产业发展论坛	2号馆二楼2C	2号馆
09/10 下午	手持智能影像设备技术发展论坛	3号馆馆内会议室	3号馆
09/10下午	智算之源：2026芯算力创新峰会	14号馆馆内会议室	14号馆
09/11 上午	大空间交互与沉浸体验技术高峰论坛	2号馆馆内会议室	2号馆
09/11 上午	光电赋能低空经济新质生产力论坛	7号馆馆内会议室	7号馆

**会议名称以现场为准*

特色展示区及馆号：

- XR 眼镜拆解专区——2号馆；
- 望远镜及天文器材展区--3号馆；
- RISC-V 生态应用展示区—-14号馆；
- AI+ 应用特色展区——14号馆；

▶赋能汽车电子与具身机器人产业

三展联动整合智能汽车全产业链资源，一站式集中展示车载光通信、多传感器融合解决方案、车载显示、汽车三电系统、整车连接线束等，五大技术板块完整覆盖智能汽车感知、高速传输、动力供给、整车布线、座舱交互全技术链路：

- **车载光通信：**带来百 Gbps 无损传输，解决高阶智驾大数据传输难题；
- **多传感器融合：**全天候精准环境感知，消除单一传感器识别盲区；
- **车载显示：**打造沉浸式人车交互座舱；
- **三电系统：**稳定支撑新能源车续航、快充与全车智能硬件供电；
- **轻量化高屏蔽线束：**适配新一代中央集中式电子电气架构；

>>回目录页

领取参观证件

汽车电子与具身机器人

>>回目录页

扫码登记参观

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——覆盖车规与机器人硬件配套：车规被动元器件、车载电源管理、伺服驱动功率器件、机器人嵌入式运动控制主板、工规车规级连接器、宽温存储模组、边缘实时控制系统，提供整车电控、机器人整机集成硬件方案。

部分展示企业：

研华科技、长江存储、SEGGER 中国（哲戈微）、航顺芯片、灵动微、上海贝岭、朗科、东芯半导体、德明利、宇瞻科技、信维电子、微容、宇阳、厚声、安勤科技、步步精、硕凌、速显微、本原微、唯创知音、九芯电子等；

CIOE中国光博会 ——车载方面：覆盖汽车光通信、汽车感知、车载显示等三大板块，集中展示光芯片、模块、车规光纤线束、车载摄像头、车载红外夜视、3D视觉感知、激光雷达、智能座舱显示、Mini/Micro LED等；

部分展示企业：

- **车载摄像头：**舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、凤凰光学、AAC Optics、特莱斯、福特科光电、中光学、海创光电；
- **3D视觉：**艾迈斯欧司朗、芯视界、睿熙科技、瑞识科技、志强视觉、美芯晟科技、芯探科技、思岚科技、向至科技、力策科技、国微感知、蓝海光电、启激科技；
- **红外夜视：**高德红外、睿创微纳、大立科技、富吉瑞、夜视院集团、海康微影、华感科技、中星时代、焜腾红外、华国光学、深知未来、光智科技；
- **车载显示：**水晶光电、赛富乐斯、芯视元、思坦科技、立琻半导体、镭昱光电、视涯、昀光科技、西湖烟山科技、芯视佳、宏禧科技、诺视科技；
- **芯片及模块：**COHERENT高意、鹏瞰半导体、光莆、光迅、芯思杰、度亘、大普技术、三菱、三安光电、长光华芯、奇芯、光特、中电十三所、赛勒、国科光芯、三优、帝奥微、优迅股份、米硅、芯升半导体、苏纳、广州光为、亿芯源、申和、鸿星科技、彼格、圣达、杭州先导；
- **车载网络：**长飞、烽火、科谱、华工正源、CORNING、欧亿光电、乐庭智联、永鼎、华晟福涛；

IICIE国际集成电路创新博览会 ——汇聚芯片及芯片设计厂商，涵盖MCU 、SoC 、运动控制芯片、安全加密芯片，配套车规 晶圆制造、高可靠封装；还将设置AI+特色展示区，汇聚芯片、方案等企业；

部分展示企业：

中兴微电子、华润微电子、比亚迪半导体、爱特微、北京君正、兆芯集成、澜起科技、紫光国微、广立 微、复旦微电子、灿芯半导体、谱瑞集成、极海半导体、成都华微电子、国芯科技、算能科技、京微齐力、鸿芯微纳、珠 海芯动力、进迭时空、隼瞻科技、合肥乾芯、二进制半导体、乘翎微电子、达摩院、美创希、清芯智研、中德工业、华沅微、思凯迈、珈港科技、妙存科技、 一微科技、智现未来、泰芯半导体、象帝先、智芯科、澜昆微、 Advinno 等。

领取参观证件

>>回目录页

**以上仅部分代表企业，排名不分先后*

汽车电子与具身机器人

>>回目录页

扫码登记参观

三展联动相关会议

>>回目录页

领取参观证件

时间	会议名称	会议地点	展馆号
09/09 下午	2026第五届车载摄像头前沿技术与测试方法研讨会	1号馆二楼1B	1号馆
09/09下午	RISC-V产业生态创新大会	14号馆二楼14C会议室	14号馆
09/09-/09/10	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1	16号馆
09/09 全天	新能源汽车电子创新技术论坛	14号馆二楼 14A	14号馆
09/10 全天	第八届"光"+智能汽车技术高峰论坛	5号馆二楼5C	5号馆
09/10 全天	第41届“微言大义”研讨会：3D传感与成像技术及应用	6号馆二楼6B	6号馆
09/10 全天	2026车载光通信技术创新应用论坛	9号馆二楼9A	9号馆
09/10 日	汽车芯片产业创新论坛	14号馆二楼14B会议室	14号馆

**会议名称以现场为准*

特色展示区及馆号：

- 车载显示展示区——2号馆；
- 车载光通信实景体验区——13号馆；
- 汽车芯片展示区——14号馆；
- AI+汽车电子应用展区——14号馆；

▶具身机器人赛道

三展同步联动呈现全套核心软硬件方案：依托视觉感知模块完成目标识别、人机交互与近距离环境探测；功率器件负责电能变换与伺服电机控制，直接决定机器人运动性能、续航能力与机身轻量化水平；连接器及线束同步承载动力供电与高速数据双通道传输；全栈芯片构建机器人 “决策大脑、运动小脑、感知神经” 完整算力架构。

部分展示企业：

特设“具身机器人展示区”，位于CIOE中国光博会6号馆，部分参与企业如智身科技、遨博智能、瑞松机器人、蓝海光电、格科微、华域汽车等；

时间	会议名称	会议地点	展馆号
09/09下午	2026具身智能产业大会--从算力到执行，构建具身智能系统	15号馆馆内会议室	15号馆
09/09-/09/1	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1	16号馆
09/10 上午	面向具身智能的智能光学技术论坛	1号馆二楼1A	1号馆
09/10 全天	视觉感知·智造未来-具身智能机器人融合应用论坛	6号馆二楼6A	6号馆

**会议名称以现场为准*

半导体智能制造

>>回目录页

扫码登记参观

领取参观证件

▶赋能半导体制造与智能制造产业升级

三展联动整合智能制造全产业链资源，一站式集中展示半导体材料、半导体设备、半导体制造及封装服务、光学精密加工、激光器及激光设备、工业嵌入式、核心零部件系统、测试测量等，完整覆盖半导体制造与智能制造在芯片制造与封装检测、光学精密加工、视觉检测、激光制造等全技术链路，赋能半导体与智能制造提质增效、柔性智造升级：

- **半导体材料：**支撑晶圆制程、芯片互连与封装成型，夯实芯片制造物质基础；
- **半导体设备：**晶圆制造/封测装备，筑牢智造终端核心芯片供给底座；
- **晶圆制造与封测服务：**覆盖晶圆制程与高端封装工艺，赋能芯片制程迭代与规模化量产落地；
- **测试测量：**全维度检测校准，管控设备精度与量产工艺品质；
- **工业视觉：**高精度视觉识别，破解产线质检、定位、测量核心难题；
- **光学精密制造：**微纳级高精加工，满足精密构件异形制造需求；
- **激光器及激光加工制造：**高能激光制程，实现切割、焊接、打标及表面处理；
- **工业嵌入式：**高可靠端侧算力，支撑产线运算与设备联动调控；
- **核心零部件系统：**高端功能组件，保障智能装备长效稳定运行；

>>回目录页

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——打造智能制造硬件底座：工业嵌入式主板、PLC 核心控制单元、伺服驱动电源、工业级元器件、高可靠连接器、宽温存储、工业物联网网关，提供标准化产线控制、边缘计算整机解决方案，适配 3C、半导体、新能源全行业自动化产线。

部分展示企业：

研华科技、安勤科技、SEGGER 中国（哲戈微）、芯驿电子、璞致电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro、拓普微、临滴、睿赛德、研江、步步精、硕凌、宇熙精密、福顺、厚声、微容、宇阳、扬兴科技、信维电子、德鸿感应、京泉华、上海贝岭、爱浦、荣和美等；

CIOE中国光博会 ——展示高精度工业镜头、工业传感器、2D/3D 机器视觉相机、激光器、激光打标 / 切割 / 焊接设备、光谱检测仪器、红外测量设备、光学镀膜设备、光学系统等，用于精密制造缺陷检测、尺寸测量、自动化定位。

部分展示企业：

- **晶圆制造与封测设备：**GlobalFoundries、Tower Semiconductor、芯联集成、联合微电子、PIC、ASTRO PLASMA、ASMPT、JEOL、Raith、E-Globaledge、Samco、纳微科毅、润华全芯微、施密科、思立康、华创智能、Finetech、MRSI(Mycronic Group)、MKS、OXFORD INSTRUMENTS、智立方、深圳科瑞、铭赛机器人、凯格精密、快克芯装备、轻蜓、思波微、诚锋电子、中科光智、MPI、和林微纳、森美协尔、PI、东方马达、ACS运动控制（中国）；

**以上仅部分代表企业，排名不分先后*

半导体智能制造

>>回目录页

扫码登记参观

部分展示企业：

- **激光器及激光加工：** IPG、锐科、大族、长光华芯、创鑫、Light Conversion、Litilit、富通尼、罗悉激光、华光、中辉、晶众、公大激光、英诺激光、卓立汉光、英谷激光、华工、联赢、海目星、韵腾、镭射沃、玉之泉、艾贝特、紫宸、古洛、创科达、新耐视、正运动、奇光、菲镭泰克、迹点激光、环立；
- **智能装备及工业自动化：** 华工、芯碁微、米思米、东佑达、圭华智能、矽万、库尔特埃莎、固安力、精准机械、晨兴智能、凯特精密、誊展精密、立可自动化、魔技纳米、菲格斯、佳迈、锐健、艾瑞森、武藏、进和、藕道智能、繁易、凯福、金源、千里智能、爱合发、研成工业、多场科技、卓创、捷传、万合精密、永翔顺；
- **精密光学加工：** 阿美特克·普瑞思泰克、DKSH 、Satisloh、克兰菲尔德精密、广浩捷、优普纳、北京海普超精、博众泰达、华粹、神工科技、天仁微纳、芝浦机械、施耐德电气、大昌洋行、善能精密、大敏尚东、朗信光学、锡斌光电、恒泰光学、通用集团机床院；
- **光学镀膜设备：** 布勒莱宝、日本光驰、博顿光电、汇成真空、上海哈呐、艾微普、IZOVAC、国泰真空、新柯隆、佑伦真空、杰莱特、中兴光电、昭和真空、哈呐、其芒、派莱特、友臻、天一国泰、梭莱、捷佳创、纳峰、兴南真科、韫茂科技、中科九微、朗为、弘浦；
- **红外测试测量：** 索雷博、Optris、欧普特科技、振兴计量、HGH、东部科技、宇桥优信、迈创分析仪器、盈盛源、英达高、布莫让、HGH、中电科四十一所、必达泰克、德美机电、极源光电、天枢智测；
- **工业传感器：** 米铱、Stella、ODTech、滨松、锐芯微、派铼兹、光引科技、万赢、睿芯源、西曼传感、豪末、远讯光电、映讯芯光、芯晟捷创、杭高睿光、恩弼科技、乐成光电、智恒、可天士电子、阿米精控、传周半导体；

IICIE国际集成电路创新博览会 ——展会现场将集中展示精密机械与结构件 、流量/压力控制、射频/电源模组、运动控制、机 器视觉、传感器等核心零部件, 半导体设备龙头企业齐聚，助力自动化设备切入高端赛道；通过现场半导体高端装备 、精 密产线实景观摩与技术对接 ,帮助自动化设备厂商直观了解半导体领域严苛标准与升级方向 ，快速补齐技术、工艺与场景 应用短板，高效切入半导体高端装备市场。

部分展示企业：

- **半导体材料：** 沪硅产业、天科合达、安集科技、中船特气、上海新阳、清溢微、西陇科学、方大炭炭、木林升、奔朗 新材、亦盛科技、中宝新材、贵研半导体、华熔科技、道川半导体材料、云升新材、昆吾、洽美斯、宇腾、晨 日 科技、 玻芯成、创格、基迈克、爱科迈、沃尔德、抚顺特钢、中色东方集团、YINCAE 英凯等；
- **半导体设备：** 盛美上海、拓荆科技、华海清科、微崇半导体、华煜半导体、精测电子、北京中电科、中科飞测、隆友 德、华卓精科、迈为技术、东方晶源、维嘉科技、三丰精密、容道社、冠礼科技、光粒半导体、理纯洁净、海目芯微、 津上智造、钧华半导体、致和半导体、维嘉科技、微法尔、四元数、海浥半导体、艾恩、博涛智能、芯慧联芯、佳智 彩、运泰利、伊创、幂帆科技，昌鼎电子、稳顶聚芯、华封科技、西斯特等；
- **晶圆制造与封测服务：** 晶合集成、武汉新芯、积塔半导体、华天科技、芯植微、佰维存储、时代民芯、锐立平芯、新 核芯、安吉海万欣等；
- **半导体核心零部件及智能制造方案：** 中科仪、新松半导体、万瑞冷电、上银科技、新莱集团、灿锐科技、司倍克、基 恩士、冠业传动、欧莱新材等。

**以上仅部分代表企业，排名不分先后*

>>回目录页

领取参观证件

半导体智能制造

>>回目录页

扫码登记参观

三展联动相关会议

领取参观证件

时间	会议名称	会议地点	展馆号
09/09 下午	先进光学与智能传感技术论坛	1号馆二楼1C	1号馆
09/09 下午	激光微纳加工先进制造论坛	2号馆二楼2C	2号馆
09/09 下午	激光技术赋能半导体制造论坛	2号馆二楼2A	2号馆
09/09 下午	激光焊接助力智能制造创新应用论坛	4号馆馆内会议室	4号馆
09/09 下午	光学半导体检测技术论坛	5号馆二楼5B	5号馆
09/09 下午	纳米压印制造技术论坛	5号馆二楼5C	5号馆
09/09 下午	先进材料创新发展大会—突破互连与散热极限-AI 异质整合封装之关键材料	13号馆二楼13A会议室	13号馆
09/09下午	2026智能制造创新发展大会	14号馆二楼14A会议室	14号馆
09/09下午	半导体制造核心设备与零部件发展论坛	16号馆馆内会议室	16号馆
09/09-/09/10	第八届中国嵌入式技术大会	16号馆会议室1	16号馆
09/10 全天	IWAPS国际先进光刻技术研讨会	南登录大厅二楼红树林厅A	南登录大厅
09/10 上午	超构&微纳光学制造技术论坛	5号馆二楼5A	5号馆
09/10 下午	光学超精密加工制造论坛	5号馆二楼5A	5号馆
09/10 全天	光学真空镀膜大会	7号馆馆内会议室	7号馆
09/10全天	先进封装与测试技术论坛-从CoWos到 CoPoS：共探 AI 时代先进封装技术演进与供应链布局	14号馆二楼14C会议室	14号馆
09/10全天	智能工控赋能自动化创新论坛	15号馆馆内会议室	15号馆
09/10全天	宽禁带半导体先进封装SiC嵌埋PCB装备及材料供应链解决方案	16号馆馆内会议室	16号馆
09/11全天	IWAPS国际先进光刻技术研讨会	5号馆二楼5ABC 6号馆二楼6ABC 9号馆二楼9ABC	5/6/9号馆
09/11上午	第二届边缘AI与智能控制技术行业论坛	15号馆馆内会议室	15号馆
09/11上午	半导体洁净厂务与能源管理论坛	16号馆馆内会议室	16号馆

>>回目录页

**会议名称以现场为准*

特色展示区及馆号：

- 激光焊接展示区——2号馆
- 蓝宝石加工应用展区——3号馆
- 光学注塑/模压非球面展区——3号馆

组团参观

>>回目录页

扫码登记参观

- **5人**报名即可成团
- 专享便捷登记通道
- 团长及每位团员**参观礼品卡**
- 专属**团长礼品卡**（10人及以上可得）
- **定制化**观展资料，提高观展效率
- 展前快递**入场证件、午餐券**
- **专人专线**接待，现场拍照留念
- **免费大巴**接送（报名达30人，限3小时车程内）

注：团长礼品卡：10人团-三合一手机快充线，20人团-折叠灯，50人团-AI机器人

扫码下载团体报名表

>>申请个人报名

>>点击查看CIOE光博会展会资料

>>点击查看IC创新博览会展会资料

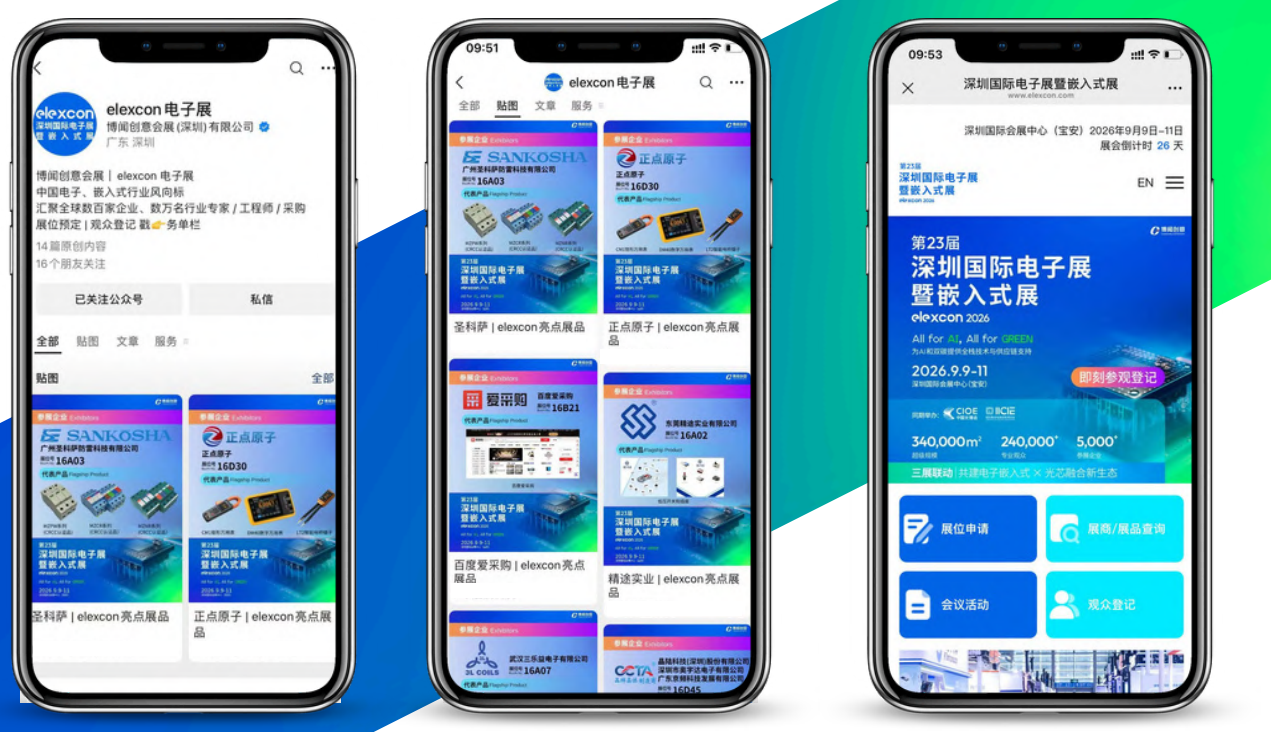
>>回目录页

领取参观证件

elexcon订阅号、企微

展商一览 查询展品

产业资讯 活动对接



扫码关注“elexcon电子展”
方便随时查看使用

扫码添加光博君企业微信
进行业交流群

elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展官方订阅号，是面向**电子与嵌入式产业从业者的垂直产业资讯平台**，依托三展联合产业资源，输出**产业深度内容、展会活动一手信息、技术干货与资源对接情线索**，打通线上内容传播与线下展会生态，成为**产业链获取趋势、选型参考、商机线索的重要窗口。**

交通指引：快速抵达深圳国际会展中心

▶地铁：搭乘11号线（碧头方向）至机场北站换乘换20号线（会展城方向）或至南山站换乘12号线（海上田园方向），到达**国展北站C1、C2口**抵达会展中心-**北登录大厅-16号馆。**

▶自驾：导航深圳市宝安区福海街道展城路1号，深圳国际会展中心地下停车场： P1、P6、P7、P9。

▶高铁抵达：

①深圳北站：搭乘地铁5号线（赤湾方向）至灵芝站换乘11号线（碧头方向）至机场站，再换乘地铁 20 号线 （会展城方向）至国展北站C1 、C2 出口到达北登录大厅-16号馆；

②深圳东站：乘坐地铁 14 号线（沙田方向）至布吉站，换乘地铁 11 号线（碧头方向）至机场站，再换乘地铁 20 号线 （会展城方向）至至国展北站C1 、C2 口到达北登录大厅-16号馆；

③福田站：乘坐地铁 11 号线（碧头方向）至机场站，换乘地铁 20 号线（会展城方向）至国展北站C1 、C2 口到达北登录 大厅-16号馆。

▶深圳宝安国际机场抵达：

抵达机场后，可选择出租车，或直接乘坐地铁 11 号线（碧头方向）至机场站，换乘地铁 20 号线（会展城方向）至国展北 站C1 、C2 口到达北登录大厅。

▶广州白云国际机场抵达：可乘坐高铁、巴士抵达深圳市内，换成公共交通至展馆。

▶香港出发：

①香港中港城码头：

乘坐客船至深圳机场码头，再搭乘出租车到深圳国际会展中心(宝安)北登录大厅;

②香港西九龙站：

可乘坐高铁至福田站，搭乘地铁11号线(碧头方向)到达机场北再换乘20号线，到达国展北站C1 、C2 口;

③香港国际机场：

可搭乘跨境巴士、轮渡（海天客运码头至深圳蛇口码头）抵达，再换成深圳市内交通抵达展馆;

④深圳各口岸：

福田、皇岗、罗湖及深圳湾等口岸，过关后再换成深圳市内交通抵达展馆。

>>回目录页

领取参观证件

博闻创意
Creativity Exhib tion

第23届
深圳国际电子展
暨嵌入式展
elexcon 2026

All for AI, All for GREEN

为AI 和双碳提供全栈技术与供应链支持

2026.9.9-11

深圳国际会展中心（宝安）

同期举办：CIOE 中国光博会　IICIE 国际集成电路创新博览会 INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

320,000m²
超级规模

240,000⁺
专业观众

5,000⁺
参展企业

三展联动｜共建电子嵌入式 × 光芯融合新生态

芯片|存储|嵌入式|边缘AI

功率器件与电源|无源器件

SiP与先进封装|连接器

即刻登记免费参观
一证参观三展

0755-88311535
elexcon.sales@cetimes.com

elexcon | ufi Approved Event

CIOE
中国光博会

第27届中国国际光电博览会

2026年9月9-11日
深圳国际会展中心(宝安)

260,000M² 展出面积
150,000+ 专业观众
4,000+ 参展企业

同期八大主题展

- 信息通信展 INFORMATION AND COMMUNICATION EXPO
- 精密光学展&摄像头技术及应用展 PRECISION OPTICS EXPO & CAMERA EXPO
- 激光技术及智能制造展 LASERS TECHNOLOGY & INTELLIGENT MANUFACTURING EXPO
- 红外技术及应用展 INFRARED APPLICATIONS EXPO
- 智能传感展 INTELLIGENT SENSING EXPO
- 光电子创新展 PHOTONICS INNOVATION EXPO
- AR&VR展 AR&VR EXPO
- 新型显示技术展 DISPLAY TECHNOLOGY EXPO

同期论坛

中国国际光电高峰论坛
CHINA INTERNATIONAL OPTOELECTRONIC CONFERENCE

更多展会详情请登录

WWW.CIOE.CN

CIOE官方小程序

关注CIOE官方公众号

IICIE
国际集成电路创新博览会
INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

2026年9月9-11日
深圳国际会展中心（宝安）

IICIE 国际集成电路创新博览会

展出面积 50,000 m² | 参展企业 1,100+ 家 | 参观人数 60,000+ 人

与全产业链龙头高效面对面

芯片及芯片设计/功率半导体

中兴微电子、华润微电子、比亚迪半导体、爱特微、北京君正、澜起科技、紫光国微、广立微、复旦微电子、灿芯半导体、谱瑞集成、极海半导体、成都华微电子、国芯科技、算能科技、京微齐力、鸿芯微纳、珠海芯动力、进迭时空、隼瞻科技、六岳微电子、二进制半导体、乘翎微电子、达摩院玄铁、美创希、清芯智研、中德工业、华沅微、思凯迈、珈港科技、妙存科技、 一微科技、智现未来、泰芯半导体、象帝先、智芯科、澜昆微、Advinno

半导体设备

盛美上海、拓荆科技、华海清科、微崇半导体、华煜半导体、精测电子、北京中电科、中科飞测、隆友德、华卓精科、迈为技术、东方晶源、维嘉科技、三丰精密、容道社、冠礼科技、光粒半导体、理纯洁净、海目芯微、津上智造、钧华半导体、致和半导体、维嘉科技、微法尔、四元数、海浥半导体、艾恩、博涛智能、芯慧联芯、佳智彩、运泰利、伊创科技、幂帆科技、昌鼎电子、稳顶聚芯、华封科技、西斯特等

制造/封测

华虹集团、积塔半导体、晶合集成、武汉新芯、增芯科技、华天科技、芯植微、佰维存储、时代民芯、锐立平芯、新核芯、安吉海万欣等

半导体材料

沪硅产业、天科合达、电科材料、安集科技、中船特气、上海新阳、清溢微、西陇科学、方大炭炭、木林升、奔朗新材、亦盛科技、中宝新材、贵研半导体、华熔科技、道川半导体材料、云升新材、昆吾、洽美斯、宇腾、晨日科技、玻芯成、欧莱新材、创格、基迈克、爱科迈、沃尔德、抚顺特钢、中色东方集团、YINCAE英凯等

半导体核心零部件

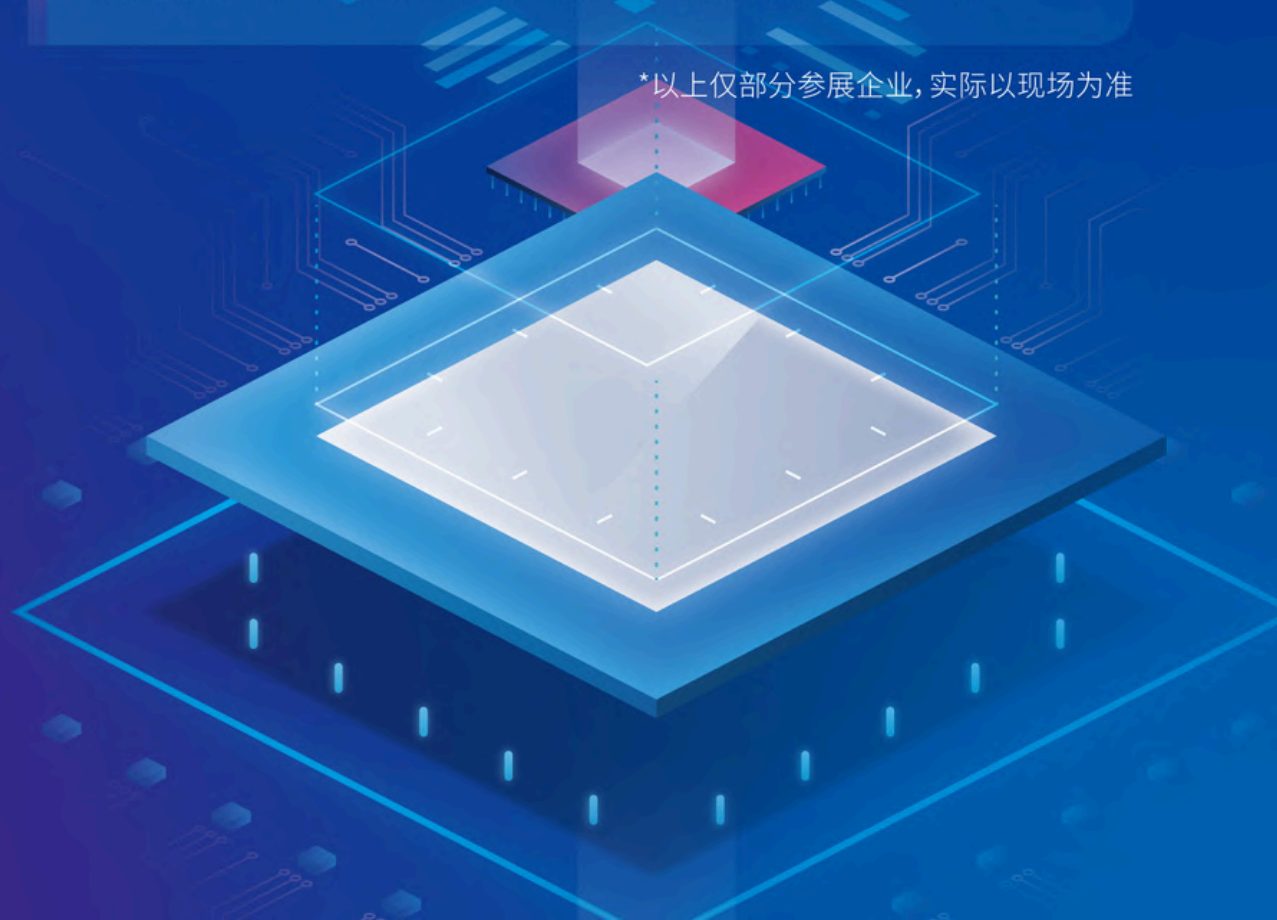
中科仪、新松半导体、万瑞冷电、上银科技、新莱集团、灿锐科技、司倍克、基恩士、冠业传动、四达全、星奇半导体、中科四点零、上可优、有氟密、百士吉、高川自动化、德利克、清能德创、兆默半导体、阿米精控、隐冠半导体、气立可、莫申、埃迈诺冠、雷赛、奕瑞、克洛诺斯、银光机器人、沈阳纪维、科瑞斯、横川机器人等

*以上仅部分参展企业，实际以现场为准

报名参观
一证逛三展

微信小程序

微信公众号



第23届

深圳国际电子展
暨嵌入式展

elexcon 2026

All for AI, All for GREEN

为AI 和双碳提供全栈技术与供应链支持

2026年9月9日-11日

深圳国际会展中心（宝安）

即刻扫码登记获取参观证件

登记成功后，人人可获得:

电子全产业链行业报告合集

涵盖存储、消费电子、汽车电子、机器人、电源、数据中心赛道报告合集

（登记后展前10个工作日内发送至登记邮箱）